

DIMENSIONEN

Geschäftsbericht 2009

INHALTSVERZEICHNIS

BRIEF AN DIE AKTIONÄRE 02
BERICHT DES AUFSICHTSRATS 06
3. DIMENSION 12

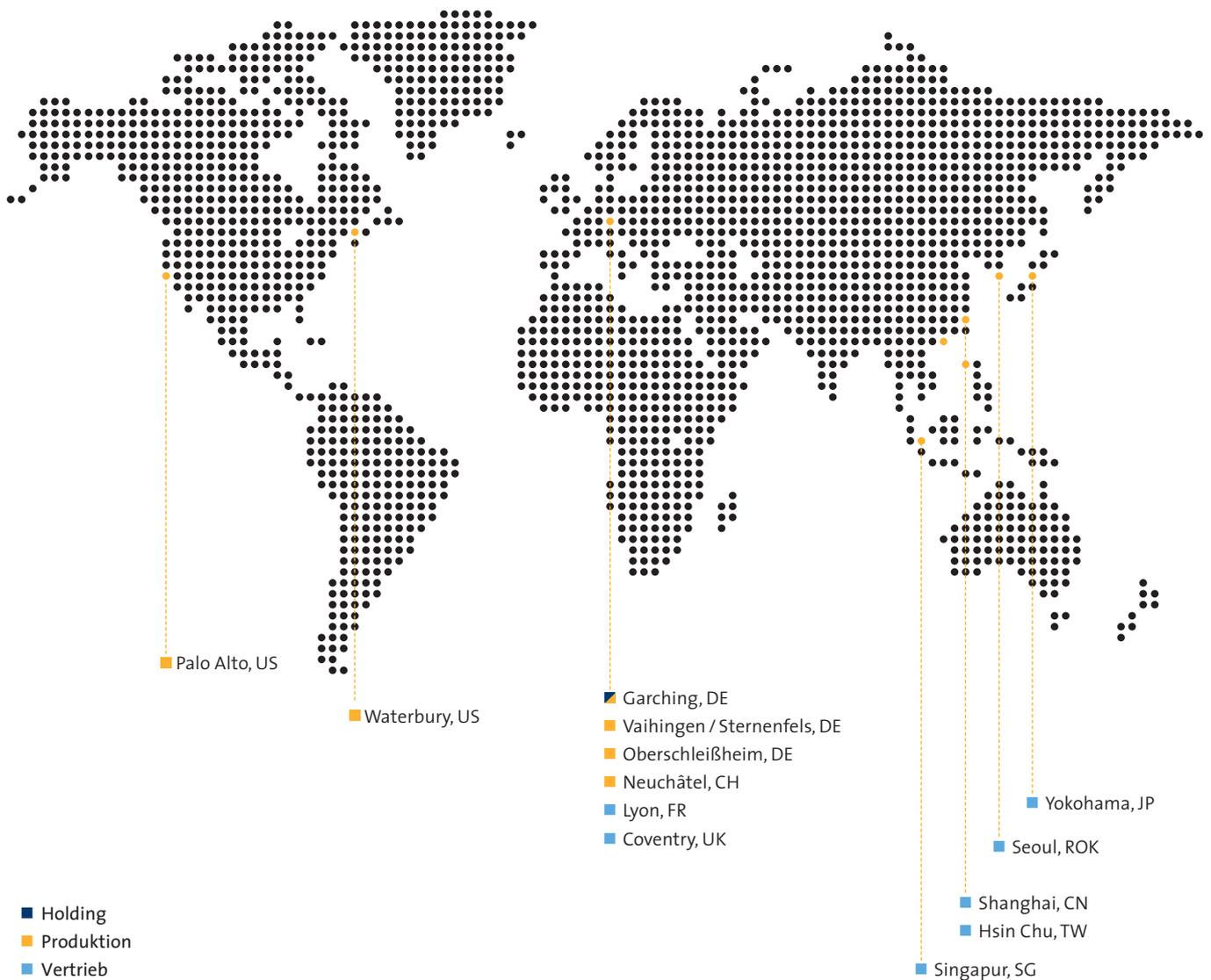


12 LEISTUNGSSTEIGERUNG
16 KOMPLEXITÄT 20 PRÄZISION
24 EFFIZIENZ

INVESTOR RELATIONS 28
CORPORATE GOVERNANCE 32
KONZERNLAGEBERICHT 42
KONZERNABSCHLUSS 73
KONZERNANHANG 88
SERVICE 144



SÜSS MICROTEC – WELTWEIT GUT AUFGESTELLT



NORDAMERIKA

Mitarbeiter 2009: 145
Umsatz 2009: 24,2 Mio. €

EUROPA

Mitarbeiter 2009: 379
Umsatz 2009: 39,7 Mio. €

JAPAN

Mitarbeiter 2009: 38
Umsatz 2009: 12,0 Mio. €

SONSTIGES ASIEN

Mitarbeiter 2009: 52
Umsatz 2009: 44,4 Mio. €

KENNZAHLEN

in Mio. €	2009	2008	Veränderung
Fortgeführte Aktivitäten			
Auftragseingang	96,3	118,2	-18,5%
Auftragsbestand zum 31.12.	57,0	65,1	-12,4%
Umsatz gesamt	103,9	121,5	-14,5%
Umsatzrendite	0,5%	-9,5%	10,0%-Punkte
Rohertrag	38,8	38,3	1,3%
Rohertragsmarge	37,4%	31,6%	5,8%-Punkte
Herstellungskosten	65,1	83,1	-21,7%
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,9	5,7	-14,0%
Fortgeführte Aktivitäten			
EBITDA	7,6	9,2	-17,4%
EBITDA-Marge	7,3%	7,6%	-0,3%-Punkte
EBIT	2,8	-8,7	132,2%
EBIT-Marge	2,7%	-7,2%	9,9%-Punkte
Ergebnis nach Steuern	0,5	-11,6	104,3%
Ergebnis je Aktie, unverwässert	0,03	-0,68	104,4%
Fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten			
Ergebnis nach Steuern	-4,9	-13,9	64,7%
Ergebnis je Aktie, unverwässert	-0,28	-0,82	65,9%
Bilanz und Cashflow			
Eigenkapital	86,1	90,6	-5,0%
Eigenkapitalquote	63,1%	59,0%	4,1%-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	0,6%	-12,8%	13,4%-Punkte
Bilanzsumme	136,4	153,6	-11,2%
Net Cash	18,4	9,4	95,7%
Free Cashflow*	8,9	1,9	368,4%
Weitere Kennzahlen			
Investitionen	3,1	9,0	-65,6%
Investitionsquote	3,0%	7,4%	-4,4%-Punkte
Abschreibungen	4,8	17,9	-73,2%
Mitarbeiter zum 31.12.**	498	545	-8,6%
Mitarbeiter zum 31.12.***	614	674	-8,9%

* vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben

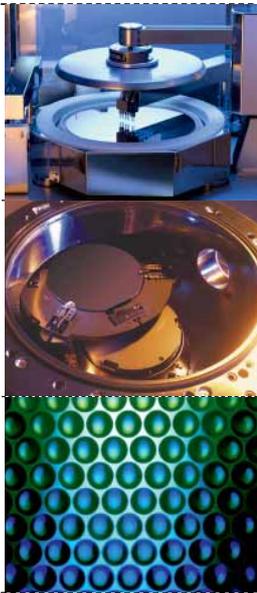
** fortgeführte Aktivitäten

*** fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten

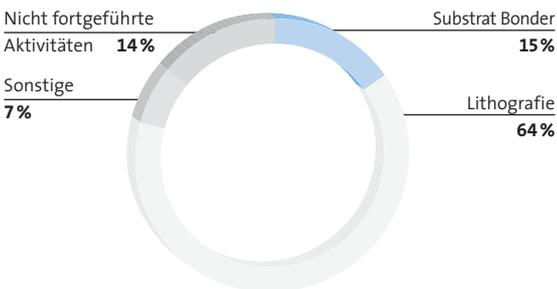
SEGMENTINFORMATIONEN



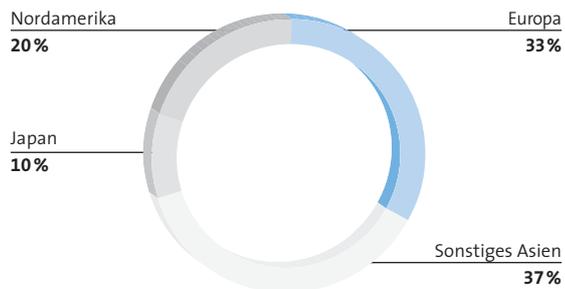
Segmente	Produktlinien	Adressierte Märkte
LITHOGRAFIE Umsatz: 77,6 Mio. € Ergebnis: 11,7 Mio. €	Mask Aligner Entwicklungssysteme Spin- und Spray-Coater	Advanced Packaging 3D-Integration Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter
SUBSTRAT BONDER Umsatz: 18,3 Mio. € Ergebnis: -3,8 Mio. €	Substrat (Wafer) Bonder	3D-Integration Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter
SONSTIGE Umsatz: 8,0 Mio. € Ergebnis: -5,1 Mio. €	Masken Mikrooptik und -linsen C4NP	Mikrooptik Halbleiterindustrie Advanced Packaging (C4NP)



Umsatz nach Segmenten



Umsatz nach Regionen





BRIEF AN UNSERE AKTIONÄRE

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in den vergangenen zwei Jahren sind die Finanzmärkte und die gesamte Weltwirtschaft in einer Weise aus dem Gleichgewicht geraten und in eine tiefe Krise gestürzt wie nie zuvor in den vergangenen 60 Jahren. Gleichzeitig befand sich die Halbleiterindustrie weltweit in einem zyklischen Abschwung und verzeichnete in 2009 eines der schlechtesten Jahre seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2001. Das abgelaufene Geschäftsjahr zählte damit zweifelsohne auch zu den schwierigsten und herausforderndsten unserer Firmengeschichte.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir haben bestanden und haben dabei sogar unsere eigenen Ziele und Erwartungen trotz der widrigen Umstände leicht übertroffen. Wir konnten unsere hervorragende Position am Markt behaupten und haben aufgrund unseres breiten Portfolios an innovativen Produkten und unserer globalen Aufstellung Marktanteile hinzugewonnen.

Gleichzeitig ist uns gelungen, unsere Kostenstruktur zügig an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und unsere Liquiditätsposition über das Jahr hinweg kontinuierlich zu verbessern. Erfreulich war in diesem Zusammenhang auch, dass wir trotz der viel besagten Kreditklemme unsere gewährte inländische Kreditlinie zum Jahresbeginn nicht nur verlängern, sondern wir zudem die Deutsche Bank AG als drittes, neues Konsortialmitglied hinzugewinnen konnten.

Das Geschäftsjahr 2009 in Zahlen

Wie bereits zu Jahresbeginn 2009 prognostiziert, verzeichneten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl bei Auftragseingang als auch im Umsatz einen deutlichen branchen- und konjunkturbedingten Rückgang. Ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Test Systeme erwirtschaftete das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 103,9 Millionen Euro und verfehlte damit den Vorjahreswert von 121,5 Millionen Euro um rund 14 Prozent. Der Auftragseingang sank im Jahresvergleich um rund 19 Prozent auf 96,3 Millionen Euro (Vorjahr: 118,2 Millionen Euro). Trotz des signifikanten Umsatzrückgangs ist es uns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 gelungen, aus fortgeführten Aktivitäten ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 2,8 Millionen Euro zu erwirtschaften. Im Vorjahr betrug das durch Sonderbelastungen in Höhe von 17,2 Millionen Euro geprägte Ergebnis vor Zinsen und Steuern -8,7 Millionen Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten wir bereits im zweiten Halbjahr 2008 mit der Umsetzung sowohl operativer als auch struktureller Maßnahmen begonnen und diese konsequent im Jahr 2009 weitergeführt. Erste Erfolge daraus spiegelten sich bereits zu Jahresanfang in der deutlich verbesserten Liquidität der SÜSS MicroTec-Gruppe wider. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 2009 signifikant auf 18,4 Millionen Euro (Vorjahr: 9,4 Millionen Euro). Darüber hinaus konnte unser Ziel, einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften, eindeutig erreicht werden. Dieser belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben zum Geschäftsjahresende auf 8,9 Millionen Euro nach 1,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Umfangreiches Maßnahmenprogramm gegen die Krise

Wie eingangs erwähnt, befand sich die Halbleiterbranche bereits im Jahr 2008 in einem zyklischen Abschwung. Diese Situation wurde durch die in der zweiten Jahreshälfte 2008 heraufziehende globale Finanzmarktkrise zusätzlich verschärft. Die aufgrund bestehender Überkapazitäten seitens der Halbleiterhersteller geringe Nachfrage nach Halbleiter-Equipment wurde durch die wachsende Unsicherheit auf den Weltmärkten weiter gebremst. Beide Effekte nötigten uns daher zu einem frühzeitigen und zügigen Handeln. Die ergriffenen Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen beinhalteten neben einer generellen Einschränkung der Reisetätigkeit, eine sehr restriktive Budgetierung von Aufträgen an externe Dienstleister sowie die Neu-Analyse und -genehmigung sämtlicher Investitionsprojekte. Darüber hinaus zählte der Abbau von Vorräten und Forderungen sowie die Optimierung des Einkaufs- und Beschaffungswesens zu den operativen Maßnahmen, die sich allesamt positiv auf die Liquiditätsposition der Gruppe auswirkten.

Zu den umgesetzten strukturellen Maßnahmen zählte die Zusammenlegung der Vertriebsstandorte Thailand und Singapur, die Umstellung der Vertriebsaktivitäten für den Geschäftsbereich Test Systeme in den Ländern Frankreich und Taiwan von direktem auf indirekten Vertrieb sowie die Neuorganisation der Vertriebs- und Servicestruktur in Nordamerika. Darüber hinaus wurde die Administration der Vertriebs- und Serviceaktivitäten in Frankreich und England an den Hauptsitz nach Garching verlagert. Durch die Zusammenlegung administrativer Bereiche in den deutschen Tochtergesellschaften konnten zudem weitere, nachhaltig wirkende Einsparungen erzielt werden.

Darüber hinaus konnten wir an den deutschen Standorten die Produktionskapazitäten durch Kurzarbeit und dem Abbau von Langzeitkonten an die reduzierte Nachfrage anpassen. Unumgänglich war jedoch auch im Jahr 2009 der Abbau von insgesamt 60 Mitarbeitern weltweit.

Alles in allem konnten wir unsere Gewinnschwelle für das Geschäftsjahr 2010 auf ein Umsatzniveau von 110 bis 115 Millionen Euro senken. Wir sind überzeugt, dass wir mit den ergriffenen Maßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine solide Basis geschaffen haben, um aus der Krise nachhaltig gestärkt hervorzugehen.



links:

Michael Knopp
Finanzvorstand

rechts:

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Strategische Entwicklung

Neben diesem umfangreichen Maßnahmenprogramm haben wir aber auch wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt. Von hoher Bedeutung waren im Geschäftsjahr 2009 die Abschlüsse von insgesamt vier Entwicklungskooperationen in dem Bereich der dreidimensionalen Systemintegration, auch 3D-Integration genannt. Zu den gewonnenen Entwicklungspartnern aus Industrie und Forschung zählen neben 3M und der Thin Materials AG das belgische Forschungszentrum für Nanoelektronik IMEC sowie eines der weltweit führenden Forschungsinstitute im Bereich der Halbleiterindustrie, das Industrial Technology Research Institute (ITRI) in Taiwan. Im Mittelpunkt der Kooperationen steht die Weiterentwicklung von Technologien in dem Bereich der Chipverpackungen. Darunter fallen insbesondere Prozesslösungen für die Handhabung gedünnter Wafer („Thin Wafer Handling“) sowie das temporäre und permanente Bonden von gestapelten Chips und deren Kontaktierung untereinander („Through Silicon Vias“). Diese Kooperationen bilden die folgerichtige Ergänzung zur 3D-Strategie des Unternehmens. Sie decken sich mit dem Ziel, unsere Fertigungssysteme zur Plattform für den Einsatz breitgefächerter Technologielösungen auszubauen, um auch zukünftig die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse optimal erfüllen zu können.

Zu den weiteren Meilensteinen des Geschäftsjahres zählen zweifelsohne die beiden im Jahr 2010 erfolgreich abgeschlossenen Investitions- bzw. Desinvestitionsprojekte. Durch den Kauf der HamaTech APE, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Singulus Technologies AG, haben wir unser Produktportfolio im Bereich der Nassprozesse, bestehend aus Coatern und Developern, sinnvoll erweitern können. Die 20-jährige Erfahrung der HamaTech APE in der Prozess- und Equipmententwicklung sowie deren hochinnovative Reinigungstechnologien für Fotomasken in der Halbleiterlithografie ergänzen ideal die Kernkompetenz der SÜSS MicroTec-Gruppe. Durch den Erwerb des Grundstücks und des modernen HamaTech-Produktionsgebäudes am Standort Sternenfels haben wir zudem die Basis für den Ausbau eines konzernweiten Kompetenz-Centers geschaffen. Der Umzug unserer im ca. 20 Kilometer entfernten Vaihingen angesiedelten Coater- und Developer-Fertigung nach Sternenfels soll bereits zur Jahresmitte 2010 erfolgen.

Wesentlich und mit direkten Auswirkungen auf den Konzernabschluss 2009 war zudem der Verkauf der in Sacka bei Dresden angesiedelten Süss MicroTec Test Systems GmbH an den US-amerikanischen Wettbewerber Cascade Microtech, Inc. Durch den Verkauf des zuletzt unprofitablen Geschäftsbereichs Test Systeme werden wir uns zukünftig ganz auf unsere Fertigungslösungen für die Mikrostrukturierung in der Mikroelektronik konzentrieren können. Die starke Wettbewerbssituation im Markt für elektronische Mess- und Prüfsysteme für integrierte Schaltungen hatte in den vergangenen Jahren zunehmend zu Margendruck geführt und letztendlich trotz technologisch führender Produktpalette kein profitables Wirtschaften ermöglicht. Umso erfreulicher ist es jetzt, dass wir mit dem Verkauf an Cascade Microtech, Inc. eine für beide Parteien sowie unsere Kunden optimale Lösung gefunden haben. Durch die Akquisition des SÜSS Geschäftsbereiches Test Systeme wird Cascade Microtech seine Führungsposition im Markt für Halbleitertestsysteme weiter ausbauen können. Cascade Microtech erlangt nunmehr die kritische Masse, um sich zukünftig auf die technologischen Herausforderungen im Bereich der Test- und Prüfsysteme konzentrieren zu können, mit denen Halbleiterhersteller bei der Entwicklung von Prozessen und Chipdesigns in den kommenden Jahren konfrontiert werden werden. Durch die mit Cascade Microtech abgeschlossene strategische Partnerschaft hinsichtlich der 3D-Integration wird SÜSS MicroTec von dieser Entwicklung ebenfalls profitieren.

Ausblick

Die Weltwirtschaft scheint den Tiefpunkt der Rezession durchschritten zu haben, wenngleich für das Jahr 2010 nur mit einer langsamen konjunkturellen Belebung gerechnet wird. Trotz dieser weiterhin kritischen Randbedingungen wollen wir im Jahr 2010 stärker in Forschung und Entwicklung investieren und damit unsere Markt- und Technologieposition in den von uns adressierten Märkten ausbauen und die Grundlage für ein dauerhaft profitables Wachstum nach der Krise schaffen. Gleichzeitig gilt unser Augenmerk im laufenden Jahr dem Umzug unserer Coater- und Developer-Fertigung an den Standort Sternenfels sowie der Integration der HamaTech APE in die SÜSS MicroTec-Gruppe.

Für das Geschäftsjahr 2010 rechnen wir mit einer Stabilisierung des Umsatzes und einem positiven freien Cashflow bereinigt um die Effekte aus dem Kauf der HamaTech APE sowie der Gebäude am Standort Sternenfels. Darüber hinaus werden wir uns im Rahmen der Quartalsberichterstattungen konkreter zum laufenden Geschäftsjahr 2010 äußern.

Meine Damen und Herren, Ihr Unternehmen hat ein schwieriges Jahr hinter sich und ein nicht minder anspruchsvolles liegt vor uns. Befreit von den Belastungen der Vergangenheit gehen wir jedoch mit Entschlossenheit und großem Selbstvertrauen in das neue Geschäftsjahr und die weitere Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass wir die aktuellen Herausforderungen ebenso erfolgreich meistern werden wie die vergangenen. Wir sind gut aufgestellt und unsere Geschäftspartner wie auch der Kapitalmarkt honorieren unsere Anstrengungen. Wir hoffen, mit dem vorliegenden Bericht auch Sie überzeugen zu können und wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit sowie bei den ausgeschiedenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für ihren außerordentlichen Einsatz im vergangenen Jahr sehr herzlich bedanken.

Garching, im März 2010



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat informiert im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009. Im Mittelpunkt der Beratungen standen insbesondere die Auswirkungen der weltweiten Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise auf die SÜSS MicroTec-Gruppe, die strategischen Kooperationen im Bereich der 3D-Integration sowie strategische Investitions- und Desinvestitionsprojekte.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden uns im Einzelnen erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand mit uns ab. Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert und zu zustimmungspflichtigen Geschäften unsere Zustimmung erteilt. Insgesamt fanden im Geschäftsjahr 2009 elf ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats sowie eine außerordentliche Sitzung statt. An diesen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Im Berichtsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat über den Kooperationsvertrag mit der Thin Materials AG beschlossen. Deren Vorstandsvorsitzender Herr Dr. Franz Richter war zu dieser Zeit zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich der Thin-Wafer-Prozessierung. Bei den Abstimmungen über den Vertrag hat sich Herr Dr. Franz Richter in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG enthalten. Im Übrigen gab es keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

Sitzungen und Beratungsschwerpunkte

Gegenstand regelmäßiger Beratungen im Aufsichtsrat waren die Auftrags-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns sowie die Finanzlage und die Investitions- und Desinvestitionsprojekte. Der Vorstand unterrichtete regelmäßig und umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weiterentwicklung, den Gang der Geschäfte sowie über die aktuelle Lage des Konzerns. Darüber hinaus wurde über Vorstandspersonalia entschieden. Der Aufsichtsrat hat sich außerdem mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagement-Systems befasst.

In der Sitzung am 6. Februar 2009 hat der Aufsichtsrat sich vorrangig mit dem Bericht des Vorstands zu den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal sowie des Geschäftsjahres 2008 befasst. Gegenstand der Diskussion waren insbesondere die Entwicklung der Marge und des Cashflows sowie Sondereffekte. Der vom Vorstand vorgelegten Planung für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach ausführlicher Erörterung, insbesondere der Themen Förderprojekte, Auslandsgesellschaften und Kostenstruktur, zugestimmt. Ferner beschäftigte sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung mit strategischen Projekten im Bereich des Thin Wafer Handlings. Der Vorstand stellte uns die Eckpunkte der beabsichtigten Zusammenarbeit mit der Thin Materials AG vor, die intensiv diskutiert wurden. Außerdem wurde über die intendierte Kooperation mit 3M berichtet.

In der Sitzung am 24. März 2009 billigte der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2008. Außerdem wurde Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung teil und informierte den Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Wir diskutierten mit den Vertretern des Abschlussprüfers Fragen der Bilanzierung sowie wesentliche Sachverhalte des abgelaufenen Geschäftsjahres und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Des Weiteren erläuterte der Abschlussprüfer die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2008 und zur aktuellen Geschäftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Des Weiteren haben wir mögliche Punkte der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 24. Juni 2009 erörtert. Der Vorstand berichtete über das Bonussystem für die Mitarbeiter im Jahr 2009. Die Vorgehensweise in Hinblick auf die Festlegung der Ziele für die variable Vergütung des Vorstands im Jahr 2009 wurde beschlossen. Außerdem wurde Beschluss über die variable Vergütung von Herrn Knopp und Herrn Dr. Schneidewind gefasst. In Hinblick auf die Ausgabe von Aktienoptionen im Jahr 2009 wurde die Vereinbarung einer zusätzlichen Ausübungshürde diskutiert. Wir ließen uns außerdem über die Implementierung der Projekte im Bereich Operations zur Verbesserung des Wareneinkaufs und der Lagerhaltung berichten. Im Anschluss an die Sitzung unterzogen wir uns der Effizienzprüfung gemäß Deutschem Corporate Governance Kodex.



Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender



In der außerordentlichen Sitzung am 8. April 2009 hat sich der Aufsichtsrat mit dem Rücktritt von Herrn Dr. Franz Richter und der sich daraus für die Hauptversammlung 2009 ergebenden Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds befasst. Er legte das Anforderungsprofil für den Nachfolger von Herrn Dr. Franz Richter fest. Des Weiteren fasste der Aufsichtsrat Beschluss über die Ausgabe von Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 an den Vorstand.

In der Sitzung am 30. April 2009 befasste sich der Aufsichtsrat mit den vorläufigen Finanzzahlen für das erste Quartal 2009 sowie dem vom Vorstand vorgelegten Gesamtjahresausblick 2009 und ließ sich die Abweichungen gegenüber der Planung erläutern. Wir fassten Beschluss über die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung. In Zusammenhang mit strategischen Projekten befassten wir uns mit dem möglichen Verkauf der Suss MicroTec Test Systems GmbH sowie einer angedachten weiteren Kooperation im Bereich Thin Wafer Handling.

In der Sitzung am 24. Juni 2009, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehmlich über die aktuelle Geschäftslage, insbesondere zu Auftragseingang und -bestand, informiert. Wir haben außerdem über die Höhe der variablen Vergütung für Herrn Christian Schubert für die Zeit seiner Zugehörigkeit zum Vorstand Beschluss gefasst.

Unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2009 wurde in einer weiteren Sitzung des Aufsichtsrats Herr Dr. Stefan Reineck zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Herr Jan Teichert zu seinem Stellvertreter gewählt. Der Vorstand berichtete über den Stand des Desinvestitionsprojekts der Suss MicroTec Test Systems GmbH und wurde gebeten, strategische Alternativen zu prüfen.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 6. Juli 2009 berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage und wir diskutierten mit dem Vorstand unterschiedliche Auftragseingangsszenarien und deren Auswirkungen. Der Vorstand berichtete über Aufbau und Ablauf des Finanzreporting sowie über die Funktionsweise des Risikomanagementsystems und wir diskutierten mit dem Vorstand weitere Optimierungen dieser Systeme. Außerdem berichtete der Vorstand über den Status der Kooperationen auf dem Gebiet der 3D-Integration. Zudem haben wir in dieser Sitzung mit dem Vorstand über die möglichen Optionen für organisatorische Änderungen innerhalb der SÜSS-Gruppe und für die Desinvestition des Geschäftsbereichs Test Systeme diskutiert. Schließlich haben wir den möglichen Erwerb der HamaTech APE mit dem Vorstand erörtert.

Themenschwerpunkte der Sitzung am 31. Juli 2009 waren die vorläufigen Finanzzahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2009 sowie der vorläufige aktualisierte Forecast für das Gesamtgeschäftsjahr. Darüber hinaus diskutierte der Aufsichtsrat wesentliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Konzerns und deren bilanzielle Behandlung. Der Vorstand informierte uns über Veränderungen im Bereich der IR-Aktivitäten. In Hinblick auf das Desinvestitionsprojekt Suss MicroTec Test Systems wurden wir über den Status informiert und haben nach ausführlicher Diskussion und Bewertung der Handlungsoptionen unsere Zustimmung zur weiteren Vorgehensweise erteilt. In Bezug auf die Akquisition der HamaTech APE berichtete der Vorstand über den Fortgang und die weiteren Schritte. Außerdem haben wir uns in dieser Sitzung mit der unternehmensinternen erweiterten Insider-Regelung befasst.

Die Struktur eines neuen variablen Vergütungssystems für den Vorstand haben wir in unserer Sitzung vom 28. September 2009 mit einem unabhängigen Vergütungsberater diskutiert und entwickelt. Der Vorstand unterrichtete über den Stand des Anfechtungsverfahrens gegen Beschlüsse der Hauptversammlung. Er informierte uns außerdem über die aktuelle Geschäftslage und berichtete über Aufbau und Funktion des Cash Management Systems. Ferner erstattete der Vorstand einen Bericht zum Status der Projekte Desinvestition Test Systeme und Erwerb HamaTech APE. Nach ausführlicher Erörterung stimmte der Aufsichtsrat der Fortführung der Gespräche sowie in Hinblick auf den Erwerb der HamaTech APE dem Abschluss eines Termsheets zu.

In der Sitzung am 3. November 2009 stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat die vorläufigen Finanzzahlen für das dritte Quartal sowie den Forecast für das Geschäftsjahr 2009 vor. Wir diskutierten mit dem Vorstand über die Situation und Perspektiven in den einzelnen Segmenten und wurden über den Fortgang des Projekts im Bereich Operations zur Verbesserung des Wareneinkaufs und der Lagerhaltung informiert. Wir diskutierten mit dem Vorstand dessen Präsentation zur Strategie im Bereich Coater. Außerdem berichtete der Vorstand über den Status des Akquisitionsprojekts HamaTech APE. Nach intensiver Diskussion der Rahmenbedingungen stimmten wir der Fortführung der Verhandlungen zu. Auf der Grundlage eines Statusberichts zur geplanten Veräußerung des Bereichs Test Systeme und nach Erörterung der Vor- und Nachteile stimmten wir auch hier der Fortsetzung der Verhandlungen zu. Der Aufsichtsrat fasste ferner Beschluss über die Verlängerung der Bestellung von Herrn Michael Knopp, dessen Amtszeit am 31. Juli 2010 ausgelaufen wäre, bis zum 31. Juli 2015 sowie über den Abschluss eines neuen Dienstvertrages mit Herrn Michael Knopp für diesen Zeitraum sowie über Nachträge zu den Dienstverträgen für die laufende Bestellungsperiode von Herrn Michael Knopp und Herrn Frank Averdung. Der Aufsichtsrat fasste ferner Beschluss über die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG.

Breiten Raum nahmen die Beratungen zu den bereits erwähnten Investitions- und Desinvestitionsprojekten in der Sitzung am 3. Dezember 2009 ein. Nach Diskussion des Termsheet-Entwurfs, der erwarteten Synergien sowie der möglichen Auswirkungen des Erwerbs der HamaTech APE auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage stimmte der Aufsichtsrat dem Abschluss eines Termsheet sowie der Aufnahme von Kaufvertragsverhandlungen zu. In Bezug auf den Verkauf des Geschäftsbereichs Test Systeme stimmte der Aufsichtsrat weiteren Verhandlungen über ein Termsheet mit Cascade Microtech und anschließenden Kaufvertragsverhandlungen zu. Auf Grundlage eines ausführlichen Berichts des Vorstands haben wir ferner über über die vorläufige Planung für das Geschäftsjahr 2010 sowie die zweijährige Cashflow Planung beraten.

Gegenstand der Sitzung am 23. Dezember 2009, die in Form einer Telefonkonferenz stattfand, waren Beratungen im Hinblick auf die geplante Akquisition der HamaTech APE. Der Vorstand stellte uns den Entwurf des Unternehmenskaufvertrags vor. Nach Diskussion der damit zusammenhängenden Fragen und Erörterung der Post-Merger-Integration der HamaTech APE in die SÜSS-Gruppe stimmten wir dem Erwerb der HamaTech APE zu. In Bezug auf den geplanten Verkauf des Geschäftsbereichs Test Systeme berichtete der Vorstand über den Stand der Vertragsverhandlungen. Der Vorstand berichtete außerdem über die aktuelle Geschäftslage.



Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäftsjahr 2009 mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zu Corporate Governance im Unternehmen sowie den ausführlichen Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im separaten Corporate Governance Bericht auf den Seiten 32 ff. des Geschäftsberichts wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihren Sitzungen am 3. November 2009 die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. In Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Empfehlungen des Kodex haben wir uns eingehend mit dem Vergütungssystem für den Vorstand befasst. Ferner hat der Aufsichtsrat festgestellt, dass ihm eine nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder angehört.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den nach HGB-Grundsätzen aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2009 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2009 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 23. März 2010 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte sowie Kosten der Abschlussprüfung ein.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht wurden von uns geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

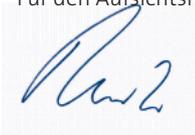
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2009 hat Herr Dr. Franz Richter sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Sein Rücktritt erfolgte im Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte, die sich aus seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG und Vorstandsvorsitzender der Thin Materials AG, Eichenau, hätten ergeben können, nachdem beide Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kooperation eingegangen waren, ohne dass SÜSS MicroTec dabei weitere Kooperationen auf dem Gebiet der Dünn-Wafer-Handhabung („Thin Wafer Handling“) ausgeschlossen hat. Als Nachfolger für den seit 19. Juni 2008 im Amt befindlichen Herrn Dr. Franz Richter wurde für den Rest der ursprünglichen Amtszeit Herr Sebastian Reppegather gewählt.

Zum 1. Februar hat Herr Frank Averdung sein Amt als Vorstandsvorsitzender angetreten. Er war durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25. November 2008 bestellt worden. Herr Christian Schubert, der am 2. Oktober 2008 zum Interims-vorstand bestellt worden war, ist zum 31. Mai 2009 aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Bestellung von Herrn Michael Knopp wurde bis zum 31. Juli 2015 verlängert.

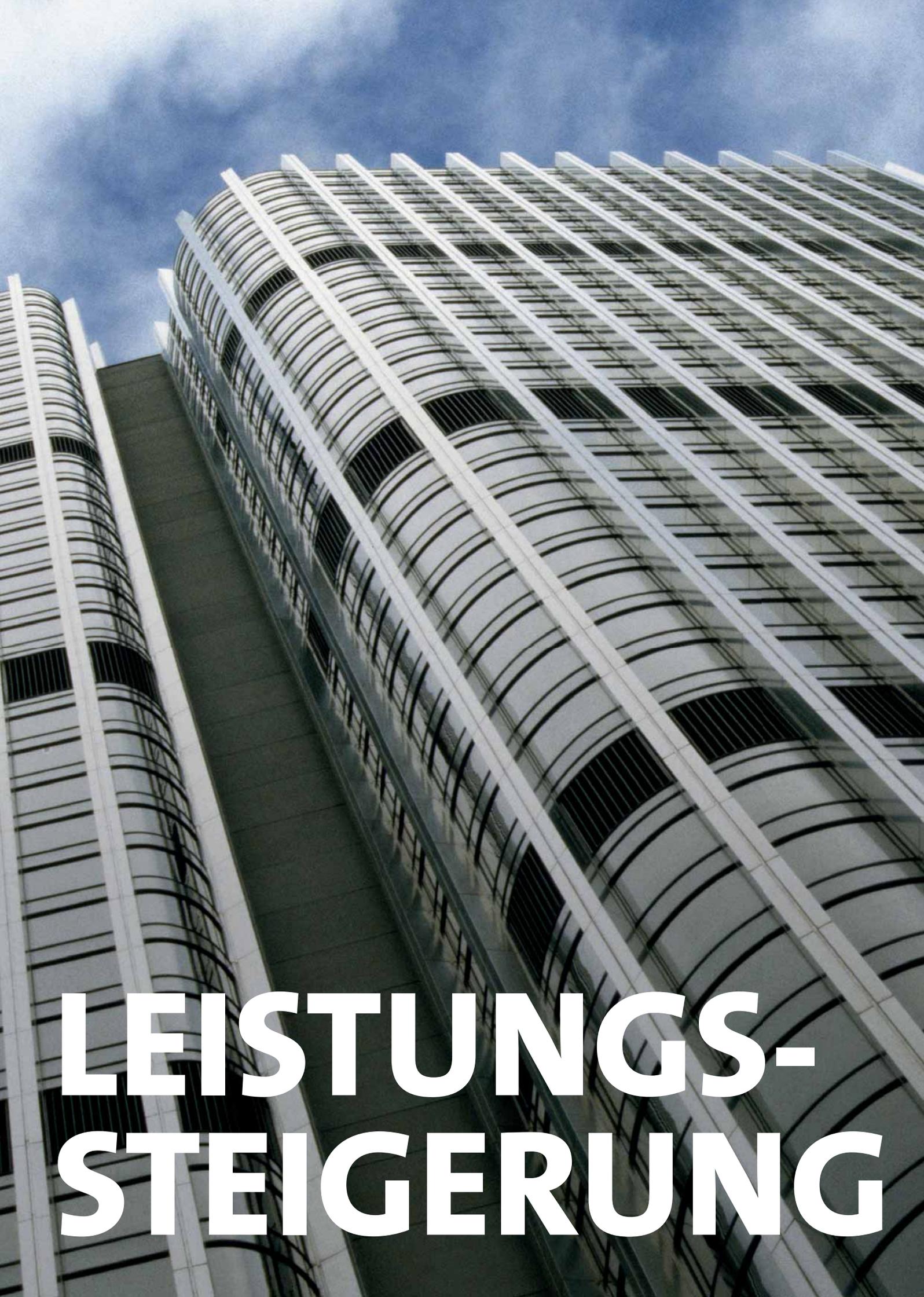
Unser persönlicher Dank gilt den ausgeschiedenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für ihre wertvollen Beiträge zum Unternehmenserfolg. Darüber hinaus bedanken wir uns bei den Vorständen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretungen für ihr persönliches Engagement und die in einem schwierigen Umfeld geleistete Arbeit.

Garching, 23. März 2010

Für den Aufsichtsrat:

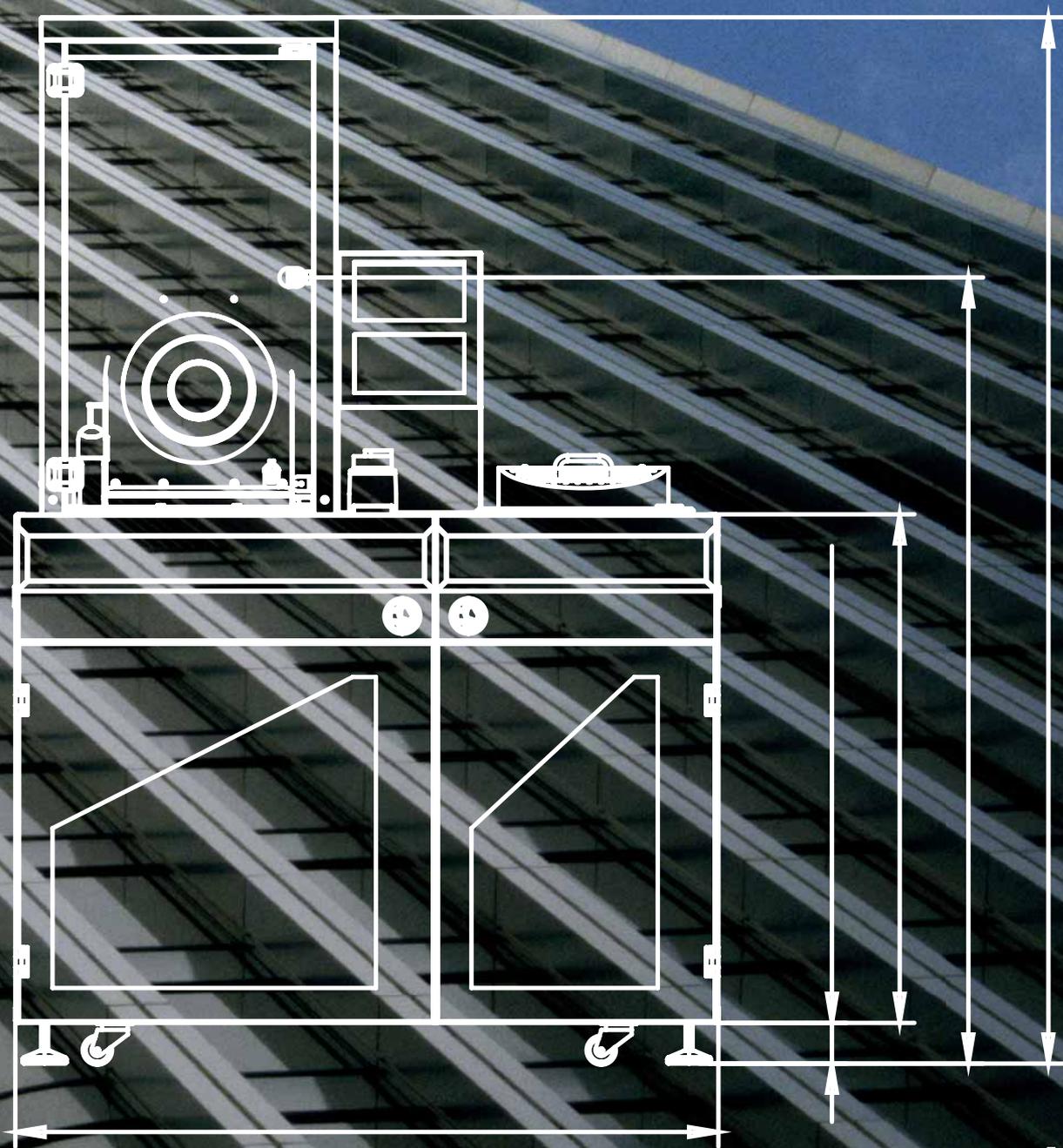


Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender



**LEISTUNGS-
STEIGERUNG**

Mehr Leistung auf geringerem Raum?
Die Halbleiterbranche hat die dritte Dimension für sich
entdeckt und arbeitet in Anlehnung an moderne Stadtarchitektur
zunehmend an der Umsetzung dreidimensionaler Chipdesigns.





MORE THAN MOORE

Die Nachfrage nach immer leistungsfähigeren und dabei schlankeren, leichteren mobilen Endgeräten ist nach wie vor ungebrochen. Während Halbleiterhersteller vormals dem Konflikt aus geringerem Platzangebot bei gleichzeitig gesteigerten Leistungs- und Komplexitätsanforderungen mit der Verringerung der Strukturgrößen begegnet sind, sehen Branchenexperten in der dreidimensionalen Systemintegration ein Fertigungsverfahren, das zukunftsweisend für die Halbleiterindustrie sein wird.

Gordon Moore, einer der Mitgründer von Intel, formulierte im Jahr 1965 das heute als „Moore’s Law“ bekannte Gesetz, wonach sich die Komplexität integrierter Schaltkreise alle zwei Jahre verdoppeln sollte. Bis heute hat Moore mit seiner These Recht behalten. Seit Mitte der sechziger Jahre wird die Leistungssteigerung in der Halbleiterindustrie durch die Skalierung von Bauelementen, also durch die Verringerung der Strukturgrößen, erreicht. Die Skalierung der integrierten Schaltkreise war über lange Zeiträume nicht nur technologisch möglich, sondern vor allem auch ökonomisch sinnvoll, denn die Leistungsverdoppelung ging mit einem unterproportionalen Kostenanstieg einher. Die anhaltende

Nachfrage nach immer leistungsfähigeren und dabei schlankeren und leichteren mobilen Endgeräten stellt die Halbleiterhersteller vor die Herausforderung, Leistungssteigerungen auf immer geringerem Raum zu realisieren. Dieser Miniaturisierung sind jedoch zunehmend Grenzen gesetzt. Mit Strukturgrößen von aktuell 45nm (Nanometer) ist die Branche heute bereits an einem Punkt angelangt, von wo aus weitere Strukturverkleinerungen sich nur mit aufwendigen und extrem teuren Lithografieverfahren, wie dem Immersionsverfahren und der EUV-Lithografie (Extrem-Ultraviolett-Lithografie), erreichen lassen.

LEISTUNGSPAKET MIT ZUKUNFT

Mittels dreidimensionaler Fertigungsverfahren werden großflächige Bauteile in kleine mehrdimensionale und multifunktionale Bauelemente verwandelt. Die vormals auf einer Ebene angeordneten Chips eines Bauteils werden dazu in mehreren Ebenen übereinander gestapelt und miteinander verbunden. Der große Vorteil der 3D-Integration liegt dabei in der Möglichkeit, nicht nur homogene digitale Produk-

te wie Speicher und Computerprozessoren miteinander zu kombinieren, sondern zukünftig auch sämtliche, auf Halbleitersubstraten hergestellte heterogene Produkte wie Sensoren, Signalprozessoren und Optikelemente vertikal integrieren zu können. Ein weiterer Pluspunkt dieses Verfahrens ist es, dass die unterschiedlichen Bauteile dazu im Vorfeld unabhängig voneinander in den für sie optimalen

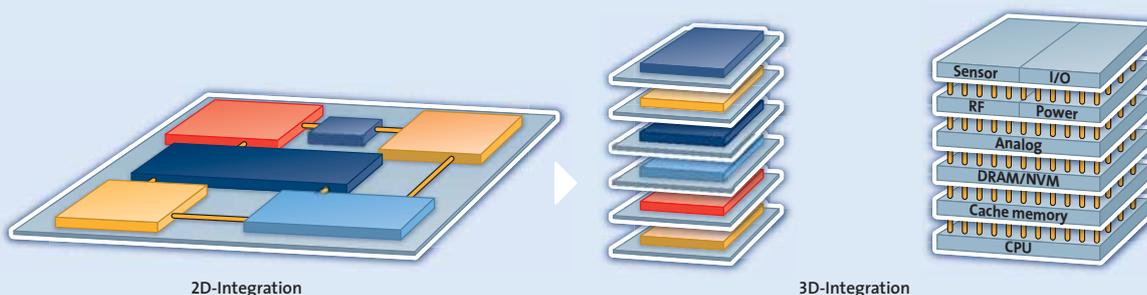
und etablierten Herstellungsprozessen gefertigt werden können. Die Komplexitäts- und Leistungssteigerung resultiert dabei insbesondere aus den wesentlich geringeren Entfernungen, die die Signale dank der Stapelung im Bauteil nunmehr überwinden müssen.



www.suss.com/markets

Auf der Suche nach alternativen Lösungen haben Halbleiterhersteller daher in Anlehnung an moderne Stadtarchitektur dreidimensionale Chipdesigns entworfen. Während in der Stadtplanung auf begrenzter Fläche möglichst viel Wohn- und Arbeitsraum geschaffen werden muss, steht die Halbleiterindustrie vor der Aufgabe, auf knappem Raum möglichst viele Funktionen zu vereinen. Das Stapeln von Mikrochips in die dritte Dimension (Z-Ebene) ermöglicht die Herstellung von leistungsfähigeren Komponenten auf Grundlage etablierter fotolithografischer Technologien und Bondverfahren. Da das Stapeln von herkömmlichen Chips aufgrund der damit ansteigenden Höhe allein noch zu keinen Platzeinsparungen führt, müssen die einzelnen Chips vor ihrer vertikalen Montage zusätzlich gedünnt werden. So wird sichergestellt, dass das dreidimensionale Bauteil die Höhe eines einzelnen einlagigen Bauteils nicht übersteigt. Die so hergestellten kleineren Komponenten sind nicht nur schneller, sie verbrauchen auch weniger Energie und erfüllen damit die Anforderungen für den Einsatz in moderner Verbraucherelektronik wie Smartphones, Navigationsgeräten und anderen mobilen Anwendungen. Die Komplexitäts- und Leistungssteigerung resultiert dabei insbesondere aus den wesentlich geringeren Entfernungen, die die Signale im Bauteil nunmehr überwinden müssen. Vergleicht man die Signalübertragung von nebeneinander angeordneten Chips und Komponenten mit denen übereinander

gestapelter, so entspricht dies in etwa einem durchschnittlichen Golfer, der vormals ein Loch direkt aus 10 km Entfernung vom Abschlag aus treffen musste, während er heute lediglich einputten muss. Die Leistungssteigerung hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit ist dabei vergleichbar mit einer Flugzeitverkürzung auf der Strecke Tokio-New York von knapp 14 Stunden auf circa fünf Minuten. Unter dem in der 3D-Integration verwendeten Schlagwort „More than Moore“ verbirgt sich zudem der Hinweis auf die geradezu unendlichen Möglichkeiten, die die dreidimensionale Systemintegration bietet. So können nicht nur gleichartige, sondern erstmals auch heterogene Bauteile zu einem 3D-Paket zusammengepackt werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Handykamera. Während vor rund zehn Jahren eine Handykamera ein Luxus war, über den nur wenige Mobiltelefone verfügten, ist es heute dank der 3D-Verfahren technisch möglich, Linsen, Halter, Blenden und Bildsensoren in eine kompakte Wafer-Level-Kamera zu integrieren. Die so erzielte Miniarisierung des Bauteils erleichtert nicht nur die Integration in das Endprodukt, das neue Herstellungsverfahren hat darüber hinaus auch zu einer wesentlichen Kostenreduzierung geführt, so dass heute nahezu jedes Mobiltelefon über eine Kamera- und Videofunktion mit hoher Bildauflösung, GPS-basierter Bildstabilität sowie integriertem Xenon-Blitzlicht verfügt.



2D-Integration

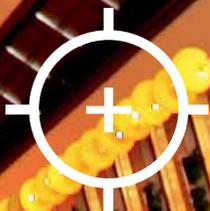
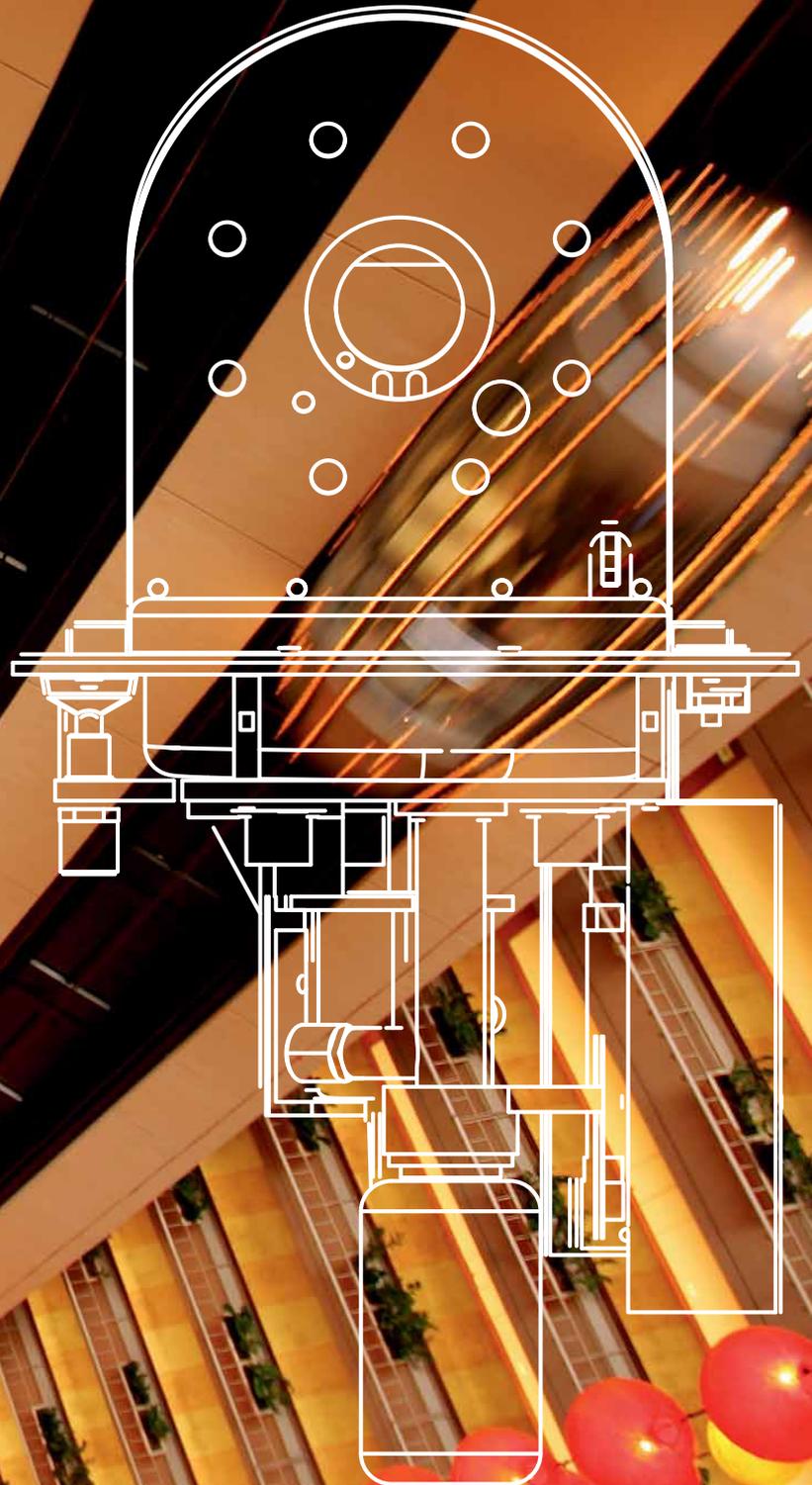
3D-Integration



KOMPLEXITÄT

+++++

Mehr Funktionen unter einem Dach reduzieren unnötige Wege.
In moderner Verbraucherelektronik werden mittlerweile ganz
unterschiedliche Funktionen auf kleinstem Raum gebündelt.





FERTIGUNG IN DER DRITTEN DIMENSION

Die wesentliche Stärke der dreidimensionalen Integrationsverfahren liegt in der Vielzahl möglicher Fertigungsprozesse sowie in der Option, neben homogenen Komponenten auch unterschiedliche Arten von Bauelementen zu einem 3D-Paket zusammenfügen zu können. Dabei kann in weiten Teilen des Fertigungsprozesses auf bereits etablierte fotolithografische Technologien und Bondverfahren zugegriffen werden.

Die 3D-Integration lässt sich generell als ein Bau- und Montagestil beschreiben, der die Herstellung und den Aufbau von Mikrokomponenten zu effizienteren, leistungsfähigeren Bauteilen ermöglicht. Durch die 3D-Integration werden großflächige Bauteile in kleine mehrdimensionale und multifunktionale Bauelemente verwandelt. Dabei werden die vormals auf einer Ebene angeordneten Chips eines Bauteils in nun mehreren Ebenen übereinander angeordnet. Analogien zu diesem Prinzip finden sich auch im täglichen Leben in Form multifunktionaler Hochhäuser: In den unteren Stockwerken befinden sich Banken und Einzelhandelsgeschäfte, die mittleren Etagen beherbergen Arztpraxen und Kanzleien, während oben Restaurants und Wohnungen angesiedelt sind.

Die 3D-Fertigung beginnt bereits mit dem Designentwurf des einzelnen Bauelements. Dessen Strukturaufbau muss geändert werden, damit die Vorteile der später angestrebten Schichtbauweise optimal genutzt werden können. Eine der wichtigsten Änderungen in dieser Entwurfsphase betrifft die Leiterbahnen. Zuvor wurden diese zu den Rändern der Chips hingeleitet und zum Schluss durch kleine Drähte mit den anderen Komponenten des Bauteils verbunden. Diese Leiterbahnen müssen nunmehr vertikal durch die einzelnen Schichten des Bauelements verlaufen, ähnlich einem Fahrstuhl, der alle Etagen eines mehrstöckigen Hauses miteinander verbindet. Je nach Design unterscheidet man in der 3D-Integration

zwischen verschiedenen Verfahren: dem 3D-Stacking, dem 3D-Packaging und dem 3D-Interconnect. Bei der einfachsten Form, dem 3D-Stacking, werden die betreffenden Bauteile auf herkömmliche Weise gefertigt, gestapelt und mittels Drähten (engl. Wire-Bonding) untereinander sowie mit der Leiterplatte verbunden. Diese Technik wird bereits seit längerem in der Massenproduktion eingesetzt. Allerdings ist das Verdrahten der einzelnen Komponenten untereinander mühsam, zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig.

Beim 3D-Packaging werden noch auf Wafer-Ebene kleine Löt Kügelchen (engl. Bumps) auf der Unterseite des Bauelements aufgebracht. Diese dienen als Kontakte zur Umwelt des Mikrochips. Die so gebumpten Bauelemente werden dann vertikal, eines über dem anderen, montiert. Komplexe Drahtführungen und -verteilungen können so vermieden werden. Gleichzeitig benötigen auf diese Weise gefertigte Bauelemente weniger Platz und die Fertigungszeit reduziert sich wesentlich. Diese Faktoren tragen maßgeblich zur Reduktion der Herstellungskosten bei. Die vertikale Signalverteilung wird dabei durch 3D-Interconnect-Verfahren mittels durchgehender Kontakte, so genannter Through-Silicon-Vias (TSVs), sichergestellt, die die einzelnen Ebenen miteinander verbinden. TSVs lassen sich auf wirtschaftliche Weise mittels herkömmlicher Lithografie und innovativer Ätz- bzw. Metallfülltechniken in die Bauelemente integrieren. Die Vielzahl an möglichen Fertigungsverfahren ist die wesentliche Stärke der dreidimensionalen Systemintegration.

Neben homogenen Komponenten lassen sich so auch unterschiedliche Arten von Bauelementen, wie zum Beispiel Sensor- und Mikrochips, zu einem 3D-Paket zusammenbauen. Diese Bauteile werden häufig an verschiedenen Standorten oder in unterschiedlichen Fabriken sowie mitunter auf unterschiedlichen Wafergrößen gefertigt.

Der große Vorteil der 3D-Integration liegt daher vor allem darin, unterschiedlichste Bauteile unabhängig voneinander in den für sie optimalen Prozessen zu fertigen und später mittels genannter 3D-Verfahren miteinander zu verbinden.

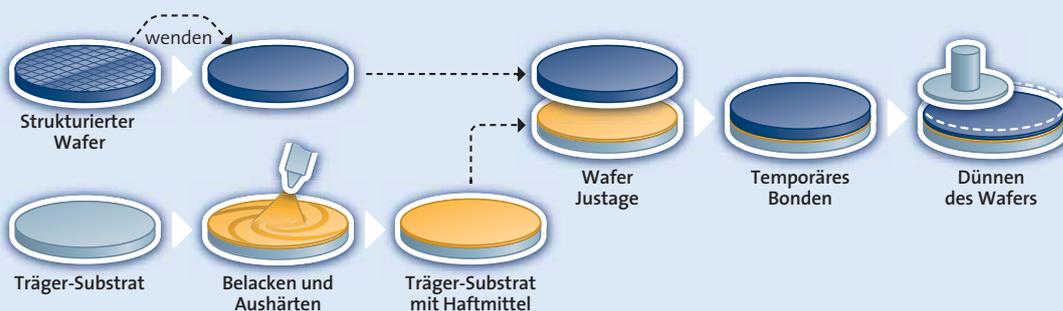
THIN WAFER HANDLING

Um mittels der dreidimensionalen Chipfertigung Platzeinsparungen zu realisieren, darf ein 3D-gefertigtes Bauteil die Höhe eines einlagigen Bauelements nicht übersteigen. Zu der Schlüsseltechnologie, die die 3D-Integration erfordert, zählt daher das Dünnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser äußerst fragilen Substrate („Thin Wafer

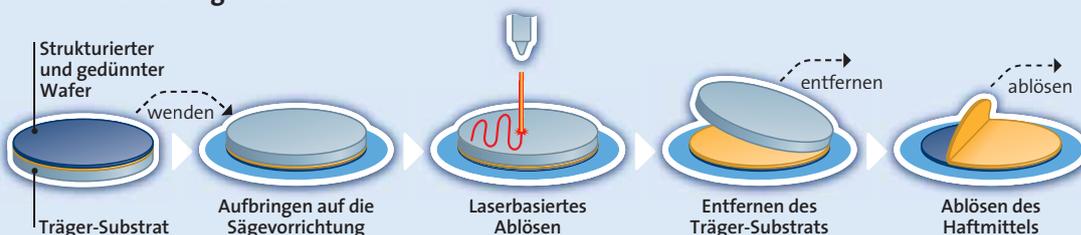
Handling“). Das Dünnen der Wafer vor oder nach einem Stapelvorgang ist ein derzeit noch in der Entwicklung befindlicher Prozessschritt, der von hoher Bedeutung für den Fertigungsprozess ist. Für das Dünnen muss der Wafer mit der bereits strukturierten Seite zu einem Träger-Substrat, zum Beispiel einem Glasträger, ausgerichtet und an ihm mittels tempo-

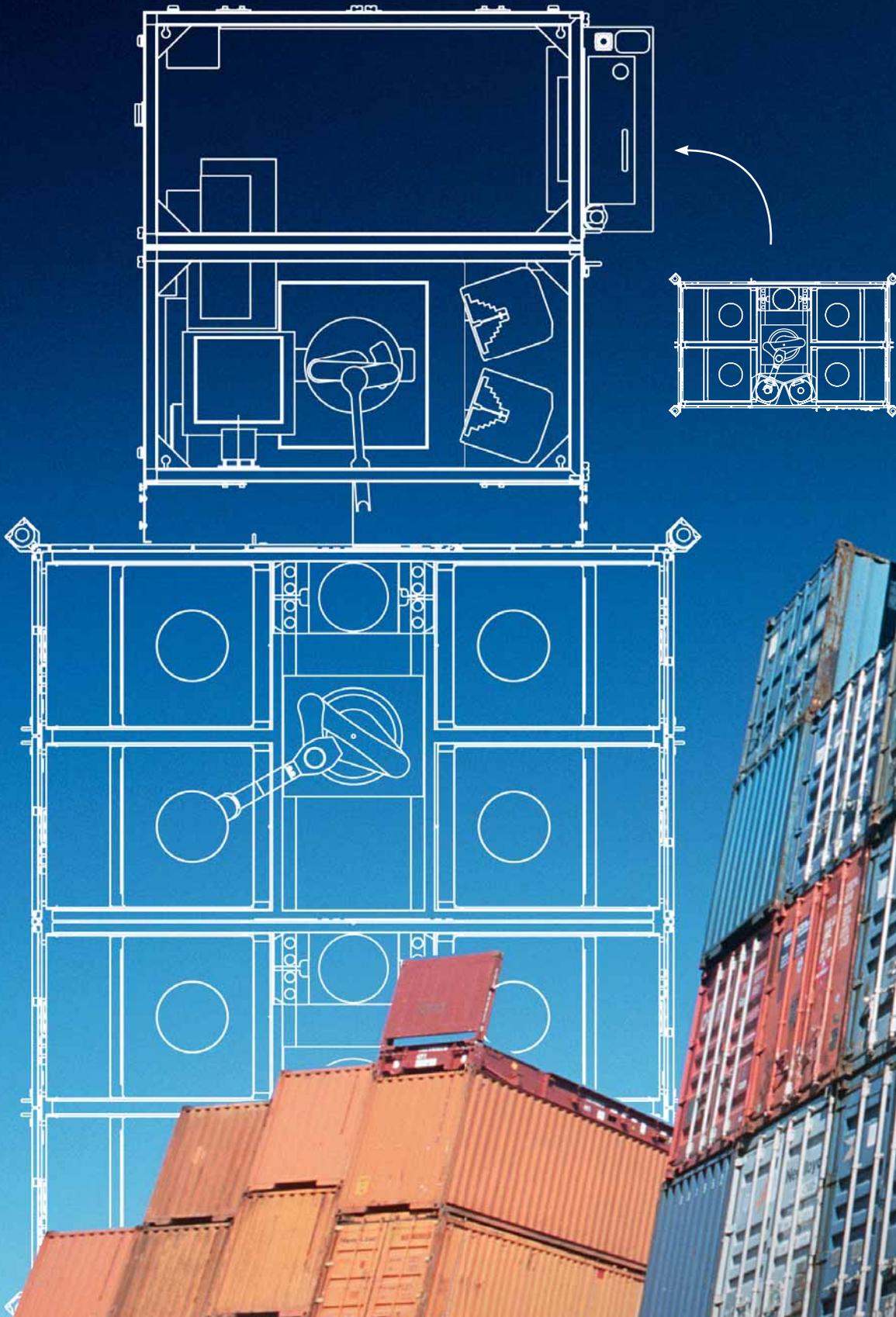
rärer Bondmethoden befestigt werden. Anschließend wird die rohe, unbehandelte Rückseite des Wafers abgeschliffen, bis dieser lediglich in etwa die Stärke eines Blatt Papiers besitzt. In einem weiteren Schritt gilt es den gedünnten Wafer von seinem Trägersubstrat abzulösen (Debonden), ohne dass dabei die bereits aufgebraachten Strukturen zerstört werden.

Temporäres Bonden und Dünnen eines Wafers



Debonden eines gedünnten Wafers





PRÄZISION



Die Fertigung dreidimensionaler Chipstrukturen erfordert höchste Präzision. Die Ausrichtung der Bauteile zueinander findet dabei im Mikrometer-Bereich statt, das entspricht in etwa dem Durchmesser eines menschlichen Haares.





ANWENDUNGSBEREICHE DER 3D-INTEGRATION

Die dreidimensionale Systemintegration findet bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Produktion weniger Bauteile Anwendung. Bestes Beispiel dafür, dass es sich bei 3D-Fertigungsverfahren nicht um reine Zukunftsmusik handelt, ist die Wafer-Level-Kamera, wie sie in Mobiltelefonen eingesetzt wird. In ihr vereinen sich State-of-the-art-Prozesse aus der MEMS und der Chipfertigung zu einem funktionsfähigen Kameramodul von der Größe eines Fingernagels.

Das vielleicht populärste Beispiel für die Anwendung von 3D-Technologien in der Halbleiterfertigung ist das iPhone von Apple. Die Forderungen der Verbraucher nach Mobiltelefonen, die über zusätzliche Funktionen wie GPS, Spiele, Video, Internetzugang, Kalender und E-Mail verfügen, haben auf Seiten der Halbleiterhersteller zu enormen Entwicklungsanstrengungen und bahnbrechenden technologischen Errungenschaften geführt. Der vertikalen Systemintegration ist es dabei zu verdanken, dass heute hochfrequente Signalverarbeitung, Bildsensoren, Speicher, Beschleunigungsmesser, Gyroskope (Kreiselinstrumente) und vieles mehr auf einer einzigen kleinen, dünnen Leiterplatte miteinander vereint werden und damit ein schlankeres, kompaktes Produktdesign umgesetzt werden kann.

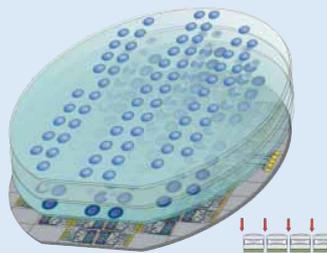
Der große Vorteil der 3D-Integration liegt dabei in der Möglichkeit, nicht nur homogene digitale Produkte wie Speicher und Computerprozessoren in einem einzelnen Stapel zu kombinieren, sondern auch sämtliche, auf Halbleitersubstraten hergestellte heterogene Produkte wie Sensoren, Signalprozessoren und Optikelemente vertikal zu integrieren. Die 3D-Fertigungsverfahren erlauben dabei die getrennte Herstellung der jeweiligen Bauteile in den für

sie optimalen Prozessen. Anschließend werden die unterschiedlichen Komponenten mittels 3D-Montage- und Verbindungs-Technologie in einem Paket zusammengeführt. Im Ergebnis entstehen so kleinere, leistungsfähigere Bauelemente zu marginal höheren Herstellungskosten. Zu den aktuell bereits in der Produktion befindlichen Bauteilen, die mit 3D-Technologien gefertigt werden, zählen Speicher- und IC-Anwendungen sowie CMOS-Bildsensoren und MEMS-Bauteile.

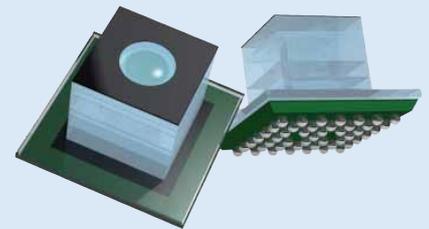
CMOS-Bildsensoren, wie sie in Handykameras eingesetzt werden, stellen beispielsweise einen besonders hochvolumigen Markt für die 3D-Integration dar. Sie waren auch die ersten 3D-Bauelemente, die mittels 3D-Verfahren in der Massenproduktion gefertigt wurden. Eine Handykamera besteht beispielsweise aus zehn bis 20 verschiedenen Komponenten, wie Polymer- oder Glaslinsen, Blenden, Filtern, Aktuatoren, Haltern, Tubus und Bildsensoren. Diese Komponenten werden jeweils einzeln gefertigt und im Anschluss daran auf Wafer-Ebene zusammengesetzt. In einem ersten Schritt werden dazu die Linsen übereinander montiert und mit dem Bildsensor verbunden, bevor dieser Stapel mit dem digitalen Rechenchip zusammengeführt wird. Dies ist die Voraussetzung, um das optische Signal in ein elektrisches Signal umzuwandeln, welches nunmehr als Bilddatei ausgelesen werden kann.

HALBLEITERTECHNIK FÜR BESSERE MOBILTELEFON-KAMERAS

Die derzeitige Fertigung von Kameras für Mobiltelefone ist noch immer von aufwendigen manuellen und halbautomatischen Arbeitsschritten geprägt. Eine Mobiltelefon-Kamera besteht aus bis zu 20 verschiedenen Komponenten, die alle einzeln gefertigt und dann zusammengesetzt werden. Die Montage stellt daher einen wesentlichen Kostenfaktor innerhalb der Fertigung dar. Um die Herstellungs- und Montagekosten zu reduzieren und die Qualität der Kameras zu verbessern, wird seit einigen Jahren versucht, die Optik auch in Wafer-Technologie herzustellen – mit Erfolg. Mittels Mikrolinsen-Imprint-Lithografie werden Polymerlinsen auf Glaswafern doppelseitig geprägt. Diese Linsenwafer werden dann mit einem Mask Aligner in Sub-Mikrometer-Präzision übereinander montiert und anschließend vereinzelt. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Kameramodule mit dem CMOS-Bildsensor zusammengeführt.



Aufbau von Wafer-Level-Kameramodulen



Fertige Wafer-Level-Kameras nach ihrer Vereinzlung und Montage auf dem CMOS-Bildsensor

Insgesamt betrachtet ist der CMOS-Bildsensor einer der größten Erfolge der 3D-Integration. In ihm vereinen sich State-of-the-art-Prozesse aus der MEMS und Chipfertigung mit dem Ergebnis, Kameramodule von der Größe eines Fingernagels zu produzieren.

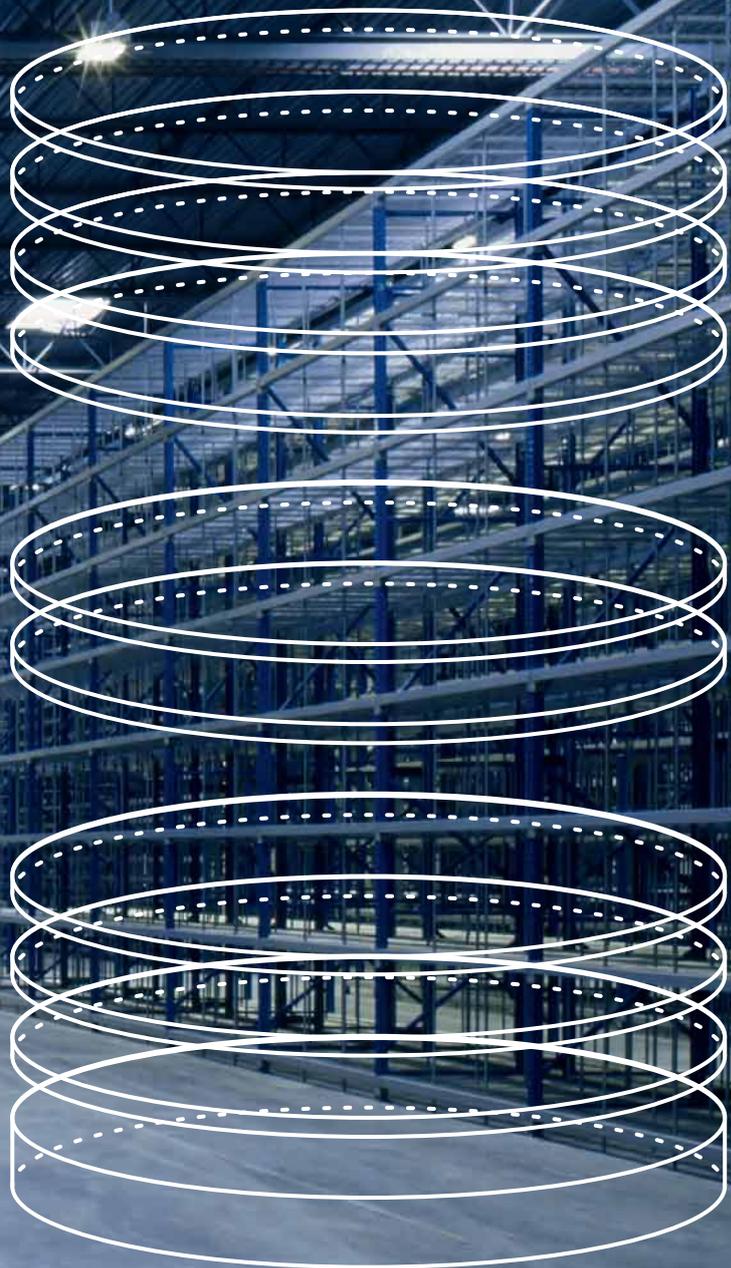
Die 3D-MEMS sind Bauelemente, die mikromechanische oder mikrooptische Bauelemente mit mikroelektronischen Schaltungen in einem kompakten System miteinander vereinen. Der Markterfolg dieser kleinen, von Haus aus dreidimensionalen Sensoren basiert auf ihrer vielfältigen Einsatzfähigkeit. Ihre Anwendungen reichen von

der Automobilindustrie über die Medizintechnik bis hin zu Verbraucherelektronik, wo die kleinen Bauteile als Bildstabilisatoren in Kameras oder als Spielcontroller in Spielkonsolen Einzug erhalten haben. Spielkonsolen wie die Nintendo Wii verwenden MEMS-Bauteile wie Beschleunigungsmesser und Gyroskope, um interaktive Sportwettkämpfe, Trainingsprogramme und Fantasy-Spiele zu realitätsnahen Erlebnissen zu machen.



EFFIZIENZA

Geballte Leistung auf knappsten Raum:
Dank innovativer Prozesstechnologien kann heute ein drei-
dimensional gefertigtes Bauteil die gleiche Höhe erreichen
wie zuvor ein einlagiges System. Das ermöglicht eine höchst
effektive Bündelung von Funktionen.





EQUIPMENT UND PROZESSLÖSUNGEN MADE BY SÜSS MICROTEC

SÜSS MicroTec verfügt bereits heute über ein Produktportfolio, das wesentliche Prozessschritte innerhalb der 3D-Integration abdeckt. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit namhaften Partnern aus Industrie und Wissenschaft unsere Systeme zu einer Plattform ausbauen, die geeignet ist, die derzeit vorangetriebenen, unterschiedlichen Prozesslösungen und -abläufe gleichermaßen umzusetzen.

Angesichts der größeren Leistungsfähigkeit und der geringen Kosten, die mit den 3D-Verfahren einhergehen, betrachten viele Experten die 3D-Integration als Wendepunkt in der hochvolumigen Herstellung von Bauelementen. Wie bei anderen Schlüsseltechnologien sind auch hier die Prozessabläufe anfänglich zahlreichen und stetigen Veränderungen unterworfen. Einigkeit über die Prozesse und deren Standardisierung stecken noch in den Kinderschuhen. „Best Known Methods“ und wissenschaftlich dokumentierte Abläufe werden dringend benötigt, um die mit der Entwicklung einhergehenden Risiken zu senken und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Das Produktportfolio von SÜSS MicroTec umfasst bereits Systeme für alle kritischen Produktionsschritte der 3D-Integration. Die Stärke von SÜSS MicroTec liegt dabei in der hohen Flexibilität seiner Produktionssysteme, deren austauschbare Module mit wenig Aufwand an kundenspezifische Entwicklungsprozesse angepasst werden können. Die Vorteile für den Kunden liegen dabei auf der Hand: Bei der Prozessentwicklung tragen kurze Umrüstzeiten maßgeblich zur Kostensenkung bei der Arbeit an Prototypen und bei Testproduktionen bei. Auch bei Auftragsfertigung in Asien, die für die Herstellung ihres vielfältigen Produktangebots unterschiedliche Wafergrößen und Materialien einsetzen, ist die Flexibilität ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der SÜSS MicroTec Systeme.

Mit der zweiten Generation des MA300 ist es SÜSS MicroTec gelungen, einen Produktions-Mask Aligner zum Prozessieren großer 300mm Wafer für den Bereich 3D-Integration zu etablieren, wie er unter anderem für die Strukturierung von Through Silicon Vias (TSVs) eingesetzt wird. Bei diesen winzigen, durch das Silizium geführten Leiterbahnen, die vertikal miteinander verbundene, gestapelte dreidimensionale Schaltkreise ermöglichen, spielt die Positioniergenauigkeit eine wesentliche Rolle. Der MA300 Gen2 wurde deshalb mit einer für die aktuellen dreidimensionalen Anwendungen optimierten,

Die ACS300 Gen2



hochpräzisen Justiereinheit ausgestattet, die neben der Verarbeitung von beidseitig strukturierten Wafern auch das Prozessieren von intransparenter, aber Infrarot-durchlässiger Materialien ermöglicht. Dank seiner hohen Präzision auch unter schwierigsten Bedingungen und seinem konkurrenzlos hohen Durchsatz ist der MA300 Gen2 dabei, sich einen festen Platz in der Fertigung von 3D-integrierten Bauteilen zu erobern.

Mit der ACS300 Gen2, einer Produktionsmaschine zum Belacken, Entwickeln und Aushärten von lichtempfindlichem Material, kann SÜSS MicroTec eine weitere Anlage für die 3D-Integration anbieten. Die ACS300 Gen2 hat sich mittlerweile bei einer Reihe von führenden Chipherstellern und Auftragsfertigern erfolgreich gegen die Konkurrenz behaupten können. Neben ihrem hohen Durchsatz und einer geringen Stellfläche verfügt die neue Maschine über eine für 3D-Anwendungen optimierte, hochpräzise 6-Achs-Robotereinheit sowie ein kamerabasiertes Zentriersystem. Damit ist die ACS300 Gen2 auch in der Lage, schwere, auf Träger gebundene Substrate, wie sie in der 3D-Integration verwendet werden, präzise zu verarbeiten.

Im Bereich der Bondsysteme bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder für bis zu 300mm Wafern, die Ausgangsplattform für die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration: das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden. Die Bondjustage erfolgt dabei stets im Submikron-Bereich. Im Jahr 2009 hat SÜSS MicroTec mit mehreren namhaften Herstellern Kooperationen hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung von temporären Bond- und Debondlösungen sowie zur Handhabung von gedünnten Wafern abgeschlossen. Ziel dieser Kooperationen ist es, die SÜSS-Systeme zu einer Plattform auszubauen, die geeignet ist, die von den verschiedenen Partnern entwickelten Prozesslösungen gleichermaßen umzusetzen, um damit auch zukünftig den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen optimal Rechnung tragen zu können.

TSV-FERTIGUNG MIT LITHOGRAFIESYSTEMEN VON SÜSS

Eine Schlüsseltechnologie, die das 3D-Interconnect-Verfahren erfordert, ist die Herstellung von Durchkontaktierungen, so genannten Through Silicon Vias, die die einzelnen Ebenen eines 3D-Bauteils miteinander verbinden. Wesentliche Schritte des Fertigungsprozesses von TSVs sind das Ätzen und das anschließende Füllen der vertikalen Leiterkanäle. Generell lassen sich TSVs entweder zu Beginn der Wafer-Herstellung („Frontend“-Prozesse) oder zu

einem späteren Produktionszeitpunkt („Backend“-Prozesse) integrieren. Aus diesem Grund haben sich die Ausdrücke Via First- und Via Last-Prozessierung im Jargon der Halbleiterindustrie etabliert. Bevor die Vias in das Silizium geätzt werden können, wird die Ätzmaske mittels Belackung, Justage und Belichtung hergestellt. Für diese Prozessschritte werden die hochpräzisen Mask Aligner und Coater von SÜSS MicroTec erfolgreich eingesetzt.

Das automatische Belackungs- und Entwicklungssystem ACS300 Gen2 ermöglicht beispielsweise die gleichzeitige Verarbeitung von 200mm- und 300mm-Wafern ohne zeitaufwendigen, mechanischen Umbau und kann je nach Bedarf mit Prozessmodulen zur Aufbringung eines Haftvermittlers mittels Spin- oder Sprühtechnologie ausgestattet werden. Die Anlage wurde für den gleichmäßigen Auftrag dünner sowie dicker Lackschichten als

auch zur Verteilung fotosensitiver Polymere in einer Dicke von unter 1 µm bis über 100 µm konzipiert. Die ACS300 Gen2 ermöglicht eine flexible Produktionsplanung von der Forschung und Entwicklung über die Pilotphase bis hin zur Massenfertigung).





INVESTOR RELATIONS

Der Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie stand im ersten Quartal 2009 noch ganz unter dem Einfluss der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung. Mit Beginn des zweiten Quartals konnte die Aktie allerdings wieder Fahrt aufnehmen und schloss das Berichtsjahr schließlich mit einem Plus von 227 Prozent. Mehr über die Kursentwicklung, die Aktionärsstruktur und die Investor Relations-Arbeit erfahren Sie in diesem Kapitel.

Trendumkehr in der Kursentwicklung

Nachdem es im Jahr 2008 im Zuge der globalen Finanzmarktkrise zu dramatischen Einbrüchen an den weltweiten Aktienmärkten gekommen war, entwickelten sich die Aktienmärkte 2009 wieder positiv. Der DAX, der mit 4.810,20 Zähler in das Jahr 2009 gestartet war, schloss zum Jahresende mit 5.957,43 Zählern knapp unter der 6000er-Marke, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der MDAX sowie der SDAX legten im gleichen Zeitraum sogar 34 % bzw. 28 % zu. Im internationalen Vergleich konnte sich die Performance des DAX damit durchaus sehen lassen. Die großen europäischen Indizes wie der französische CAC40 oder der britische FTSE 100 legten mit jeweils 22 % deutlich weniger zu. Auch die Wall Street und die Börse in Tokio legten weniger stark zu. Dow Jones und Nikkei schlossen 2009 mit einem Plus von rund 19 % über ihrem Vorjahresniveau.

Die SÜSS MicroTec-Aktie war mit einem Kurs von 1,36 € in das Geschäftsjahr 2009 gestartet, nachdem der Aktienkurs im vorausgegangenen Jahr 2008 im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise deutliche Verluste hinnehmen musste. Die darauffolgende Kursentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2009 war im Wesentlichen von der anhaltenden Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der weiteren gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklung geprägt. Ab April zogen die Handelsaktivitäten jedoch wieder spürbar an und die SÜSS MicroTec-Aktie konnte deutliche Kursgewinne

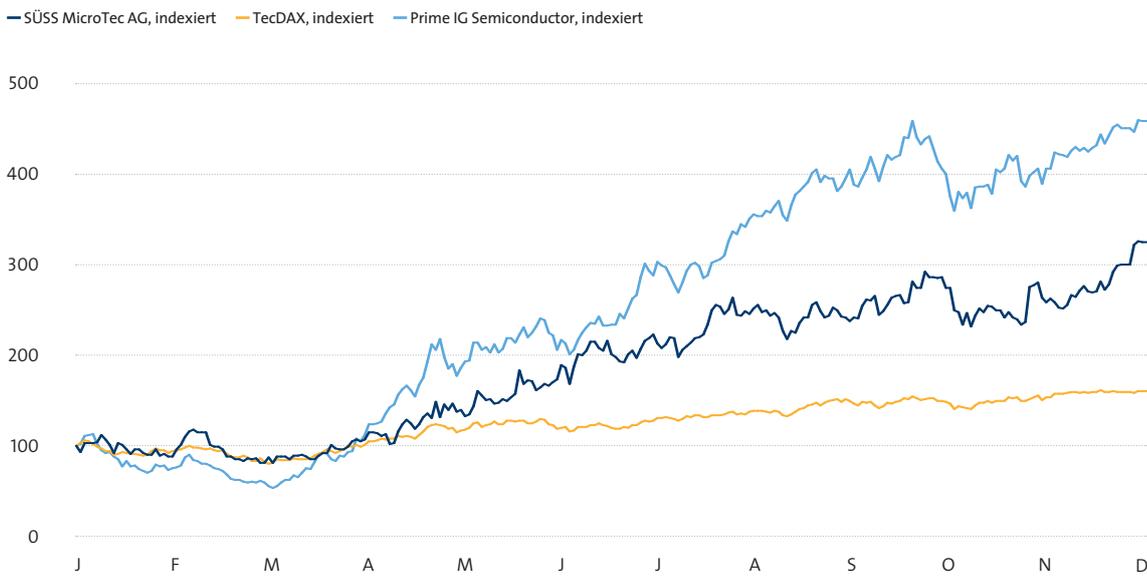
verzeichnen. Die im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungskooperationen des Unternehmens im Bereich der 3D-Integration sowie Mitteilungen über steigende Auftragseingänge beziehungsweise verbesserte Kapazitätsauslastungen in der Halbleiterindustrie wirkten sich hier positiv auf die Aktie aus. Unterstützt wurde dieser Trend durch die begleitende Quartalsberichterstattung, die erste Erfolge aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Restrukturierung aufzeigte. So konnte die SÜSS MicroTec-Aktie seit dem Frühsommer 2009 ihren Entwicklungsvorsprung gegenüber dem Vergleichsindex TecDAX kontinuierlich ausbauen. Lediglich der Branchenindex IG Prime Semiconductor verzeichnete, gezogen von der herausragenden Entwicklung der Infineon-, Aixtron- sowie der Dialog Semiconductor-Aktie, parallel eine noch bessere Performance. Am 31. Dezember 2009 notierte die SÜSS MicroTec-Aktie schließlich bei 4,45 € und verzeichnete damit ein Plus von 227 % gegenüber dem Vorjahres-Stichtag. Die Indizes TecDAX und IG Prime Semiconductor schlossen in demselben Zeitraum mit einem Plus von rund 61 % bzw. rund 362 % gegenüber dem Vorjahr ab.

Die Liquidität der SÜSS MicroTec-Aktie an allen deutschen Börsenplätzen lag mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Tag von 46.414 Stück auf dem Niveau des Vorjahres (2008: 46.325 Stück pro Tag). Der durchschnittliche Kurs der Aktie belief sich im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 auf 2,53 €.

Weitere Einzelheiten zur Aktie und ihrer Kursentwicklung enthalten die nachfolgenden grafischen Darstellungen.

Die Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie 2009

(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 1. Januar 2009: 1,36 €)

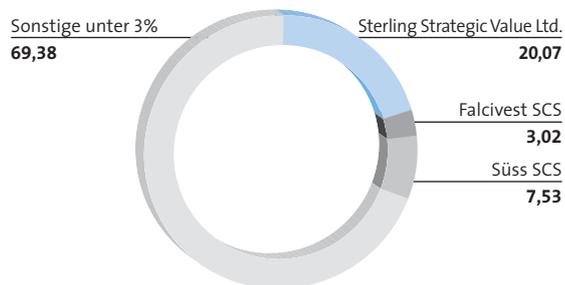


Vergleich der Kursentwicklung von SÜSS, TecDax und Prime IG Semiconductor im Geschäftsjahr 2009

	01.01.2009	31.12.2009	Veränderungen
TecDAX	508,31 €	817,58 €	+60,8%
Prime IG Semiconductor	21,06 €	97,26 €	+361,8%
SÜSS MicroTec	1,36 €	4,45 €	+227,2%

Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2009

in %





Die SÜSS MicroTec-Aktie im Überblick

Wertpapierkennnummer	722670
ISIN-Nummer	DE0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG
Bloomberg-Kürzel	SMH
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31.12.2009)	17.019.126
Wertpapiergattung	Nennwertlose Stückaktien
Designated Sponsor	HSBC Trinkaus & Burkhardt bis 30.09.09 Equinet ab 01.10.09
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs-/-/schlusskurs in Euro	1,36 € / 4,45 €
Jahreshoch-/tief in Euro*	4,48 € / 1,04 €
Prozentuale Jahresentwicklung	+227,2%
Kapitalmaßnahmen 2009	–

* XETRA-Schlusskurs

Investor Relations in Zeiten der Krise

Auf die Veränderungen an den internationalen Kapitalmärkten, ausgelöst durch die Finanzkrise, haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr mit verstärkten Investor Relations-Aktivitäten sowie dem Ausbau von Präsenztagen an in- und ausländischen Finanzmarktplätzen reagiert. So absolvierten Vorstand und Investor Relations insgesamt sieben Kapitalmarktkonferenzen und Roadshows und nutzten darüber hinaus – in mehr als 80 Einzelgesprächen – die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten. Daneben fanden anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen sowie zu außerordentlichen Entwicklungen Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt. Ein weiterer Schwerpunkt der Investor Relations-Aktivitäten lag auf der Überarbeitung und dem Ausbau des Online-Angebots auf der Unternehmenswebsite. In der Rubrik „Investor Relations“ können sich Aktionäre und potenzielle Anleger jederzeit über die aktuellen Entwicklungen sowie die historischen Veröffentlichungen des Konzerns informieren. Neben allen Pflichtpublikationen, die in deut-

sch und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, ergänzen nunmehr Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat das Online-Angebot. Darüber hinaus ermöglichen die zum Download bereitgestellten Analystenstudien und ein vierteljährlich aktualisiertes FactSheet einen schnellen Überblick. Für interessierte Investoren bieten wir zudem Werksführungen am Hauptsitz Garching bei München an, die um Diskussionsrunden mit dem Vorstand ergänzt werden. Unser Ziel ist es, bei Analysten und Investoren das Verständnis für unsere Geschäftsaktivitäten durch vertiefende Einblicke in das konzernweite Produktportfolio und dessen Anwendungsbereiche weiter zu steigern.

Ausgezeichneter Geschäftsbericht

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Geschäftsbericht der SÜSS MicroTec AG bereits zum fünften Mal von der LACP (League of American Communications Professionals) ausgezeichnet. In der Wettbewerbskategorie „Technology – Semiconductors & Equipment“ erhielt der Geschäftsbericht 2008 den „Platinum“-Award und setzte sich damit gegen alle eingereichten Finanzberichte in seiner Kategorie durch.

Analysten Research

Als Folge des schwierigen Börsenjahres 2008 und der damit einhergehenden geringeren Marktkapitalisierung der SÜSS MicroTec AG, hat es im Geschäftsjahr 2009 Veränderungen hinsichtlich der Struktur und Anzahl der die SÜSS MicroTec covernden Researchhäuser gegeben. Von den vormals sieben aktiven Researchhäusern haben im Geschäftsjahr 2009 die Deutsche Bank AG, die Crédit Agricole Cheuvreux AG sowie die Close Brothers Seydler Research AG und die Fairresearch GmbH & Co. KG ihre regelmäßige Berichterstattung eingestellt. Neu hinzugewonnen werden konnte hingegen die GBC AG Investment Research sowie die Equinet AG, die ab Oktober 2009 als Designated Sponsor auch die Betreuung der SÜSS MicroTec-Aktie von der HSBC Trinkaus & Burkhardt übernommen hat. Mit der Credit Suisse AG, der DZ Bank AG sowie der SES Research GmbH haben darüber hinaus drei Researchhäuser ihre langjährige Berichterstattung über die SÜSS MicroTec-Aktie fortgesetzt.



www.suss.com/investor_relations

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG fand im Berichtsjahr am 24. Juni 2009 im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt. Rund 120 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste waren der Einladung nach München gefolgt, um sich über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens in dem von der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise geprägten Umfeld persönlich zu informieren. Damit waren rund 38% des Grundkapitals vertreten. Der Vorstand erläuterte in seinem Rechenschaftsbericht ausführlich die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie des ersten Quartals 2009. Im Vordergrund standen dabei die im Geschäftsjahr 2008 angefallenen Sonderbelastungen, die das Jahresergebnis 2008 maßgeblich geprägt hatten, sowie die bereits ab Jahresmitte durchgeführten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen. Darüber hinaus erläuterte der Vorstand umfassend die produktstrategische Ausrichtung des Unternehmens für die kommenden Jahre. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere das Zukunftspotential und die Chancen auf dem Gebiet der 3D-Integration.

Mit Ausnahme der Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen folgte die Hauptversammlung in der abschließenden Abstimmung mit großer Mehrheit den von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagenen Beschlussfassungen. Die in diesem Jahr von Aktionärsseite eingereichten Gegenanträge wurden hingegen von der Mehrheit der Stimmen abgelehnt. Als Nachfolger für den seit 19. Juni 2008 im Amt befindlichen Herrn Dr. Franz Richter wurde für den Rest der ursprünglichen Amtszeit Herr Sebastian Reppegather in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Sebastian Reppegather ist Mitglied der Geschäftsführung der IED Beteiligungs-GmbH, Frankfurt am Main, sowie Investmentdirektor bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz. Darüber hinaus ist Herr Sebastian Reppegather Mitglied im Aufsichtsrat der Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands.



CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Bei SÜSS MicroTec orientieren wir uns am deutschen Corporate Governance Kodex, der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem nachfolgenden Bericht.

Corporate Governance-Bericht

SÜSS MicroTec misst der Corporate Governance seit jeher einen hohen Stellenwert bei. Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als ihre Verpflichtung an, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung für den Bestand des Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen.

Wir sind überzeugt, dass eine gute und transparente Corporate Governance ein wesentlicher Faktor für den unternehmerischen Erfolg ist. Unser Ziel ist es, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website.

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Die SÜSS MicroTec AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“), der im Jahr 2002 erlassen und zuletzt im Juni 2009 erweitert wurde, bereits seit mehreren Jahren mit nur wenigen Ausnahmen. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG sich eingehend mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodex, insbesondere mit den neuen Anforderungen vom 18. Juni

2009, befasst. Auf der Basis dieser Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 3. November 2009 die nachfolgend aufgeführte Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 AktG verabschiedet.

Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des Deutsche Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit den folgenden vier Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 mit den drei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – im Zeitraum vom 7. November 2008 bis zum 3. November 2009 entsprechen.

+ **Einladung zur Hauptversammlung, Stimmrechtsvertreter**

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.2 allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, sofern die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind. SÜSS MicroTec verfügt bislang nicht über die notwendigen Zustimmungserfordernisse zur elektronischen Übermittlung von Einberufungsunterlagen. Da es sich bei den Aktien der Gesellschaft um Inhaberaktien handelt, kann auch zukünftig nicht mit ausreichender Sicherheit gewährleistet werden, dass die benötigten Zustimmungserfordernisse erfüllt werden.

+ Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrates wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbsthalts nicht zusätzlich gefördert.

+ Bildung von Ausschüssen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 aus nunmehr drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG die Bildung von entsprechenden Ausschüssen für nicht notwendig an. Insbesondere ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass bei dieser Mitgliederzahl durch die Bildung von Ausschüssen die Arbeit des Gremiums unnötig erschwert werden würde.

+ Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

In Ziffer 5.4.6 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie eine Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Ausschüssen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Nach Ansicht der Gesellschaft wird das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrates durch Vereinbarung einer erfolgsorientierten Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich gefördert.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.



www.suss.com/investor_relations

Des Weiteren erfüllt die SÜSS MicroTec AG freiwillig auch die nicht obligatorischen Anregungen des Kodex mit den folgenden Einschränkungen:

- + Abweichend von Ziffer 2.3.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.
- + In Ziffer 2.3.4 regt der Kodex an, den Aktionären der Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (zum Beispiel Internet) zu ermöglichen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.
- + Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet abweichend von Ziffer 3.6 Abs. 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt.



Hauptversammlung – Sprachrohr der Aktionäre

Die jährliche Hauptversammlung wird bei SÜSS MicroTec mit dem Ziel vorbereitet, den Aktionären vor, während und nach der Versammlung alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel eineinhalb Monate vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der IR-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. So können Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selber ausüben, durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.



www.suss.com/investor_relations

Die Einberufung zur Hauptversammlung erfolgte bislang nicht auf elektronischem Wege, da die entsprechenden Zustimmungserfordernisse noch nicht erfüllt sind. Die SÜSS MicroTec AG wird die Entwicklungen in diesem Zusammenhang genau verfolgen und – sofern dies dem bisherigen Verfahren vorzuziehen ist – in einer zukünftigen Hauptversammlung eine entsprechende Satzungsänderung vorschlagen.

Kommunikation und Transparenz

Um größtmögliche Transparenz und gleiche Chancen für alle zu gewährleisten, folgt die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec dem Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren. Dazu nutzt das Unternehmen verschiedene Medien. Neben Telefongesprächen, Konferenzen, Roadshows und bei gelegentlichen Unternehmensbesuchen nutzen wir insbesondere die Website des Unternehmens, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über aktuelle Entwicklungen im Konzern zu informieren. So können neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, Präsentationen wichtiger Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei eingesehen beziehungsweise abgerufen werden. Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir unsere Aktionäre, Analysten, Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

SÜSS MicroTec unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft („AG“) dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmen diese mit dem Aufsichtsrats

ab und sorgen für deren Umsetzung. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – zum Beispiel Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt.

Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet. Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehören dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist.

Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2009 nicht. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr über den Kooperationsvertrag mit der Thin Materials AG beschlossen. Deren Vorstandsvorsitzender Herr Dr. Franz Richter war zu dieser Zeit zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG. Bei den Abstimmungen über den Vertrag hat sich Herr Dr. Franz Richter in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender enthalten. Im Übrigen gab es keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren ist.

Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 1. Februar 2009 wurde Herr Frank P. Averdung in den Vorstand und zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SÜSS MicroTec AG berufen. In seiner Funktion verantwortet der ehemalige Geschäftsführer der Carl Zeiss SMS GmbH (SMS – Semiconductor Metrology Systems), Jena, die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion, Arbeitssicherheit, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Qualitätsmanagement und Konzernstrategie.

Herr Christian Schubert, der sein Vorstandsmandat am 2. Oktober 2008 interimistisch angetreten war, verblieb bis zum Ende seiner Bestellung am 31. Mai 2009 im Vorstand der Gesellschaft und widmete sich dabei insbesondere der weiteren Optimierung des Einkaufs- und Beschaffungswesens sowie der Materialwirtschaft.

Wie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung am 26. März 2009 angekündigt wurden war, hat Herr Dr. Franz Richter sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2009 auf eigenen Wunsch vorzeitig niedergelegt. Grund für diese Entscheidung war die Vermeidung möglicher Interessenskonflikte, die sich aus seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Thin Materials AG und Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG hätten ergeben können, nachdem beide Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kooperation eingegangen waren, ohne dass SÜSS MicroTec dabei weitere Kooperationen auf dem Gebiet der Dünnwafer-Handhabung ausgeschlossen hat. Als sein Nachfolger wurde Herr Sebastian Reppegather von der Hauptversammlung für den Rest der ursprünglichen Amtszeit in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



Vergütungsbericht

Eine transparente und verständliche Darstellung der Vorstandsvergütung ist für SÜSS MicroTec seit Jahren ein wesentliches Element guter Corporate Governance. Mit dem zum 5. August 2009 in Kraft getretenen Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) hat der Gesetzgeber neue Anforderungen hinsichtlich der Festsetzung der Vorstandsvergütung geschaffen. Der Gesetzgeber verfolgt dabei das Ziel, die Vergütung des Vorstands an einer nachhaltigen und auf Langfristigkeit ausgerichteten Unternehmensführung zu orientieren. Dieses Ziel deckt sich mit den Grundsätzen, die der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec zugrunde liegen. Der Aufsichtsrat hat sich seit dem Sommer 2009 zu verschiedenen Terminen und insbesondere in seiner Sitzung am 3. November 2009 eingehend mit den gesetzlichen Neuerungen und insbesondere mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen. Nach ausführlicher Beratung hat der Aufsichtsrat das Vorstandsvergütungssystem zum 1. Januar 2010 an die gesetzlichen Neuerungen angepasst.

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Darüber

hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden. Weitere geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Die erfolgsbezogenen Vergütungskomponenten des Vorstands unterteilen sich in eine variable Vergütung, die sich an individuell festgelegten Zielen orientiert und eine am langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtete aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen. Für die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Für Vorstandsverträge, die nach dem 7. November 2008 abgeschlossen werden, wird für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change of control“-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Im Geschäftsjahr 2009 hat die SÜSS MicroTec AG folgende Vergütungen an die Vorstandsmitglieder gezahlt:

Vorstandsvergütung 2009

Vorstand	Grundgehalt in €*	Variable Vergütung für 2008 in €	Aktioptionen in Stück	Sonstige Leistungen in €**	Aufwand für Altersversorgung in €
Frank Averdung ^a	237.127,00	0,00	67.500	5.910,30	2.148,00
Michael Knopp	210.852,00	53.018,93	67.500	6.447,60	2.148,00
Christian Schubert ^b	111.144,78	20.000,00	–	–	–

* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit
 ** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

a) Vorstandsmitglied seit 1. Februar 2009

b) Vorstandsmitglied bis 31. Mai 2009

Aufsichtsratsvergütung 2009

Aufsichtsrat	Vergütung gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung in €	Sitzungsgeld gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung in €	Auslagenersatz und 19 % MwSt. abzgl. 30 % AR-Steuer etc. (§ 13 Abs. 3 der Satzung) in €
Dr. Franz Richter (Aufsichtsratsvorsitzender bis 24. Juni 2009)	22.500,00	6.000,00	5.415,00 MwSt. abzgl. 1.298,00 D&O-Versicherung = 4.117,00
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender seit 24. Juni 2009)	42.500,00	13.500,00	8.976,34 zzgl. 12.345,50 MwSt. abzgl. 1.947,00 D&O-Versicherung = 19.374,84
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 24. Juni 2009)	37.500,00	13.500,00	9.690,00 MwSt. abzgl. 1.082,00 D&O-Versicherung = 8.608,00
Sebastian Reppegather (Aufsichtsratsmitglied seit 24. Juni 2009)	17.500,00	7.500,00	4.050,00 abzgl. 7.912,50 AR-Steuer und 433,00 D&O-Versicherung = -4.295,50

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

Im Geschäftsjahr 2009 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütungen beziehungsweise Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.



Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte 2009

Datum der Transaktion	Käufer / Verkäufer	Funktion / Status	Art und Ort der Transaktion	Anzahl in Stück	Kurs / Preis in €	Gesamt-volumen
25.06.2009	Dr. Stefan Reineck	Aufsichtsrats-vorsitzender	Kauf über Frankfurter Wertpapierbörse	3.000	2,80	8.400,00
03.03.2009	Frank Averdung	Vorstands-vorsitzender	Kauf über XETRA	15.000	1,20	18.000,00
20.02.2009	Frank Averdung	Vorstands-vorsitzender	Kauf über XETRA	2.500	1,10	2.750,00

Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 € erreicht oder übersteigt.

Der SÜSS MicroTec AG wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt drei vorgenommene Geschäfte gemeldet.

Sämtliche Geschäfte wurden auch auf der Website des Unternehmens unter veröffentlicht.



www.suss.com/investor_relations

Aktienoptionsprogramme

Die SÜSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktienoptionsplänen ein wichtiges Element der Mitarbeiterbeteiligung an dem Erfolg des Unternehmens sowie die Möglichkeit, Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über drei Aktienoptionsprogramme. In allen Fällen können die Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

Aktienoptionsprogramm 2002

Aus dem von der Hauptversammlung am 14. Juni 2002 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2002 waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2009 20.050 Optionen (davon null Optionen an Mitglieder des Vorstands) ausstehend. Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt null Bezugsrechte ausgeübt. 4.500 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2002 sind im Berichtsjahr verfallen. Am Ende des Geschäftsjahres standen insgesamt noch 15.550 Optionen aus dem Optionsprogramm 2002 aus. Davon können 15.550 Optionen zu einem Ausübungspreis i. H. v. 3,44 € bis zum Ausübungszeitraum August 2010 ausgeübt werden, wenn eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) wenn der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen ist und sich der Börsenkurs der Gesellschaft in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax oder sein Nachfolgeindex TecDax oder (ii) wenn der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen ist. Der für die Ermittlung der Erfolgsziele maßgebliche Börsenkurs am Tag der Ausgabe der Optionen beträgt 4,91 €.

Aktienoptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2009 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 567.600 Optionen aus. Im Berichtsjahr 2009 wurden null Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 163.700 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2009 verfallen. Optionen aus diesem Programm wurden im Geschäftsjahr 2009 nicht ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 403.900 Stück, davon wurden insgesamt 70.000 an Mitgliedern des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p.a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p.a. gestiegen. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 4,95 € für 81.500 am 31. August 2005 ausgegebene Optionen, 7,35 € für 103.000 am 8. Juni 2006 ausgegebene Optionen sowie 8,39 € für 189.400 am 23. Mai 2007 und 8,42 € für 30.000 am 22. August 2007 ausgegebene Optionen.

Aktienoptionsprogramm 2008

Aus dem von der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2008 waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2009 null Optionen (davon null Optionen an Mitglieder des Vorstands) ausgegeben. Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt 438.250 Bezugsrechte ausgegeben. 2.500 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 sind im Berichtsjahr verfallen. Am Ende des Geschäftsjahres 2009 standen noch 435.750 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2009 aus. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern folgende Erfolgsziele erfüllt sind: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie hat sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,833 % pro vollem Kalendermonat gestiegen. Zusätzlich zu den Erfolgszielen (i) und (ii) muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraumes mindestens einmal bei 5,00 €, für die Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 5,75 € und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und dem 60. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 6,60 € gelegen haben. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 1,30 € für 438.250 am 14. April 2009 ausgegebene Optionen.



Rechnungslegung und Abschlussprüfung

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 24. Juni 2009 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2009 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

Besitz von Aktien und Bezugsrechten

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2009	Veränderung gegenüber 31.12.2008	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2009	Veränderung gegenüber 31.12.2008
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	–	40.000	–
Jan Teichert	0	–	0	–
Sebastian Reppegather*	0	–	0	–
Vorstand				
Frank Averdung**	27.500	+27.500	67.500	+67.500
Michael Knopp	22.500	–	97.500	+67.500
Christian Schubert***	0	–	0	–

* Aufsichtsratsmitglied seit 24. Juni 2009

** Vorstandsmitglied seit 1. Februar 2009

*** Vorstandsmitglied bis 31. Mai 2009

Organe

Mitglieder des Vorstands und deren Mandate:

Frank Averdung

+ VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

Michael Knopp

-

Christian Schubert

-

Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Mandate:

Dr. Franz Richter

Vorstandsvorsitzender der Thin Materials AG, München

- + Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- + Replisaurus Technologies, Inc., Kista, Schweden (Chairman of the Board of Directors)
- + EpiSpeed AG, Zug, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
- + Industrieverband SEMI, San Jose, CA / USA (Mitglied im „International Board of Directors“)

Dr. Stefan Reineck

Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchardt

- + AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- + NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- + Aleo solar Aktiengesellschaft, Prenzlau (Mitglied des Aufsichtsrats)
- + TF Instruments Inc. Minmouth Junction, NJ / USA (Mitglied im Board)
- + Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR / USA (Mitglied im Board)
- + Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg an der Havel (Beiratsvorsitzender)*

Jan Teichert

Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau a. d. Isar

Sebastian Reppegather

Investment Director bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im Board of Directors)
- + IED Beteiligungs-GmbH, Frankfurt am Main (Mitglied der Geschäftsführung)

* bis 31. Oktober 2009



KONZERNLAGEBERICHT

und Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2009

43 GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

- 43 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 45 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 46 Forschung und Entwicklung
- 48 Überblick über den Geschäftsverlauf

52 ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

- 52 Ertragslage
- 54 Finanz- und Vermögenslage
- 56 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 56 Investitionen
- 56 Die Holding – SÜSS MicroTec AG
- 59 Mitarbeiter im Konzern

59 ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

61 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB

61 NACHTRAGSBERICHT

62 RISIKOBERICHT

- 62 Risikomanagement-System
- 62 Organisation und Dokumentation des Risikomanagements
- 62 Risiko-Identifikation
- 62 Risiko-Bewertung
- 63 Risiko-Handhabung
- 63 Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB
- 64 Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
- 65 Betriebliche Risiken
- 66 Finanzmarktrisiken

68 PROGNOSEBERICHT

- 69 Halbleiterindustrie
- 69 Halbleiter-Equipment-Industrie
- 69 Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
- 71 Endogene Indikatoren

72 GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS

72 VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

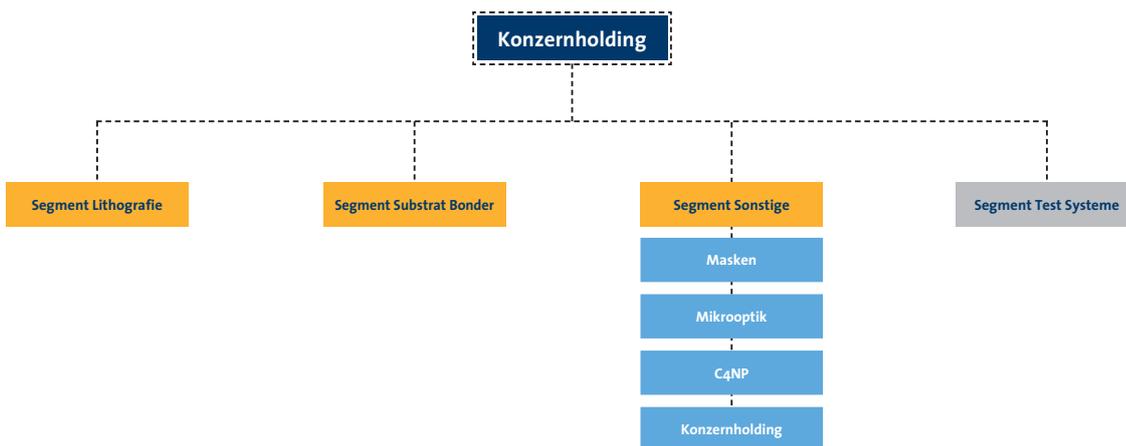
Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und

Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

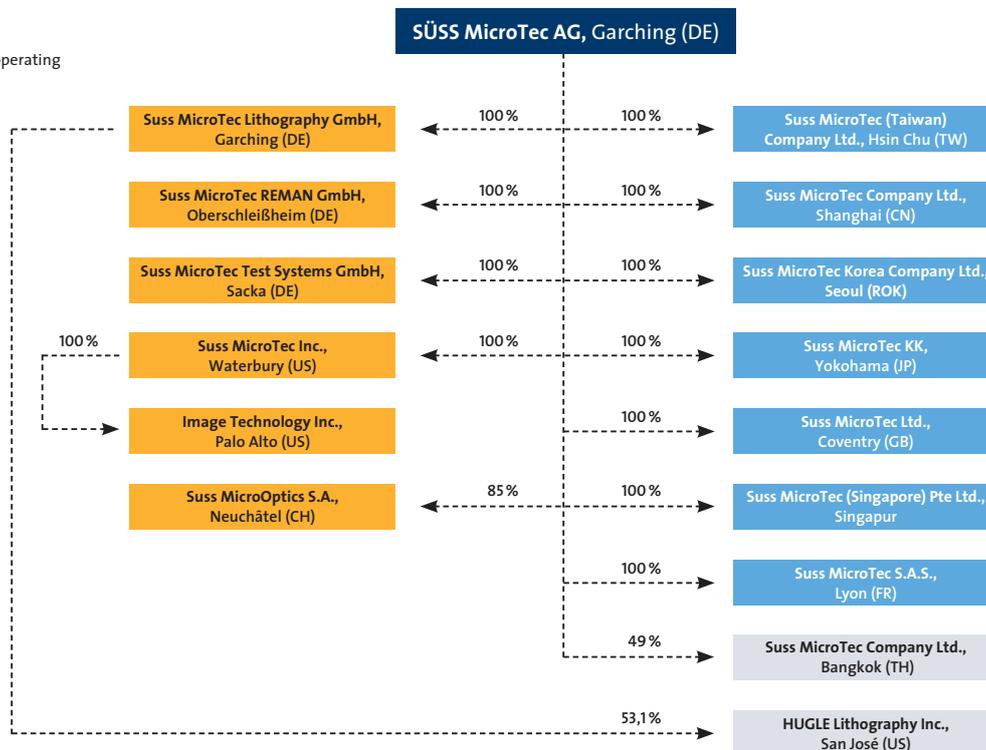
Der Konzern ist zum 31. Dezember 2009 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Der folgende Lagebericht bezieht sowohl die fortgeführten als auch die nicht fortgeführten Aktivitäten des Konzerns in die Betrachtung mit ein. Zu den nicht fortgeführten Aktivitäten des Geschäftsjahres 2009 zählt das Segment Test Systeme, von welchem sich die SÜSS MicroTec AG am 27. Januar 2010 getrennt hat.





Rechtliche Konzernstruktur

- Muttergesellschaft
- Vertrieb
- Produktion
- Sonstige / Nonoperating



Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, England, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea, Thailand und Taiwan.

Daneben bestehen noch geringfügige Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

- + 10 % Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz (DE)
- + 10 % ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT)

Diese geringfügigen Beteiligungen haben unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft sowie die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.

Leitung und Kontrolle

Personalveränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Zum 1. Februar 2009 hat Herr Frank Averdung sein Amt als Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG angetreten. Er war durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25. November 2008 in den Vorstand der Gesellschaft bestellt worden. In seiner Funktion verantwortet der ehemalige Geschäftsführer der Carl Zeiss SMS GmbH, Jena, die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion, Arbeitssicherheit, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Qualitätsmanagement, Umweltschutz und Konzernstrategie.

Herr Christian Schubert, der am 2. Oktober 2008 zum Interimsvorstand bestellt worden war, ist mit dem Ende seiner Bestellung zum 31. Mai 2009 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Die Bestellung von Herrn Michael Knopp wurde im Laufe des Geschäftsjahres um weitere fünf Jahre bis zum 31. Juli 2015 verlängert.

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2009 hat Herr Dr. Franz Richter sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Sein Rücktritt erfolgte im Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte, die sich aus seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG und Vorstandsvorsitzender der Thin Materials AG, Eichenau, hätten ergeben können, nachdem beide Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kooperation eingegangen waren, ohne dass SÜSS MicroTec dabei weitere Kooperationen auf dem Gebiet der Dünnwafer-Handhabung („Thin Wafer Handling“) ausgeschlossen hat. Als Nachfolger für den seit 19. Juni 2008 im Amt befindlichen Dr. Franz Richter wurde für den Rest der ursprünglichen Amtszeit Herr Sebastian Reppegather gewählt.

Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 13 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash-Position (Flüssige Mittel zuzüglich Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrufter als Strategie. Ziel ist es durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren.



Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträngige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Forschung und Entwicklung

Die konsequente Entwicklung von Equipment und Prozesslösungen sowie die produktübergreifende Standardisierung sind auch weiterhin ein wichtiger Baustein der Unternehmensstrategie um kurz-, mittel- und langfristige Marktanteile der SÜSS MicroTec-Geschäftsfelder in den adressierten Märkten zu erhöhen bzw. um neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Produkte und Entwicklungen der jeweiligen Segmente bzw. Unter-einheiten dargestellt und erläutert.

Lithografie

Im Geschäftsjahr 2009 wurde neben der ACS300 Gen2, einer Weiterentwicklung des überaus erfolgreichen Coat- und Developer Cluster ACS300Plus, das neuentwickelte Beleuchtungssystem MO Exposure Optics in den Markt eingeführt.

Die zweite Generation des ACS300 wurde hinsichtlich des Systemaufbaus und der Prozessmodule eigens für Anwendungen, wie dem Advanced Packaging und der 3D-Integration entwickelt. Das modulare System für die Belackung, Aushärtung und Entwicklung von Wafern bis 300mm Durchmesser eignet sich dank seiner Fähigkeit, extrem dicke Fotolackschichten bearbeiten zu können, insbesondere für Anwendungen wie Solder-Bumping, Gold-Bumping oder Redistribution Layer. Im Vergleich zu

seinem Vorgänger, dem ACS300Plus, verfügt die Weiterentwicklung des Clusters über die höchste, derzeit auf dem Markt erhältliche Belackungs- und Entwicklungskonformität sowie über eine erweiterte Effizienz bei gleichzeitig kleinerer Grundfläche.

Zu den neuen Technologien, die SÜSS MicroTec im abgelaufenen Geschäftsjahr in das Produktportfolio aufgenommen hat, zählt auch die patentierte MO Exposure Optik, ein neues Beleuchtungssystem, das auf alle Generationen von manuellen und automatischen Mask Alignern von SÜSS MicroTec nachgerüstet werden kann. Die gemeinsam mit der Konzerntochter Süss MicroOptics aus Neuchatel entwickelte Optiktechnologie basiert auf hochwertigen Mikro-Optiken (Mikrolinsen Arrays), die eine verbesserte Auflösung und Schärfentiefe sowie hervorragende Uniformität in der Maskenbeleuchtung ermöglichen.

Substrat Bonder

Im Geschäftsjahr 2009 hat die SÜSS MicroTec AG insgesamt vier Entwicklungskooperationen im Bereich der 3D-Integration abgeschlossen. Zu den Partnern aus Industrie und Forschung zählen neben 3M und der Thin Materials AG auch das belgische Forschungszentrum für Nanoelektronik IMEC sowie das taiwanische Industrial Technology Research Institute (ITRI). Im Mittelpunkt dieser Kooperationen steht die Entwicklung von permanenten und temporären Bonding und De-Bonding-Prozessen sowie die Herstellung von Durchkontaktierungen (Through Silicon Vias) im Rahmen der dreidimensionalen Systemintegration. Aus diesen Kooperationen leiteten sich auch die wesentlichen Entwicklungsaktivitäten der Substrat Bonder Division im Jahr 2009 ab. Ziel der Entwicklungen von SÜSS ist es, basierend auf dem XBC300 Produktions-Bonder eine Bonder-Plattform anzubieten, die geeignet ist, die von den verschiedenen Partnern entwickelten Prozesslösungen gleichermaßen umzusetzen.

C4NP

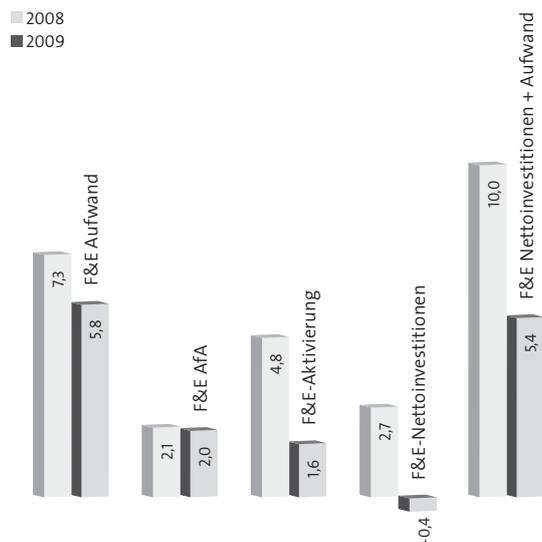
Im Geschäftsjahr 2009 wurden die letzten beiden noch ausstehenden Systeme an den Entwicklungspartner IBM ausgeliefert und erfolgreich implementiert. Damit sind gleichzeitig die Entwicklungsleistungen im Rahmen des Projekts C4NP vollends abgeschlossen worden.

Der Aufwand für Forschung und Entwicklung aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten ging im Jahresvergleich von 7,3 Mio. € auf 5,8 Mio. € zurück. In den Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen sind im Berichtsjahr Wertminderungen in Höhe von 0,4 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) enthalten, die den nicht fortgeführten Aktivitäten im Bereich Test Systeme zuzuordnen sind. Im Vorjahr entfiel der größte Teil der Wertminderungen in Höhe von 8,0 Mio. € auf das C4NP-Projekt. Zudem mussten im Vorjahr in den Segmenten Substrat Bonder bzw. Test Systeme aktivierte Entwicklungsleistungen von 0,7 Mio. € bzw. 0,1 Mio. € wertberichtigt werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren übertrafen im Berichtsjahr die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungsbetrag. Kam es im Vorjahr noch zu einer Nettoentlastung der Gewinn- und Verlustrechnung von 2,7 Mio. € wurde im Berichtsjahr die Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 0,4 Mio. € belastet.

Die Zahlen der Tabelle berücksichtigen sowohl fortgeführte wie auch nicht fortgeführte Aktivitäten. Die Wertminderungen sind nicht enthalten.

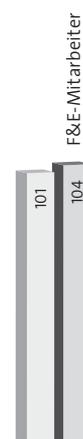
F&E-Ausgaben im Jahresvergleich

in Mio. €



F&E-Mitarbeiter im Jahresvergleich

2008
2009





Überblick über den Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

In den vergangenen zwei Jahren sind die Finanzmärkte und die gesamte Weltwirtschaft in einer Weise aus dem Gleichgewicht geraten und in eine tiefe Krise gestürzt wie nie zuvor in den vergangenen 60 Jahren. Laut WTO (World Trade Organisation) verzeichnete der weltweite Handel im Jahr 2009 den stärksten Rückgang seit Ende des zweiten Weltkrieges. Der Austausch von Waren und Dienstleistungen ging im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % zurück. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt sank laut WTO im Jahr 2009 um 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang ist vor allem eine Folge der weltweiten Wirtschaftskrise in den Industrieländern.

Nachdem das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Weltwirtschaftsklima im ersten Quartal 2009 auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken war, stieg der Weltwirtschaftsklima-indikator in den darauffolgenden drei Quartalen des Jahres wieder langsam an. Unterstützend wirkten sich diesbezüglich die überall auf der Welt aufgelegten staatlichen Konjunkturprogramme aus. Für das Jahr 2010 erwartet der IWF (Internationale Währungsfonds) nunmehr ein globales Wirtschaftswachstum von 3,9 %. Für die Euro-Zone wird mit einem Anstieg von 1,0 % gerechnet. Gleichzeitig wies die Organisation auf die Gefahren eines global unabgestimmten Ausstiegs aus den fiskal- und geldpolitischen Maßnahmenprogrammen sowie der anhaltend fragilen Stabilität des Finanzsystems hin, die leicht zu Rückschlägen in der globalen Wirtschaftsentwicklung führen könnten.

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete trotz der ergriffenen Konjunkturmaßnahmen in 2009 starke Rückgänge. Die preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt-Rate (BIP) fiel mit -4,8 % deutlich negativ aus und lag zudem unter den bereits rückläufigen Vorjahreswerten von 2008 (1,3 %) und 2007 (2,5 %). Für die deutsche Wirtschaft rechnet das DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) im Jahr 2010 nunmehr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,1 % sowie 1,8 % im Jahr 2011.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Der Vereinigung der Halbleiterindustrie Semiconductor Industry Assoziation (SIA) zufolge verzeichnete die weltweite Halbleiterbranche in 2009 einen Umsatzrückgang von 9,0 % auf 226,3 Mrd. US-Dollar (2008: 248,6 Mrd. US-Dollar). Insgesamt fiel die Jahresentwicklung damit jedoch besser aus, als noch zu Beginn des Jahres erwartet. Nach bereits starken Einbrüchen im Jahr 2008 erreichte die Branche laut dem Marktforschungsinstitut Gartner im ersten Quartal des Jahres 2009 ihren Tiefpunkt. In den darauffolgenden drei Quartalen stiegen die Umsätze wieder stetig an. Lageraufstockungen sowie die starke Nachfrage nach PCs, Mobiltelefonen und Verbraucherelektronik trugen insbesondere im vierten Quartal 2009 zur Verbesserung der Gesamtjahresentwicklung bei.

Nach Angaben des Fachverbands ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) verzeichnete der deutsche Halbleitermarkt in 2009 einen Umsatzrückgang von rund 22 % auf 7,2 Mrd. €. Als Ursache wurden hier die Umsatzrückgänge in den Treibersegmenten Automobil- und Industrie-Elektronik sowie der Datentechnik als Folge der globalen Wirtschaftskrise angeführt.

Unternehmensentwicklung

Wie bereits zu Jahresbeginn 2009 prognostiziert, verzeichnete das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl bei Auftragseingang als auch im Umsatz einen deutlichen konjunktur- und branchenbedingten Rückgang. Ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Test Systeme erwirtschaftete die SÜSS MicroTec-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 103,9 Mio. € und verfehlte damit den Vorjahreswert von 121,5 Mio. € um 14,5 %. Der Auftragseingang in den fortgeführten Aktivitäten sank im Jahresvergleich um 18,5 % auf 96,3 Millionen € (Vorjahr: 118,2 Mio. €).

Trotz des signifikanten Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2009 ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 2,8 Mio. € erwirtschaften. Im Vorjahr betrug das durch Sonderbelastungen in Höhe von 17,2 Mio. € geprägte EBIT -8,7 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen bereits im zweiten Halbjahr 2008 mit der Umsetzung sowohl operativer als auch struktureller Maßnahmen begonnen und diese konsequent im Jahr 2009 weitergeführt. Erste Erfolge daraus spiegeln sich bereits zu Jahresanfang in der deutlich verbesserten Liquidität der SÜSS MicroTec-Gruppe wider. Die liquiden Mittel und Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 31,1 Mio. € nach 24,4 Mio. € im Vorjahr. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 2009 signifikant auf 18,4 Mio. € (Vorjahr: 9,4 Millionen €). Der Free Cashflow vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben belief sich zum Geschäftsjahresende 2009 auf 8,9 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €).

Der Auftragsbestand aus den fortgeführten Aktivitäten betrug zum 31. Dezember 2009 57,0 Mio. € (Vorjahr: 65,1 Mio. €).

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich in 2009 für die fortgeführten Aktivitäten auf 0,93 nach 0,97 im Vorjahr.

Umsätze und Auftragslage in den Regionen

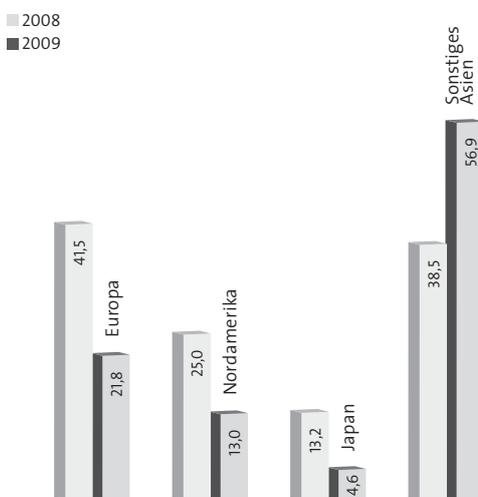
Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter, MEMS und Test Systeme.

Auftragseingänge nach Regionen

Von den starken Auftragsrückgängen waren im Geschäftsjahr 2009 alle Regionen mit Ausnahme der Region Asien betroffen. In Europa sank der Auftragseingang aus fortgeführten Aktivitäten um -47,5 % auf 21,8 Mio. € nach 41,5 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Test Systeme im Jahr 2009 einen Auftragseingang in Höhe von 13,0 Mio. € und verfehlte damit den Vorjahreswert von 25,0 Mio. € um rund -48,0 %.

Während die Region Japan im Jahr 2009 mit -65,2 % den stärksten Auftragsrückgang auf 4,6 Mio. € nach 13,2 Mio. € im Vorjahr erzielte, verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe in der Region Asien (ohne Japan) ein Auftragsplus von 47,8 % auf 56,9 Mio. € nach 38,5 Mio. € im Vorjahr. Zu der positiven Entwicklung trug vor allem die mit dem zweiten Quartal 2009 wiedergekehrte Nachfrage von taiwanesischen Packaging-Kunden bei, die nach ihrer Investitionszurückhaltung im zweiten Halbjahr 2008 gleich mehrere Aufträge für Lithografie-Equipment, insbesondere Coater, platzierten.

Entwicklung der Auftragseingänge nach Regionen (fortgeführte Aktivitäten) in Mio. €





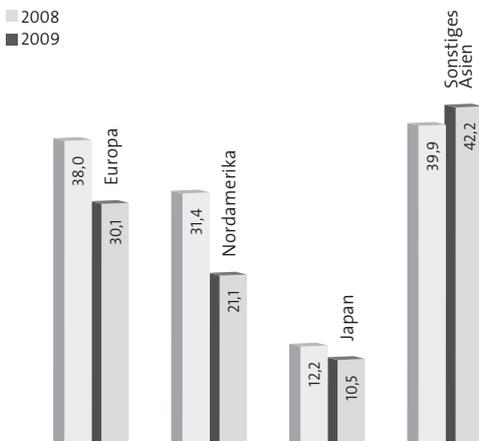
Umsätze nach Regionen

Die Verteilung der Umsätze nach Regionen liefert ein ähnliches Bild wie die Auftragsverteilung. Die in der Region Asien erzielte Umsatzsteigerung aus fortgeführten Aktivitäten um 5,8 % auf 42,2 Mio. € (Vorjahr: 39,9 Mio. €) konnte die Umsatzrückgänge in den übrigen Regionen nicht kompensieren.

In Europa sank der Umsatz um 20,8 % auf 30,1 Mio. € nach 38,0 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr mit -32,8 % auf 21,1 Mio. € den stärksten Rückgang (Vorjahr 31,4 Mio. €), während der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten in der Region Japan mit 10,5 Mio. € lediglich 13,9 % schwächer als im Vorjahr ausfiel (Vorjahr: 12,2 Mio. €).

Entwicklung der Umsätze nach Regionen (fortgeführte Aktivitäten)

in Mio. €



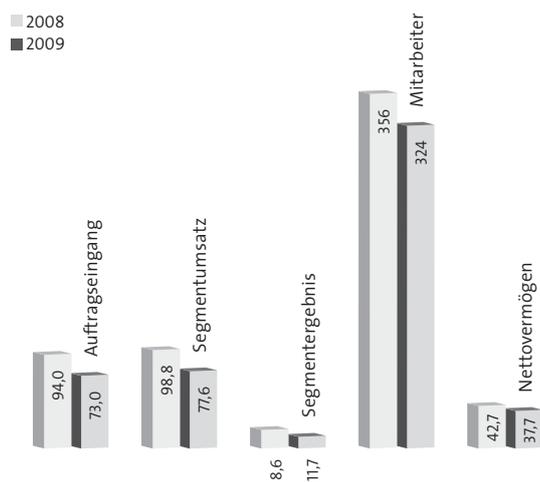
Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Entwicklung und Produktion dieser Produktlinien sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen an der Enz angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisation in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt mit einem Umsatzanteil von rund 75 % der fortgeführten Aktivitäten das Kernsegment der SÜSS MicroTec-Gruppe dar. Zu den adressierten Märkten der Produktlinien zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie das Advanced Packaging und die 3D-Integration.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Segment Lithografie im Geschäftsjahr 2009 sowohl beim Auftragszugang als auch im Umsatz deutliche Rückgänge. Grund hierfür war vor allem die starke Investitionszurückhaltung seitens der Produktionskunden. Der Auftragseingang reduzierte sich im Jahresvergleich um rund 22 % auf 73,0 Mio. € nach 94,0 Mio. € im Jahr 2008. Der Umsatz fiel mit 77,6 Mio. € ebenfalls rund 22 % schwächer aus als im Vorjahr (Vorjahr: 98,8 Mio. €). Die reduzierte Nachfrage betraf insbesondere die Produktlinie Mask Aligner. Das Segmentergebnis verschlechterte sich um 6,9 Mio. € bzw. 37,1 % auf 11,7 Mio. €. Die Rohertragsmarge von 44,4 % veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Segmentübersicht Lithografie

in Mio. €

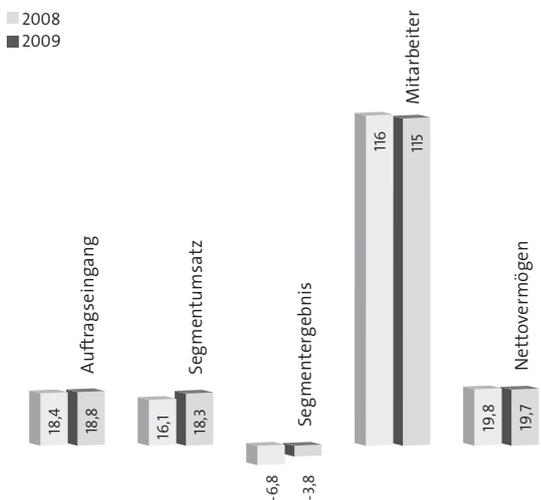


Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder beinhaltet die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder, die am Standort Waterbury im US-Bundesstaat Vermont angesiedelt sind. Der Vertrieb der Bonder-Produktlinien erfolgt über Waterbury hinaus auch von kleineren Einheiten an den Standorten in Europa sowie in Asien. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder erzielte im Geschäftsjahr 2009 sowohl im Auftragseingang als auch beim Umsatz erfreuliche Zuwächse. Der Auftragseingang stieg von 18,4 Mio. € im Jahr 2008 um 2,2% auf 18,8 Mio. € im Jahr 2009. Der Umsatz übertraf mit 18,3 Mio. € den Vorjahreswert von 16,1 Mio. € um 13,7%. Grund für die positive Geschäftsfeldentwicklung ist die steigende Bedeutung von Bonding-Equipment im Fertigungsprozess zukünftig dreidimensionaler Chipstrukturen (3D-Integration) sowie das aktuelle und erweiterte Produktangebot in diesem Segment. Das im Vorjahr durch Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. € geprägte Segmentergebnis verbesserte sich von -6,8 Mio. € auf -3,8 Mio. € im Jahr 2009. Die Rohertragsmarge verbesserte sich dementsprechend von 6,0% auf 14,7%.

Segmentübersicht Substrat Bonder in Mio. €

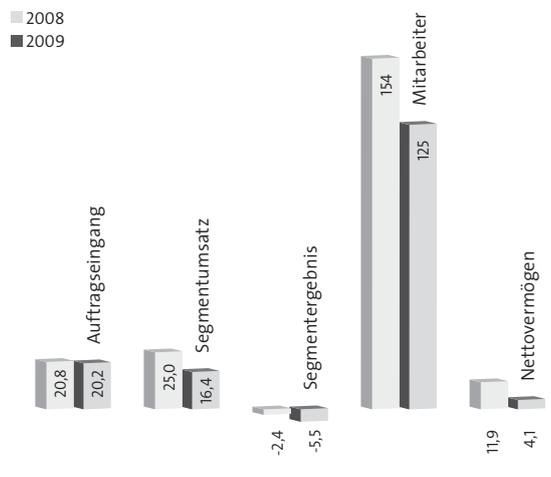


Test Systeme

Das Segment Test Systeme umfasst die Entwicklung, die Produktion sowie den europaweiten Vertrieb und ist in Sacka bei Dresden angesiedelt. Das Segment wurde am 27. Januar 2010 an den US-amerikanischen Wettbewerber Cascade Microtech, Inc. verkauft und wird daher im abgelaufenen Geschäftsjahr unter den nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Zu den adressierten Märkten der Test Systeme zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie der Halbleiter-Engineering-Bereich.

Das Segment Test Systeme erzielte in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld 2009 einen Umsatz von 16,4 Mio. € nach 25,0 Mio. € im Vorjahr. Ursache hierfür waren insbesondere der anhaltende Wettbewerbsdruck mit den Hauptkonkurrenten Cascade Microtech und in der Folge ausgelöster Margendruck. Beide Faktoren wirkten sich negativ auf das Segmentergebnis aus, das im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. € auf -5,5 Mio. € zurückging. Umso erfreulicher ist es, dass das Segment trotz der widrigen Marktumstände mit 20,2 Mio. € einen Auftragseingang in etwa auf Höhe des Vorjahres erreichte (Vorjahr: 20,8 Mio. €).

Segmentübersicht Test Systeme in Mio. €





Sonstige

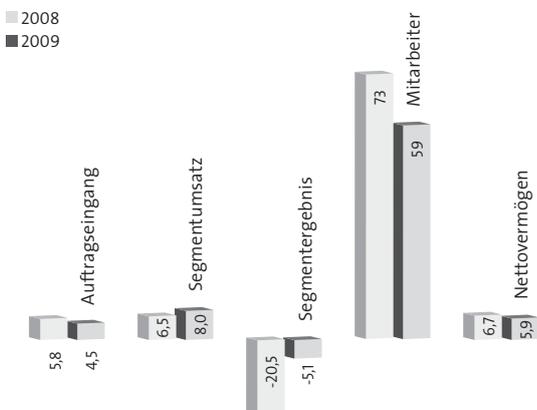
Das Segment Sonstige beinhaltet neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien, USA) auch die Mikro-Optik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz sowie das Geschäftsfeld C4NP. Ebenfalls im Segment Sonstige enthalten sind die größtenteils nicht auf Segmentebene zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Das Geschäftsfeld Mikrooptik entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 leicht positiv. Während der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 10,0 % auf 2,2 Mio. € anstieg, blieb der Umsatz mit 1,8 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Im Maskengeschäft verringerte sich der Umsatzbeitrag von 3,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,7 Mio. €. Der Auftragseingang verringerte sich um -40,5 % auf 2,2 Mio. €. Hintergrund der schwächeren Entwicklung des Maskengeschäfts war das anhaltend schwierige Marktumfeld.

Das im Vorjahr durch Sonderbelastungen in Höhe von 12,9 Mio. € geprägte Segmentergebnis verbesserte sich von -20,5 Mio. € auf -5,1 Mio. €.

Segmentübersicht Sonstige

in Mio. €



ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Ertragslage

Trotz des schwierigen Marktumfelds mit deutlich niedrigeren Umsatzerlösen ist es der SÜSS MicroTec AG im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, ein positives EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 2,8 Mio. € aus den fortgeführten Aktivitäten zu erzielen. Im Vorjahr stand bei den fortgeführten Aktivitäten noch ein EBIT von -8,7 Mio. € zu Buche. Diese Vorjahreszahl war allerdings von Sonderbelastungen in Höhe von 17,2 Mio. € geprägt, so dass sich ein bereinigtes EBIT in Höhe von 8,5 Mio. € errechnete.

Die Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten verringerten sich im Berichtsjahr von 121,5 Mio. € im Vorjahr auf 103,9 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang von knapp 15% und zeigt, dass die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise auch am SÜSS MicroTec-Konzern nicht spurlos vorübergegangen ist. Insofern ist es sehr erfreulich, dass es im Segment Substrat Bonder sogar gelungen ist, die Umsatzerlöse von 16,1 Mio. € im Vorjahr auf 18,3 Mio. € zu steigern. Auch der Bereich C4NP lieferte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzbeitrag von 3,4 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €), da die an IBM gelieferten Tools erfolgreich abgenommen werden konnten. Damit verfügt der Konzern über keinen Auftragsbestand an C4NP-Maschinen mehr.

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein Rohertrag von 38,8 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertragsmarge von 37,4% entspricht. Bereinigt man den Rohertrag des Vorjahres von 38,3 Mio. € um Sonderbelastungen in Höhe von 12,4 Mio. €, bedeutet dies einen Rückgang von 11,9 Mio. €. Die bereinigte Rohertragsmarge des Vorjahres belief sich auf 41,7%. Neben dem reduzierten Umsatzniveau ist für den Rückgang von Rohertrag und Rohertragsmarge in erster Linie der veränderte Produktmix entscheidend: Der Umsatzanteil der vergleichsweise margenschwachen Substrat Bonder hat im Berichtsjahr zugenommen. Zudem konnten aus dem Verkauf der C4NP-Maschinen keine positiven Roherträge erzielt werden.

Infolge der durchgeführten Kosteneinsparmaßnahmen konnten sowohl die Vertriebs- als auch die Verwaltungskosten deutlich gesenkt werden: Die Vertriebskosten gingen von 20,4 Mio. € im Vorjahr auf 16,7 Mio. € zurück, die Verwaltungskosten sanken von 16,8 Mio. € auf 13,9 Mio. €. Zusätzlich zu den genannten Kosteneinsparungen wirkten im Bereich der Vertriebskosten auch die gesunkenen Provisionen auf Grund des reduzierten Umsatzniveaus. Die Forschungs- und Entwicklungskosten gingen von 5,7 Mio. € auf 4,9 Mio. € zurück.

Das Finanzergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr von -0,8 Mio. € auf -0,1 Mio. € verbessert werden. Diese Verbesserung beruht im Wesentlichen auf reduzierten Zinsaufwendungen. Vor allem die positive Marktwertentwicklung der Zinsswaps machte sich hier bemerkbar.

Die Belastung des Konzerns mit Ertragsteuern in Höhe von 2,1 Mio. € blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhältnismäßig hohe Ertragsteueraufwand resultiert im Wesentlichen aus der fehlenden Aktivierbarkeit aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge bei der Suss MicroTec Inc. infolge der anhaltend negativen Ertragssituation. Im Vorjahr war der Steueraufwand durch die Veränderung bei der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche in Höhe von 2,7 Mio. € geprägt.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 0,5 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 5,6 Mio. € vor Berücksichtigung von Sonderbelastungen in Höhe von 17,2 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von -5,4 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €), das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Dieses negative Ergebnis nach Steuern resultiert zum einen aus einem Verlust aus der operativen Geschäftstätigkeit von -0,8 Mio. €, einem Verlust aus der Bewertung der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert von -4,7 Mio. € sowie einem positiven Ertragsteuereffekt von 0,1 Mio. €. Die negativen Bewertungseffekte betreffen in Höhe von 4,2 Mio. € den Geschäfts- oder Firmenwert des Segments Test Systeme, in Höhe von 0,4 Mio. € immaterielle Vermögenswerte und in Höhe von 0,1 Mio. € das Sachanlagevermögen des aufzugebenden Geschäftsbereichs.

Im Vorjahr war in den nicht fortgeführten Aktivitäten noch die Restabwicklung des Segments Device Bonder berücksichtigt, aus der allerdings keine wesentlichen Effekte resultierten.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von -4,9 Mio. € (Vorjahr: -13,9 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie betrug -0,28 € nach -0,82 € im Vorjahr. Der Gesamtumsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,8% von 214 T€ auf 193 T€.



Finanz- und Vermögenslage

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net Cash-Position von 9,4 Mio. € im Vorjahr auf 18,4 Mio. € auszubauen. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren erhöhte sich von 24,4 Mio. € im Vorjahr auf 31,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

So konnte der bereits im Vorjahr starke Cashflow aus dem operativen Geschäft weiter gesteigert werden: Er stieg von 9,4 Mio. € im Vorjahr auf 12,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres. Ursächlich für diesen Anstieg war zum einen der deutliche Abbau des Vorratsvermögens von 8,3 Mio. € sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 6,6 Mio. €. Gegenläufig wirkten Kundenanzahlungen, die sich um 6,7 Mio. € verringerten.

Weiterhin trug die im Cashflow aus der Investitionstätigkeit erkennbare Investitionszurückhaltung zur Verbesserung der Net Cash-Position bei. Vor Berücksichtigung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren von 6,7 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €) belief sich der Cashflow aus der Investitionstätigkeit auf -3,2 Mio. € nach -7,5 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Free Cashflow vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben verbesserte sich von 1,9 Mio. € im Vorjahr auf 8,9 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr. Damit wurde die Vorgabe, aus dem operativen Geschäft ausreichend freien Cashflow zu generieren, so dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf für die organische Weiterentwicklung des Basisgeschäfts auftreten sollte, deutlich übertroffen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf -2,1 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Der Tilgung von Bankverbindlichkeiten durch die Süss MicroTec KK in Japan von 4,6 Mio. € stand eine Mittelaufnahme von 3,0 Mio. € durch die SÜSS MicroTec AG aus der sale and lease back-Transaktion der eingeführten SAP-Software gegenüber.

Neben liquiden Mitteln und Wertpapieren in Höhe von 31,1 Mio. € (Vorjahr: 24,4 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Kreditlinien von 9,0 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Zum Vorjahresstichtag lag bereits schriftlich eine weitere Kreditzusage in Höhe von 3,0 Mio. € vor. Die entsprechende Kreditvereinbarung wurde im April des Berichtsjahres unterzeichnet. Im ersten Quartal wurde das Bankenkonsortium der Gesellschaft um eine dritte Bank ergänzt, die ebenfalls eine Linie von 3,0 Mio. € stellte. Die gesamte Kreditlinie von 9,0 Mio. € ist nicht an sogenannte Financial Covenants gebunden und hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2010. Die Besicherung erfolgte zu banküblichen Konditionen. Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme insgesamt 2,4 Mio. €.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert verringerte sich von 17,8 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 13,6 Mio. € und ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen. Die Abnahme von 4,2 Mio. € resultiert aus der Umgliederung des Geschäfts- oder Firmenwerts in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte im Zusammenhang mit den nicht fortgeführten Aktivitäten im Bereich Test Systeme.

Auch die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: Nach 10,3 Mio. € im Vorjahr betragen sie zum Bilanzstichtag noch 9,3 Mio. €. Wie beim Geschäfts- oder Firmenwert wurden auch aus dieser Position aktivierte Entwicklungsleistungen des Segments Test Systeme von 0,4 Mio. € in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte umgegliedert. Unabhängig von dieser Umgliederung übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr die planmäßigen Abschreibungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte die getätigten Investitionen, was zu einer entsprechenden Belastung in der Gewinn- und Verlustrechnung führte. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Höhe von 3,3 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) auf das Segment Lithografie und in Höhe von 6,0 Mio. € (Vorjahr: 6,5 Mio. €) auf das Segment Substrat Bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente in Höhe von 4,5 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €), welche auch die geleasteten SAP-Lizenzen enthalten. Der Restbuchwert von 4,5 Mio. € entfällt in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie und Substrat Bonder sowie in Höhe von 3,7 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) auf das Segment Sonstige.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Infolge der restriktiven Investitionspolitik im Berichtsjahr verringerten sich die Sachanlagen von 5,4 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 4,1 Mio. € zum Bilanzstichtag. Der Rückgang resultiert in Höhe von 0,3 Mio. € aus der Umgliederung von Sachanlagen des Segments Test Systeme in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte.

Die latenten Steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen auf Grund verminderter temporärer Differenzen im Bereich des Vorratsvermögens um 1,3 Mio. € und betragen zum Bilanzstichtag 7,8 Mio. €.

Bei den kurzfristigen Vermögenswerten kam es im Berichtsjahr ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung: Sie verringerten sich von 105,0 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 96,5 Mio. €. Dieser Rückgang resultierte im Wesentlichen aus den Vorräten und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Erstere gingen von 54,6 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 40,8 Mio. € zurück, wobei ein Teil des Rückgangs von 4,5 Mio. € auf der Umgliederung von Vorräten des Segments Test Systeme in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte beruht. Daneben machten sich die Anstrengungen des Konzerns zur Senkung der Lagerbestände positiv bemerkbar, die durch die eingeführte SAP-Software ermöglicht wurden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich von 23,1 Mio. € auf 14,8 Mio. €. Auch aus dieser Position wurde ein Teil von 2,0 Mio. € in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte umgegliedert. Neben dem gesunkenen Umsatzniveau machte sich im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein effizientes Forderungsmanagement bemerkbar.

Infolge der nicht fortgeführten Aktivitäten im Segment Test Systeme weist der Konzern zum Bilanzstichtag zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte von 7,5 Mio. € (Vorjahr: 0,0 Mio. €) aus. Die Zusammensetzung dieser Position wird im Anhang erläutert. Die umgegliederten Aktiva wurden mit ihrem beizulegenden Wert abzüglich anfallender Veräußerungskosten bewertet. Dieser wurde aus dem erzielten Veräußerungspreis für das Segment Test Systeme abgeleitet. Insgesamt wurden Abwertungen von 4,7 Mio. € vorgenommen. Davon entfielen 4,2 Mio. € auf den Geschäfts- und Firmenwert des Segments Test Systeme, 0,4 Mio. € auf immaterielle Vermögenswerte und 0,1 Mio. € auf Sachanlagen.

Die Kundenanzahlungen verringerten sich von 19,4 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 12,6 Mio. €.

Analog zum Vorgehen auf der Aktivseite weist der Konzern auch auf der Passivseite zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten aus. Sie betragen zum 31. Dezember 2009 insgesamt 2,4 Mio. € (Vorjahr: 0,0 Mio. €) und sind im Anhang genauer erläutert.



Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf Grund der geringeren Bilanzsumme im Jahresvergleich von 59,0% auf 63,1%.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend erzielte die SÜSS MicroTec im Berichtsjahr trotz eines Umsatzrückgangs von knapp 15% ein positives EBIT aus fortgeführten Aktivitäten von 2,8 Mio. €. Dem durch das schwierige Marktumfeld bedingten Rückgang von Umsatzerlösen und Rohertragsmargen konnte durch deutliche Einspareffekte in den Vertriebs- und Verwaltungskosten erfolgreich begegnet werden.

Durch die deutlich ausgebaute Net Cash-Position von 18,4 Mio. € (Vorjahr: 9,4 Mio. €) verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Investitionen

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes bewegen werden. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Masken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Der größere Anteil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht. Dominierende Projekte im Berichtsjahr waren die Erweiterungen der Produktpalette im Segment Substrat Bonder. Wir gehen langfristig davon aus, dass rund 15 bis 25% der Ausgaben für Forschung und Entwicklung aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der weitere Roll-out des im Vorjahr bei den ersten Konzerngesellschaften erfolgreich eingeführten ERP-Systems SAP vorbereitet. Im Rahmen des Projektes werden in den kommenden zwei bis drei Jahren Investitionen in Software und Hardware von rund 2,0 Mio. € vorgenommen werden. Das Volumen des Gesamtprojektes beträgt 5,0 Mio. €. Im Berichtsjahr konnte über eine sale and lease back-Transaktion ein Teil des Projektes von 3,0 Mio. € refinanziert werden.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt u.a. die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

Gesellschaft in T€	SMT AG (HGB)			
	2009	2008	Änderung	in%
Jahresfehlbetrag	-18.030	-406	-17.624	<-100 %
Eigenkapital	78.623	96.400	-17.777	-18 %
Bilanzsumme	110.694	119.623	-8.929	-7 %
EK-Quote in%	71 %	81 %		
Anlagevermögen	76.501	95.881	-19.380	-20 %
...% der Bilanzsumme	69 %	80 %		
Umlaufvermögen	34.193	23.742	10.451	44 %
...% der Bilanzsumme	31 %	20 %		

Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,5 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 3,7 Mio. €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von Intellectual Property im Bereich Dünn-Wafer-Handling in Höhe von 0,9 Mio. €. Gegenläufig wirkten sich planmäßige Abschreibungen aus.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen verringerten sich im Berichtsjahr um 18,8 Mio. € und belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 61,2 Mio. €. Die Gründe für diesen Rückgang werden nachfolgend unter den wesentlichen Ereignissen mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding erläutert.

Der Rückgang der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultiert aus planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1,9 Mio. €. Gegenläufig wirkten sich Erhöhungen von Ausleihungen gegenüber der Süss MicroTec Inc. in Höhe von 0,8 Mio. € und gegenüber der Süss MicroTec Singapur in Höhe von 0,1 Mio. € aus.

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich um 2,6 Mio. €. Der Anstieg der kurzfristigen Forderungen ist hauptsächlich auf die Erhöhung kurzfristiger Darlehen gegenüber der Süss MicroTec Inc. und der Süss MicroTec KK zurückzuführen.

Die SÜSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditätsposition weiter ausbauen. Neben der erfolgreichen Refinanzierung des SAP-Projekts in Höhe von 3,0 Mio. € resultiert der Ausbau im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Die Erhöhung der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1,1 Mio. € als auch im Erwerb von Wertpapieren in Höhe von 6,3 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich im Berichtsjahr von 11,2 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 18,1 Mio. €. Ursächlich für diesen Anstieg war im Wesentlichen die positive Entwicklung der Finanzlage der Süss MicroTec Lithography GmbH. Die hieraus resultierenden Cashflows wurden über das bestehende Cashpooling auf Bankkonten der SÜSS MicroTec AG transferiert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten blieben im Verlauf des Jahres 2009 unverändert und bestehen weiterhin aus den im Dezember 2012 fälligen Schuld-scheindarlehen.



Das verringerte Eigenkapital (-17,8 Mio. €) resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres (18,0 Mio. €) und den Zuführungen zur Kapitalrücklage (0,2 Mio. €) auf Grund bestehender Aktienoptionspläne.

Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2009 ein Jahresfehlbetrag von 18,0 Mio. € (Vorjahr: -0,4 Mio. €).

Auf Grund des vorhandenen Gewinnabführungsvertrages mit der Suss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, wurde bei der Holding ein Verlust in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: -2,0 Mio. €) ergebniswirksam gebucht. Auf Grund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrages mit der Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Gewinn in Höhe von 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) ergebniswirksam vereinnahmt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten (Vorjahr: 3,1 Mio. €).

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass keine Weiterbelastungen von Entwicklungsleistungen im Rahmen des C4NP-Projekts mehr anfallen. Im Vorjahr betragen diese Weiterbelastungen 0,7 Mio. €. Weiterhin sanken die Fremdwährungsverluste um 1,1 Mio. € auf 1,3 Mio. €. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außer den Fremdwährungsverlusten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €) und Beiträge in Höhe von 0,6 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) enthalten. Die Erhöhung der Beiträge resultiert aus einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Forschungsinstitut IMEC im Bereich Waferbonding-Lösungen zu Applikationen für die 3D-Integration.

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 0,4 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) enthalten eine Ausschüttung der Tochtergesellschaft Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu.

Weiterhin fielen im Berichtsjahr Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 18,8 Mio. € an. Der größte Teil dieser Abschreibungen in Höhe von 13,5 Mio. € wurde auf die Anteile an der Suss MicroTec Inc. vorgenommen. Eine Ursache für diese Abwertung lag im Anstieg des risikoadjustierten Diskontierungszinssatzes, der dem auf diskontierten Cashflows basierenden Bewertungsmodell für die Finanzanlagen zugrunde liegt. Des Weiteren gingen im Vergleich zum Vorjahr positive Liquiditätseffekte aus der Veränderung des Working Capitals deutlich zurück. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich die Verschuldung dieser Gesellschaft im Berichtsjahr erhöhte und die Umsatzprognose für das Folgejahr reduziert wurde.

Ein weiterer Teil der Abschreibungen in Höhe von 3,3 Mio. € entfiel auf die Abwertung der Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH, Dresden. Diese Abwertung wurde im Zusammenhang mit dem im Januar 2010 erfolgten Verkauf dieser Gesellschaft notwendig. Die Abwertung auf den beizulegenden Wert orientiert sich am erzielten Kaufpreis.

Die Konzernplanung sieht für 2010 einen deutlichen Umsatzrückgang bei der Suss MicroTec KK, Japan, vor. Dieser Rückgang ist durch die Zurückhaltung japanischer Kunden bei der Bestellung von Maschinen im Produktionsumfeld bedingt. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft von 1,9 Mio. € an.

Infolge der Verlagerung des Vertriebs „Rest of Asia“ von Bangkok nach Singapur wickelt die SÜSS MicroTec AG derzeit ihre Beteiligung an der Suss MicroTec Company Ltd., Thailand, ab. In diesem Zusammenhang wurde zum Bilanzstichtag eine Abwertung der Anteile an dieser Gesellschaft von 0,1 Mio. € vorgenommen.

Im Vorjahr wurden aufgrund veränderter Geschäftsmodelle mit einer Reduzierung der bisher ausgeübten Vertriebstätigkeiten bei den Tochtergesellschaften in Frankreich und England Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1,9 Mio. EUR notwendig. Diese entfielen in Höhe von 1,4 Mio. EUR auf den Beteiligungsansatz an der Süss MicroTec S.A.S., Lyon, und in Höhe von 0,5 Mio. auf den Beteiligungsansatz an der Süss MicroTec Ltd., Coventry.

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf die ausgebauten Liquiditätsposition der Gesellschaft zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2009 durchschnittlich 19 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

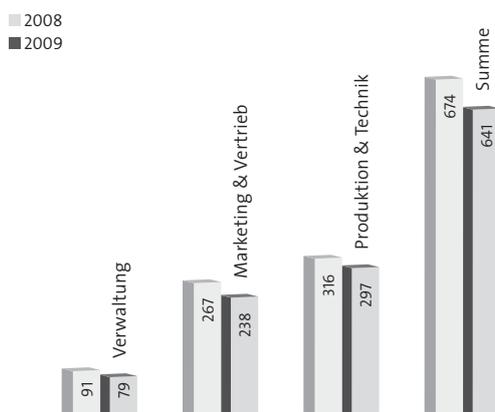
Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind auf Grund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2009 waren 614 (Vorjahr: 674) Mitarbeiter in den fortgeführten und nicht fortgeführten Bereichen des Konzerns beschäftigt.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen



ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

Das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG in Höhe von 17.019.126 € ist aufgeteilt in 17.019.126 nennwertlose, stimmberechtigte Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag hält Herr Tito Tettamanti eine Beteiligung am Kapital der SÜSS MicroTec AG von 20,07% (Vorjahr: 20,07%). Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei von der Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gehalten, die von Herrn Tettamanti kontrolliert wird.

Die Terramater (Stichting), Amsterdam, Niederlande, hat im Berichtsjahr Anteile an der SÜSS MicroTec AG erworben und hält zum Bilanzstichtag eine Beteiligung am Kapital der SÜSS MicroTec AG von 10,57%. Die der Terramater zugerechneten Stimmrechte werden dabei von der Süss SCS, Strassen, Luxemburg, und der Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gehalten.



Weitere direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10% überschreiten, gibt es zum Bilanzstichtag nicht.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Die Hauptversammlung vom 24. Juni 2009 hat dem Vorstand die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2009 nebst entsprechender Satzungsänderung nicht erteilt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 4.254.775 € durch Ausgabe von bis zu 4.254.775 neuen Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die bestehenden Schuldscheinverträge beinhalten eine Change-of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen.

Mit den drei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein „Change-of-Control“ eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können mit Ausnahme des Schuldscheindarlehens im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 11. März 2010 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.com/investors_relations/corporate_governance/de/declaration_on_corporate_governance allgemein zugänglich gemacht.

NACHTRAGSBERICHT

Am 13. Januar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG den erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen zum Kauf der HamaTech APE GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Singulus Technologies AG, mitgeteilt. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 12. Januar 2010 vorbehaltlich vereinbarter Closing-Konditionen von beiden Parteien unterzeichnet und sieht einen Kaufpreis von 4,5 Mio. € sowie den Erwerb des Grundstücks und des Firmengebäudes am Standort Sternenfels zu einem Kaufpreis von ebenfalls 4,5 Mio. € vor. Am 15. Februar 2010 wurde die Transaktion vollzogen.

Am 15. Januar 2010 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihr 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihr zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

Am 27. Januar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG ihren in Sacka bei Dresden angesiedelten Geschäftsbereich Test Systeme verkauft. Der Kaufpreis für die Suss MicroTec Test Systems GmbH (ohne Finanzverbindlichkeiten und Barmittel) besteht aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente beträgt 4,5 Mio. €, wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Erwerberin bezahlt wurden. Zusätzlich wurde ein Betrag von 2,5 Mio. € in ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig ist, die nach der Transaktion von der Verkäuferin erfüllt werden müssen und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führen.



RISIKOBERICHT

Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement im SÜSS MicroTec-Konzern auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risiko-Identifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risiko-Bewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. € erreichen oder übertreffen.

Risiko-Handhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagement-System im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikomanagement-Systems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft. Eine absolute Sicherheit kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihre konzernweiten Procedure Rules zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.



Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Bei den deutschen Gesellschaften wurde bereits im Vorjahr SAP eingeführt. Weitere Tochtergesellschaften werden im nächsten Jahr folgen. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware „MIS Package“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Ausgelöst durch die Fehlentwicklung auf dem US-Hypothekenmarkt waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Diese schlug sich in der Abschwächung des Geschäfts- und Konsumklimas, einer erhöhten Arbeitslosigkeit, einem Rückgang des Investitionsvolumens und daraus resultierend in gesunkener Nachfrage und schwierigeren Marktbedingungen nieder. Im Umfeld dieser Entwicklung ist die ökonomische Situation in den meisten Industrieländern von hoher Unsicherheit gekennzeichnet. Wenngleich in den vergangenen Monaten bestimmte Indizes und ökonomische Daten auf erste Anzeichen einer Erholung und Stabilisierung des makroökonomischen Umfelds hindeuteten, besteht keine Gewissheit, inwieweit diese Erholung umfassend und nachhaltig ist. Sollte die Erholung nur vorübergehend sein oder sich der weltweite Konjunkturabschwung fortsetzen, kann nicht garantiert werden, dass sie keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wird. Die gegenwärtige Kreditverknappung auf den Finanzmärkten könnte beispielsweise die Finanzierungsmöglichkeiten unserer Kunden erschweren, was zur Folge haben kann, dass sich Kaufabsichten bezüglich unserer Produkte ändern, verzögern oder Transaktionen nicht durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund können auch Stornierungen bereits erteilter Aufträge nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann eine unzureichende Generierung von Umsätzen oder ein erschwerter Zugang zu den Kapitalmärkten bei unseren Kunden dazu führen, dass sie nicht in der Lage sind, ausstehende Rechnungen fristgerecht oder vollständig zu begleichen. Dadurch könnten unser Ergebnis und unsere Cashflows negativ beeinflusst werden.

Zahlreiche andere Faktoren, wie Schwankungen bei den Energie- und Rohstoffpreisen sowie globale politische Konflikte, einschließlich der Situation im Nahen und Mittleren Osten und in anderen Regionen, wirken sich weiterhin auf makroökonomische Faktoren sowie die internationalen Kapitalmärkte aus. Unsicherheiten hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach unseren Produkten beeinträchtigen und unsere Budgetierung wie auch unsere Prognosen erschweren.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Abhängigkeit von einzelnen Know-how-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Betriebliche Risiken

Vermögens- und Ertragslage

Infolge der durch die unsichere ökonomische Situation der meisten Industrieländer bedingten Investitionszurückhaltung vieler Kunden kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Konzern seine für 2010 gesteckten Umsatzziele nicht erreichen kann. Durchgeführte und derzeit laufende Kosteneinsparmaßnahmen könnten demzufolge nicht ausreichen, um ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Wir begegnen diesem Risiko durch eine konsequente Auswertung der zur Verfügung stehenden Frühindikatoren, vor allem unseres Auftragseingangs. Wir verfügen bereits heute über einen weiteren Katalog von möglichen Maßnahmen zur Absenkung unseres Break-even-Umsatzes, deren Ergebnisauswirkungen allerdings teilweise erst in 2011 wirksam würden. Eine – über die aufgestellte Konzernplanung hinausgehende – Verschlechterung der Ertragslage könnte in der Konzernbilanz Wertminderungen im Rahmen künftiger Impairment-Tests notwendig machen. Dies hätte sowohl die Abwertung von Aktivwerten der Holding als auch des Konzerns zur Folge. Diese Wertminderungen hätten Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.



Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Auf Grund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

Änderungen der Konzernstruktur

Nach Ende des Berichtsjahres hat die SÜSS MicroTec AG die HamaTech APE GmbH & Co. KG übernommen. Akquisitionen sind von sich aus riskant, da sie Risiken aus der Integration von Mitarbeitern, Prozessen, Technologien und Produkten beinhalten. Es besteht das unternehmerische Risiko, dass sich das erworbene Unternehmen wirtschaftlich nicht wie erwartet im Markt entwickelt und die mit seinem Erwerb verfolgten Umsatz- und Ertragsziele nicht erreicht oder dass die beabsichtigten Synergieeffekte nicht erzielt werden können. Wir begegnen diesem Risiko, indem Akquisitionen vorab sorgfältig und systematisch geprüft werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Due-Diligence-Prüfung.

Finanzmarktrisiken

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge

mit Kunden, die in sog. „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sog. „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 15,2 Mio. € (Vorjahr: 24,1 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 11,9 Mio. € (Vorjahr: 13,3 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2009 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung

in T€	2009	2008
1–30 Tage	1.134	4.962
31–60 Tage	652	3.414
61–90 Tage	541	999
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	2.327	9.375

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt (in T€):

Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung

in T€	2009	2008
91–180 Tage	579	930
181–360 Tage	210	294
> 360 Tage	224	235
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	1.013	1.459

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Die nach wie vor schwierige Lage an den Finanzmärkten kann unsere Fremdfinanzierungsmöglichkeiten einschränken. Im Fall einer deutlichen Verfehlung unserer Planung für 2010 kann nicht ausgeschlossen werden, dass geltende Covenants aus den bestehenden Schuldscheindarlehen nicht eingehalten werden können. Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2007 ein Schuldscheindarlehen von 9,0 Mio. € begeben.

Derzeit stellen drei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kreditlinie von 9,0 Mio. €, die zunächst bis zum 31. März 2010 befristet ist. Teile dieser Kreditlinie nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinie über den 31. März 2010 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei Kunden, die auf solchen Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf Grund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Darüber hinaus wird ein Sockelbetrag auf eine Laufzeit von 12 Monaten gesichert. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (29).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer 10%igen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 420 T€ (Vorjahr: 690 T€) und einer entsprechenden Verminderung des Jahresergebnisses geführt.



Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in T€):

2009			
in T€	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.450	703	2.153
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.887	1.680	4.567
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-678	-111	-789
Kundenanzahlungen	-1.303	0	-1.303
Netto-Exposure	2.356	2.272	4.628
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	-214	-206	-420

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Geschäftsjahr 2007 platzierten variablen Teile des Schuldscheinanlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht.

2008			
in T€	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.620	139	2.759
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.859	2.611	7.470
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-301	-721	-1.022
Kundenanzahlungen	-1.625	0	-1.625
Netto-Exposure	5.553	2.029	7.582
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	-505	-185	-690

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2009 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

PROGNOSEBERICHT

Wie bereits zu Jahresbeginn 2009 prognostiziert, verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl bei Auftragseingang als auch im Umsatz einen deutlichen konjunktur- und branchenbedingten Rückgang. Die aufgrund bestehender Überkapazitäten seitens der Halbleiterhersteller geringe Nachfrage nach Halbleiter-Equipment wurde durch die wachsende Unsicherheit auf den Weltmärkten weiter gebremst. Makroökonomische Indikatoren deuten jedoch bereits auf eine Stabilisierung der Weltmärkte hin. Darüber hinaus verzeichnete die Halbleiterindustrie beginnend mit dem zweiten Quartal 2009 ein stetiges Wachstum, wenngleich sich der weltweite Halbleiterumsatz noch deutlich unter dem einstigen Niveau von 2007 befindet. Vor dem Hintergrund der vorsichtig, positiven Erwartungshaltung seitens der Markt- und Branchenbeobachter geht SÜSS MicroTec für das Jahr 2010 von einer moderat positiven Umsatzentwicklung aus.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

Halbleiterindustrie

Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise verzeichnete die Halbleiterindustrie im Jahr 2009 weltweit einen Umsatzrückgang von 9,0 % auf 226,3 Mrd. US-Dollar (SIA, Februar 2010). Insgesamt fiel die Jahresentwicklung damit besser aus, als zu Beginn des Jahres noch erwartet worden war. Nach bereits starken Umsatzeinbrüchen im Jahr 2008 verbesserte sich die Lage in der Halbleiterindustrie beginnend mit dem zweiten Quartal 2009 kontinuierlich. Für 2010 gehen die beiden Marktforschungsinstitute Gartner und iSuppli von einem weltweiten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 19,9 % bzw. 21,5 % auf ein Niveau von 276 bis 280 Mrd. US-Dollar aus (Stand Februar 2010/März 2010). Die positive Erwartungshaltung ist zum einen in der steigenden Nachfrage nach PCs und Mobiltelefonen begründet sowie zum anderen in den steigenden Durchschnittspreisen für Speicherchips (DRAMs). Darüber hinaus schaffen Schwellenländer wie China und Indien mit ihren Investitionen in die kabellose Infrastruktur zusätzliche Nachfrage nach allen Arten von Halbleiterprodukten (SIA, Februar 2010).

Halbleiter-Equipment-Industrie

Vor dem Hintergrund fallender Speicherchippreise und bestehender Überkapazitäten hatten die Halbleiterhersteller beginnend in der Jahresmitte 2008 ihre Investitionsbereitschaft in Halbleiter-Equipment deutlich reduziert. Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die Halbleiter-Equipment-Industrie in Folge dessen in 2009 einen Umsatzrückgang von -42,6 % (Stand Dezember 2009). Die im zweiten Quartal 2009 einsetzende Belebung im Halbleitermarkt führte jedoch laut dem Branchenverband Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) dazu, dass das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsatzerlösen in Nordamerika bereits seit Juli 2009 konstant über der Paritätsmarke lag. Nach Meinung der beiden Marktforschungsinstitute Gartner und iSuppli wird sich diese positive Entwicklung im Jahr 2010 fortsetzen. Während Gartner im ersten Halb-

jahr 2010 insbesondere Technologiezukäufe seitens der Chiphersteller und Auftragsfertiger (Foundries) erwartet, sollen in der zweiten Jahreshälfte zudem Kapazität-zukäufe die positive Entwicklung treiben. Die Prognosen der Marktforscher reichen vor diesem Hintergrund von einem Anstieg der weltweiten Ausgaben für Halbleiter-Equipment von 45,3 % (Gartner, Dezember 2009) bis 46,8 % (iSuppli, Januar 2010). Für 2011 rechnet Gartner im Halbleiter-Equipment-Markt mit einem weiteren Wachstum von 30,2 % auf insgesamt 47,8 Mrd. US-Dollar. Bei der Bewertung der Zahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie Märkte reflektieren, die für große „Frontend“-orientierte Hersteller wie Applied Materials oder ASML bestimmend sind.

SÜSS MicroTec ist hingegen im klassischen „Frontend“ der Chiphersteller kaum aktiv und ist als innovativer, spezialisierter Equipment-Hersteller hauptsächlich in den Teilmärkten MEMS, Advanced Packaging, Verbindungshalbleiter und 3D-Integration tätig. Für diese Teilmärkte gibt es hingegen nur wenige Prognosen.

Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS)

Trotz der stetig steigenden Absatzzahlen blieb der Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS) nach 2007 und 2008 auch im Jahr 2009 ohne nennenswertes Wachstum. Grund hierfür ist laut dem Industrieverband SEMI der wachsende Anteil an Niedrigpreis-MEMS-Bauteilen für Verbraucher-elektronik, der sich negativ auf die durchschnittlichen Verkaufspreise auswirkt. Das Marktforschungsinstitut Yole Développement geht jedoch vor dem Hintergrund einer langsam einsetzenden Erholung der Weltwirtschaft davon aus, dass der MEMS-Markt im Jahr 2010 erstmalig wieder um 14 % auf ein Marktvolumen von 8,0 Mrd. US-Dollar wachsen wird. Die Marktforscher prognostizieren darüber hinaus eine durchschnittliche Wachstumsrate von 24,2 % pro Jahr mit einem erwarteten Umsatz im Bereich der Mikrosystemtechnik von 12,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2012 (Stand August 2009).

Verbindungshalbleiter (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter ist stark diversifiziert und daher schwer global einzuschätzen. SÜSS MicroTec konzentriert sich in diesem Markt auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannten High-Brightness (HB)- und Ultra-High-Brightness (UHB)-LEDs. Die hocheffizienten Leuchtdioden sind im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln extrem platzsparend und haben eine bis zu 50-mal so lange Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigerem Energieverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung. Neben diesen umweltfreundlichen Eigenschaften haben die hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit sowie die zunehmend preiswertere Herstellung der Dioden zu einer breiten Akzeptanz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen geführt. Dabei wird die Nachfrage zunehmend durch den Einsatz in der Computer- und Fernsehtechnik getrieben.

Das französische Marktforschungsinstitut Yole Développement prognostiziert für den weltweiten LED-Markt für die kommenden sechs Jahre daher eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14,1% auf ein Marktvolumen von 11,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015. Laut den Marktforschern wird das Wachstum dabei insbesondere

von der steigenden Nachfrage nach Ultra-High-Brightness-LEDs getrieben werden, deren durchschnittliche jährliche Wachstumsrate sich im genannten Zeitraum auf +54,4% belaufen soll. Für die Equipmenthersteller leitete sich nach Schätzungen von Yole Développement aus dem Markt für HB- und UHB-LEDs für die kommenden sechs Jahre eine durchschnittliche jährliche Marktwachstumsrate von +33,6% auf ein Marktvolumen von 353 Mio. US-Dollar im Jahr 2015 ab.

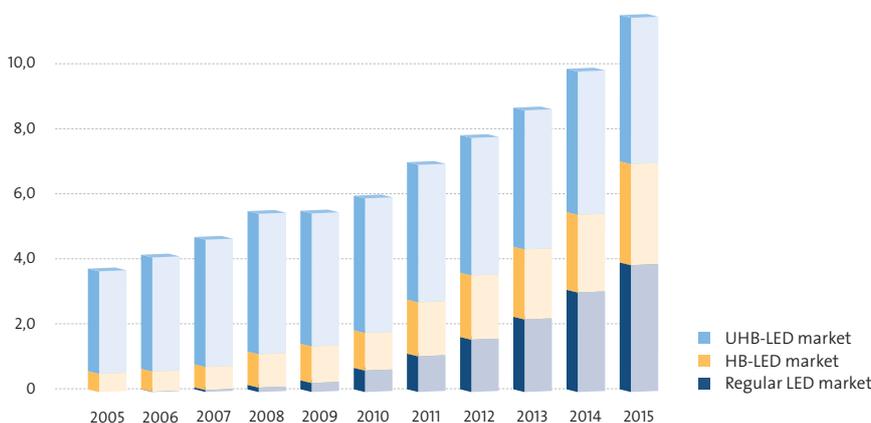
Endogene Indikatoren

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebotes entscheidend. Im Geschäftsjahr 2009 hat das Unternehmen insgesamt vier strategisch bedeutende Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung im Bereich der 3D-Integration abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass diese Neuentwicklungen bereits im Jahr 2010 das Interesse bei Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Chipherstellern finden werden, die diese neuen Prozesse in den folgenden Jahren nach und nach in ihre Produktion integrieren werden.

Der LED-Markt

in Mrd. USD

Quelle: Yole Développement, HB LED & LED Packaging Report, Oktober 2009





GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENT- WICKLUNG DES KONZERNS

Die Weltwirtschaft scheint den Tiefpunkt der Rezession durchschritten zu haben, wenngleich für das Jahr 2010 nur mit einer langsamen konjunkturellen Belebung gerechnet wird.

Für die Halbleiter-Equipment-Industrie prognostizieren aktuelle Studien führender Marktforschungsinstitute wie Gartner und iSuppli Marktwachstumsraten für 2010 im Bereich zwischen 45 und 47%. Für 2011 rechnet Gartner mit einem weiteren Wachstum von 30,2%. Diese Prognosen beziehen sich jedoch auf Märkte, die für große „Frontend“-orientierte Hersteller bestimmend sind und somit für uns nur eine bedingte Aussagekraft haben. Entsprechend haben wir in unserer internen Planung diese Wachstumsraten nicht antizipiert und unterstellen eine stabile Entwicklung, die Umsätze auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres vorsieht. Dabei gehen wir davon aus, dass uns aus dem im Februar 2010 erworbenen Geschäftsbetrieb der HamaTech APE GmbH & Co. KG Umsätze in ähnlicher Höhe zufließen, wie wir sie im Berichtsjahr aus den nicht fortgeführten Aktivitäten im Bereich Test Systeme erzielt haben. Trotz der sich uns weiterhin stellenden Herausforderungen der Weltwirtschaft planen wir im Jahr 2010 stärker in Forschung und Entwicklung zu investieren und damit mittel- bis langfristig unsere Markt- und Technologieposition in den von uns adressierten Märkten auszubauen. Gleichzeitig gilt unser Augenmerk im laufenden Jahr dem Umzug unserer Coater- und Developer-Fertigung an den Standort Sternenfels sowie der Integration der HamaTech APE in die SÜSS MicroTec-Gruppe.

Unter der Annahme, dass der Umsatzanteil des nicht fortgeführten Bereichs Test Systeme am Konzernumsatz durch die HamaTech APE ersetzt werden kann, gehen wir davon aus, im Geschäftsjahr 2010 eine Steigerung unseres operativen Ergebnisses (EBIT) im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr erreichen zu können.

Weiterhin sollten wir in 2010 bei stabilen Umsätzen in der Lage sein, einen positiven freien Cashflow bereinigt um die Effekte aus dem Kauf der HamaTech APE sowie der Gebäude am Standort Sternenfels zu erwirtschaften.

Entwickeln sich die von uns adressierten Märkte in der oben beschriebenen Form und gelingt es dem SÜSS MicroTec-Konzern, seine Produktpalette konsequent an den Marktbedürfnissen auszurichten, gehen wir für 2011 von steigenden Auftragseingängen und Umsätzen aus. Je nach Umsatzwachstum erscheint das Erreichen einer EBIT-Marge zwischen 8 und 10% möglich. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 11. März 2010

Der Vorstand

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
Finanzvorstand

KONZERNABSCHLUSS

74 KONZERNABSCHLUSS NACH IFRS

- 74 Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
- 75 Gesamtergebnisrechnung
- 76 Konzernbilanz
- 78 Konzern-Kapitalflussrechnung
- 80 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
- 82 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2009
- 84 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2008
- 86 Segmentberichterstattung

88 KONZERNANHANG

- 103 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
- 110 Erläuterungen zu den Aktiva
- 114 Erläuterungen zu den Passiva
- 127 Sonstige Angaben



KONZERNABSCHLUSS

KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

in T€	Anhang	01.01.2009 – 31.12.2009	01.01.2008 – 31.12.2008
Umsatzerlöse	(3)	103.901	121.495
Umsatzkosten	(4)	-65.058	-83.146
Bruttoergebnis vom Umsatz		38.843	38.349
Vertriebskosten		-16.674	-20.429
Forschungs- und Entwicklungskosten		-4.871	-5.698
Verwaltungskosten		-13.939	-16.821
Abschreibungen des Geschäfts- oder Firmenwerts		0	-4.426
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	2.941	4.650
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-3.520	-4.326
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):		7.567	9.207
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-4.787	-17.908
Operatives Ergebnis (EBIT)		2.780	-8.701
Finanzergebnis	(7)	-139	-804
Gewinn/Verlust aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern		2.641	-9.505
Ertragsteuern	(8)	-2.105	-2.054
Gewinn/Verlust aus fortgeführten Aktivitäten		536	-11.559
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)	(2f)	-5.393	-2.342
Gewinn/Verlust nach Steuern		-4.857	-13.901
Davon Minderheitsanteile		-46	-30
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		-4.811	-13.871
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,03	-0,68
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		-0,31	-0,14
Ergebnis je Aktie (verwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,03	-0,68
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		-0,31	-0,14

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS)

in T€	Anhang	01.01.2009 – 31.12.2009	01.01.2008 – 31.12.2008
Periodenergebnis		-4.857	-13.901
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere		379	-53
Fremdwährungsanpassung		-80	1.358
Absicherung künftiger Zahlungsströme		-202	0
Latente Steuern		-49	15
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen		48	1.320
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen		-4.809	-12.581
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		-4.763	-12.551
Davon Minderheitsanteile		-46	-30



KONZERNBILANZ (IFRS)

AKTIVA in T€	Anhang	31.12.2009	31.12.2008
Langfristige Vermögenswerte		39.954	48.600
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	13.837	15.113
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	13.599	17.767
Sachanlagen	(13)	4.081	5.421
Sonstige Finanzanlagen		0	5
Steuererstattungsansprüche	(19)	121	573
Sonstige Vermögenswerte	(14)	554	664
Latente Steueransprüche	(8)	7.762	9.057
Kurzfristige Vermögenswerte		96.480	104.960
Vorräte	(15)	40.790	54.596
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	14.842	23.142
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	355	848
Wertpapiere	(18)	10.489	3.759
Steuererstattungsansprüche	(19)	265	298
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.621	20.603
Sonstige Vermögenswerte	(20)	1.595	1.714
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	(2f)	7.523	–
Bilanzsumme		136.434	153.560

PASSIVA in T€	Anhang	31.12.2009	31.12.2008
Eigenkapital		86.060	90.617
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		85.859	90.370
Gezeichnetes Kapital	(21)	17.019	17.019
Rücklagen	(21)	69.583	74.142
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-743	-791
Minderheitsanteile		201	247
Langfristige Schulden		19.988	18.554
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	3.003	3.026
Rückstellungen	(23)	711	902
Finanzschulden	(24)	10.962	9.199
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		67	0
Latente Steuerschulden	(8)	5.245	5.427
Kurzfristige Schulden		30.386	44.389
Rückstellungen	(25)	1.772	3.161
Steuerschulden	(28)	595	801
Finanzschulden	(24)	1.747	5.758
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(26)	4.536	5.365
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.458	5.116
Sonstige Verbindlichkeiten	(27)	14.906	24.188
Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten	(2f)	2.372	–
Bilanzsumme		136.434	153.560



KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

in T€	01.01.2009 – 31.12.2009	01.01.2008 – 31.12.2008
Gewinn/Verlust (nach Steuern)	-4.857	-13.901
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	4.052	12.305
Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	4.168	4.426
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.506	1.630
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	14	98
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	448	287
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-555	563
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	252	630
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-629	-135
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	0	18
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	432	-1.628
Veränderung des Vorratsvermögens	8.297	291
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.638	3.227
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	609	709
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-23	288
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-139	-3.880
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-9.204	4.119
Veränderung der latenten Steuern	1.092	336
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten	12.101	9.383
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Aktivitäten	11.999	9.991

in T€	01.01.2009 – 31.12.2009	01.01.2008 – 31.12.2008
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-417	-1.801
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.831	-7.582
Auszahlungen für den Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	-6.730	-3.757
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	12	12
Einzahlung aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen	0	1.906
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten	-9.966	-11.222
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten	-9.843	-10.845
Tilgung von Bankdarlehen	-79	-680
Tilgung der Wandelanleihe	0	-373
Tilgung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-4.601	2.573
Tilgung übriger Finanzverbindlichkeiten	-344	-117
Aufnahme übriger Finanzverbindlichkeiten	2.957	0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten	-2.067	1.403
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten	-2.067	1.745
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	128	947
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	196	511
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang	20.603	20.092
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	20.799	20.603
Abzüglich flüssiger Mittel der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und der nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende des Berichtszeitraums	-178	-199
Flüssige Mittel zum Ende der Periode (Konzernbilanz)	20.621	20.404
Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	722	838
Zinseinnahmen während der Periode	978	639
Steuerzahlungen während der Periode	796	2.965
Steuererstattungen während der Periode	-42	470



KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage
Stand 01.01.2008	17.019	92.212	433
Zuführung auf Grund Ausgabe von Bezugsrechten		630	
Periodenergebnis			
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen			
Stand 31.12.2008	17.019	92.842	433
Stand 01.01.2009	17.019	92.842	433
Zuführung auf Grund Ausgabe von Bezugsrechten		252	
Periodenergebnis			
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen			
Stand 31.12.2009	17.019	93.094	433

Bilanzgewinn/ -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
-5.262	-2.111	102.291	277	102.568
		630		630
-13.871		-13.871	-43	-13.914
	1.320	1.320	13	1.333
-19.133	-791	90.370	247	90.617
-19.133	-791	90.370	247	90.617
		252		252
-4.811		-4.811	-46	-4.857
	48	48	0	48
-23.944	-743	85.859	201	86.060



ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

Anlagespiegel 2009

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						31.12.2009
	01.01.2009	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Umklassi- fizierung in „Held for sale“	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.970	-29	1.242	14	3.931	3.706	14.560
2. Entwicklungskosten	30.959	-335	1.589	0	843	0	31.370
3. Aktivierte Leasinggegenstände							
Software	191	-10	2.957	0	0	0	3.138
	52.120	-374	5.788	14	4.774	3.706	49.068
II. Geschäfts- oder Firmenwert	36.604	0	0	0	4.168	0	32.436
III. Sachanlagen							
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.903	-87	73	76	200	16	3.749
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.168	-218	135	509	273	44	10.277
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.154	-90	157	46	1.548	976	9.743
4. Fahrzeuge	516	-4	0	0	6	42	464
5. Anlagen im Bau	138	-2	0	-136	0	0	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände							
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	436	-13	0	0	0	0	423
Technische Anlagen und Maschinen	815	-20	52	-509	0	0	338
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	761	-2	0	0	0	0	759
	28.891	-436	417	-14	2.027	1.078	25.753
IV. Finanzanlagen							
1. Sonstige Beteiligungen	2.095	0	0	-2.095	0	0	0
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	2.095	5	0	2.263
	2.268	0	0	0	5	0	2.263

* Die Zugänge zu den kumulierten Abschreibungen entfallen in Höhe von T€ 4.787 auf fortgeführte und in Höhe von T€ 4.939 auf nicht fortgeführte Aktivitäten. Die Zugänge zu den kumulierten Abschreibungen bei den nicht fortgeführten Aktivitäten enthalten Abschreibungen wegen Wertminderungen in Höhe von T€ 4.690.

Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
01.01.2009	Währungs- differenz	Zugang*	Umbuchungen/ Umgliederungen	Umklassi- fizierung in „Held for sale“	Abgang	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
16.202	-16	1.386	0	3.931	873	12.768	4.768	1.792
20.614	-155	2.444	0	843	0	22.060	10.345	9.310
191	-10	222	0	0	0	403	0	2.735
37.007	-181	4.052	0	4.774	873	35.231	15.113	13.837
18.837	0	4.168	0	4.168	0	18.837	17.767	13.599
3.198	-70	149	0	132	16	3.129	705	620
8.645	-216	400	267	273	43	8.780	1.523	1.497
9.640	-78	857	0	1.444	971	8.004	2.514	1.739
436	-2	11	0	6	24	415	80	49
0	0	0	0	0	0	0	138	0
271	-10	69	0	0	0	330	165	93
536	-17	15	-267	0	0	267	279	71
744	-2	5	0	0	0	747	17	12
23.470	-395	1.506	0	1.855	1.054	21.672	5.421	4.081
2.095	0	0	-2.095	0	0	0	0	0
168	0	0	2.095	0	0	2.263	5	0
2.263	0	0	0	0	0	2.263	5	0



ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

Anlagespiegel 2008

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.2008
	01.01.2008	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.979	169	2.823	0	1	20.970
2. Entwicklungskosten	25.800	526	4.759	0	126	30.959
3. Aktivierte Leasinggegenstände						
Software	146	45	0	0	0	191
	43.925	740	7.582	0	127	52.120
II. Geschäfts- oder Firmenwert	36.372	232	0	0	0	36.604
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.581	256	122	0	56	3.903
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.622	546	345	-203	142	10.168
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.919	332	1.061	203	361	12.154
4. Fahrzeuge	508	7	5	0	4	516
5. Anlagen im Bau	24	-13	139	0	12	138
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	324	22	90	0	0	436
Technische Anlagen und Maschinen	794	114	39	0	132	815
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	754	7	0	0	0	761
	26.526	1.271	1.801	0	707	28.891
IV. Finanzanlagen						
1. Sonstige Beteiligungen*	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	0	0	173
	2.268	0	0	0	0	2.268

* im Vorjahr At-equity bewertete Beteiligungen

Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
01.01.2008	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	
14.687	136	1.380	0	1	16.202	3.292	4.768	
9.609	206	10.925	0	126	20.614	16.191	10.345	
146	45	0	0	0	191	0	0	
24.442	387	12.305	0	127	37.007	19.483	15.113	
14.411	0	4.426	0	0	18.837	21.961	17.767	
2.895	185	174	0	56	3.198	686	705	
8.118	410	422	-163	142	8.645	1.504	1.523	
8.668	253	819	163	263	9.640	2.251	2.514	
405	6	29	0	4	436	103	80	
0	0	0	0	0	0	24	138	
154	14	103	0	0	271	170	165	
505	85	78	0	132	536	289	279	
732	7	5	0	0	744	22	17	
21.477	960	1.630	0	597	23.470	5.049	5.421	
2.095	0	0	0	0	2.095	0	0	
168	0	0	0	0	168	5	5	
2.263	0	0	0	0	2.263	5	5	



SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

in T€	Lithografie		Substrat Bonder		Sonstige	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Außenumsatz	77.573	98.843	18.313	16.145	8.015	6.507
Innenumsatz	0	0	0	0	5.637	6.598
Gesamter Umsatz	77.573	98.843	18.313	16.145	13.652	13.105
Segmentergebnis (EBIT)	11.742	18.607	-3.848	-6.845	-5.114	-20.463
Ergebnis vor Steuern	11.641	18.378	-3.857	-6.861	-5.143	-21.022
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge	77	-2.443	-748	-2.186	592	-13.025
Segmentvermögen	53.312	64.080	25.400	25.612	8.584	10.325
– davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
Konzernaktiva						
Segmentsschulden	-15.646	-21.384	-5.686	-5.805	-2.701	-3.625
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
Konzernschulden						
Abschreibungen	1.810	2.195	1.661	1.914	1.316	13.799
– davon planmäßig	1.810	2.195	1.661	1.251	1.316	1.353
– davon außerplanmäßig	0	0	0	663	0	12.446
Investitionen / Capital expenditure	722	2.496	1.062	2.736	1.341	3.773
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	324	356	115	116	59	73

Segmentinformationen nach Regionen

in T€	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Europa	39.735	50.225	2.125	6.352	65.444	74.235
Nordamerika	24.152	39.301	1.088	2.883	26.111	36.429
Japan	12.010	15.396	19	99	2.656	5.926
Sonstiges Asien	44.381	44.382	16	49	784	924
Rest	27	8	0	0	0	0
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-1.125	-1.466
Gesamt	120.305	149.312	3.325	9.383	93.870	116.048

Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten		Konsolidierungseffekte		Summe	
2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
103.901	121.495	16.404	27.817	–	–	120.305	149.312
5.637	6.598	0	0	-5.637	-6.598	0	0
109.538	128.093	16.404	27.817	-5.637	-6.598	120.305	149.312
2.780	-8.701	-5.508	-2.322	–	–	-2.728	-11.023
2.641	-9.505	-5.503	-2.342	–	–	-2.862	-11.847
-79	-17.654	563	-780	–	–	484	-18.434
87.296	100.017	6.574	16.031	–	–	93.870	116.048
13.599	13.599	0	4.168	–	–	13.599	17.767
						42.564	37.512
						136.434	153.560
-24.033	-30.814	-2.441	-4.475	–	–	-26.474	-35.289
						-23.900	-27.654
						-50.374	-62.943
4.787	17.908	4.939	453	–	–	9.726	18.361
4.787	4.799	249	352	–	–	5.036	5.151
0	13.109	4.690	101	–	–	4.690	13.210
3.125	9.005	123	378	–	–	3.248	9.383
498	545	125	154	–	–	623	699



ANHANG

zum IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009

(1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen in Deutschland sowie Waterbury und Palo Alto in den USA und Neuchatel in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Japan, Thailand, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

a) Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2009 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

b) Nicht vorzeitig angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

IFRS 2 „Share-based Payment – Group Cash-settled Share-based Payment Transactions“

Im Juni 2009 veröffentlichte das IASB Änderungen des IFRS 2 „Share-based Payment – Group Cash-settled Share-based Payment Transactions“, mit denen die Bilanzierung von anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich innerhalb des Konzerns im Einzelabschluss klargestellt wird. Darüber hinaus werden mit der Änderung auch Regelungen in IFRS 2 aufgenommen, die bislang in IFRIC 8 „Scope of IFRS 2“ und in IFRIC 11 „IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions“ enthalten waren.

Der geänderte Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IAS 24 „Related Party Disclosures“

Am 4. November 2009 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 24 „Related Party Disclosures“. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen Vereinfachungen der Angabepflichten von Unternehmen, die staatlich kontrolliert oder bedeutend beeinflusst werden. Weiterhin wurde durch die Änderung des IAS 24 die Definition eines nahestehenden Unternehmens oder einer nahestehenden Person verdeutlicht.

Der geänderte Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IFRIC 19 „Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments“

Das International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) hat am 26. November 2009 mit IFRIC 19 „Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments“ eine Interpretation veröffentlicht, die Hinweise zur Bilanzierung von so genannten debt for equity swaps liefert. IFRIC 19 erläutert die Anforderungen der IFRS, wenn ein Unternehmen teilweise oder vollständig eine finanzielle Verbindlichkeit durch Ausgabe von Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten tilgt.

IFRIC 19 ist verpflichtend für Perioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

Die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen von Standards wurden im Geschäftsjahr von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2009 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Von einer vorzeitigen Anwendung der Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 16. September 2009 wurde die Verordnung 839/2009 bekannt gemacht, mit der die vom IASB am 31. Juli 2008 unter dem Titel „Geeignete Grundgeschäfte“ veröffentlichten Änderungen an IAS 39 übernommen wurden. Durch die Änderungen wird klargestellt, wie bei der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften mit dem Inflationsanteil von Finanzinstrumenten und mit Optionskontrakten, die als Sicherungsinstrument genutzt werden, zu verfahren ist.

Der geänderte Standard ist erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2009 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2010 keine Auswirkungen.



IFRIC 17 „Distributions of Non-cash Assets to Owners“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 27. November 2009 wurde die Verordnung 1142/2009 bekannt gemacht, mit der der am 27. November 2008 vom IFRIC veröffentlichte IFRIC 17 übernommen wurde. IFRIC 17 stellt klar und erläutert, wie Sachdividenden an Eigentümer eines Unternehmens zu bilanzieren sind. Mit der gleichen Verordnung wurden auch sich durch IFRIC 17 ergebende Änderungen an IFRS 5 und an IAS 10 übernommen.

IFRIC 17 und die entsprechenden Änderungen in IFRS 5 und IAS 10 sind erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Oktober 2009 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2010 keine Auswirkungen.

IAS 32 „Financial Instruments: Presentation“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24. Dezember 2009 wurde die Verordnung 1293/2009 bekannt gemacht, mit der die am 8. Oktober 2009 vom IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 32 übernommen wurden. Die Änderungen betreffen die Bilanzierung beim Emittenten von Bezugsrechten, Optionen und Optionsscheinen auf den Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten, die in einer anderen Währung als der funktionalen Währung des Emittenten denominiert sind. Bisher wurden solche Fälle als derivative Verbindlichkeiten bilanziert. Solche Bezugsrechte, die zu einem festgelegten Währungsbetrag anteilig an die bestehenden Anteilseigner eines Unternehmens ausgegeben werden, sind nach der Neuregelung als Eigenkapital zu klassifizieren. Die Währung, auf die der Ausübungspreis lautet, ist dabei unbeachtlich.

Die Änderungen an IAS 32 sind erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Januar 2010 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2011 keine Auswirkungen.

IFRIC 16 „Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 5. Juni 2009 wurde die Verordnung (EG) 460/2009 bekannt gemacht, mit der der im Juli 2008 vom IFRIC verabschiedete IFRIC 16 „Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation“ übernommen wurde. Ziel der Interpretation ist eine Klarstellung zweier Sachverhalte, die sich im Rahmen der beiden Standards IAS 21 „The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates“ und IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ im Zusammenhang mit der Bilanzierung der Absicherung von Fremdwährungsrisiken innerhalb eines Unternehmens und seiner ausländischen Geschäftsbetriebe ergeben.

IFRIC 16 stellt klar, was als Risiko bei der Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb anzusehen ist und wo innerhalb der Unternehmensgruppe das Sicherungsinstrument zur Minderung dieses Risikos gehalten werden darf.

Die Interpretation ist erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2009 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2010 keine Auswirkungen.

c) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag eines Segments auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt sind. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.



Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingsschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingsschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Sonstige Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden der Bewertungskategorie „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ zugeordnet und werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt, da eine zuverlässige Ermittlung des Fair Values nicht möglich ist.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen. Im Falle einer Wertminderung wird das Kumulierte übrige Eigenkapital um den Wertminderungsbetrag reduziert und der entsprechende Betrag unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.



Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Aktienbasierte Vergütungen

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfanges liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der jeweiligen Funktionskosten ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Anleihen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Anleihen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt. Statt der bisher in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählten Darstellung der nicht fortgeführten Aktivitäten in einer gesonderten Spalte erfolgt der Ausweis dieser Aktivitäten nun in einer gesonderten Zeile. Ergänzende Angaben werden im Anhang gemacht.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.



Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Cashflow Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgesetzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

d) Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturlageentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2009 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen T€ 383 (2008: T€ 994).

Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Durchschnittlich errechnet sich dabei ein jährliches Wachstum von 4,8 % (2008: 1,9 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 9,9 % (2008: 9,2 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.



Auf Grund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

e) Konsolidierung

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2009		2008	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 € vs 1 USD	1,440	1,397	1,398	1,474
1 € vs 1 JPY	133,070	130,272	126,400	152,522
1 € vs 1 GBP	0,889	0,896	0,960	0,799
1 € vs 1 CHF	1,484	1,507	1,486	1,585
1 € vs 1 TWD	46,208	46,112	46,267	46,614
1 € vs 1 SGD	2,018	2,026	2,018	2,078
1 € vs 1 CNY	9,800	9,543	9,663	10,301
1 € vs 1 KRW	1.670,940	1.783,230	1.784,480	1.604,175
1 € vs 1 THB	47,975	48,247	48,855	48,672

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ergaben sich keine Veränderungen des Konsolidierungskreises.

Im Vorjahr wurde die neugegründete Süss MicroTec Korea Co. Ltd. in den Konsolidierungskreis einbezogen, an der die SÜSS MicroTec AG mit 100 % beteiligt ist. Bei der Süss MicroTec Korea Co. Ltd. handelte es sich um eine reine Vertriebsgesellschaft, welche die Präsenz des Konzerns in Korea verstärken soll. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis war für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns nicht wesentlich.

Ebenfalls im Vorjahr wurde die Beteiligung der SÜSS MicroTec AG an der MFI Technologies Group, Vancouver, endkonsolidiert und befindet sich folglich nicht mehr im Konsolidierungskreis. Im Zuge der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur im Konzern wurden die beiden zur MFI Technologies Group zählenden Gesellschaften MFI Technologies Inc., Vancouver, und MFI Technologies Corporation, USA, die seit Jahren weder über einen aktiven Geschäftsbetrieb verfügten noch werthaltige Vermögenswerte hielten, abgewickelt. Aus der Endkonsolidierung entstand dem Konzern ein Endkonsolidierungserfolg in Höhe von T€ 121.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

	Wäh- rung	gezeichnetes Kapital	Beteili- gung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsoli- dierung
SÜSS MicroTec AG, Garching	EUR	17.019.126,00	Holding	96.400.251,96	-18.029.592,43	voll
Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching	EUR	2.000.100,00	100 %	28.929.093,34	5.180.751,00	voll
Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka *	EUR	511.291,88	100 %	8.793.426,02	-835.142,16	voll
Süss MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	999.279,94	-124.190,12	voll
Süss MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	36.518.116,00	-129.623.756,00	voll
Süss MicroTec S.A.S., Lyon	EUR	1.275.000,00	100 %	118.682,00	477.973,00	voll
Süss MicroOptics S.A., Neuchatel	CHF	500.000,00	85 %	2.408.069,66	-466.790,72	voll
Süss MicroTec Inc., Waterbury	USD	105.000,00	100 %	21.571.798,29	-6.662.029,59	voll
Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	85.132.768,00	25.968.838,00	voll
Süss MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	7.275.216,92	3.434.645,90	voll
Image Technology Inc., Palo Alto	USD	24.287,00	100 %	2.283.555,10	-531.947,07	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose **	USD	1.190.442,00	53,1%	-39.579,00	-2.876,00	at cost
Süss MicroTec Company Ltd, Bangkok ***	THB	4.000.000,00	49 %	1.166.762,00	-14.063.179,87	voll
Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim *	EUR	25.564,59	100 %	297.582,52	91.710,46	voll
Süss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	-659.323,59	28.189,10	voll
Süss MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	-38.529.676,00	-41.276.349,00	voll
Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz	EUR	51.129,19	10 %	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand ****	EUR	52.000,00	10 %	1.184.160,00	11.639,00	at cost

* Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

** auf Grund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

*** Vollkonsolidierung über Kontrollausübung

**** Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2008

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.



Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2009 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

Am 13. Januar 2010 hat die SÜSS MicroTec AG den erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen zum Kauf der HamaTech APE GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Singulus Technologies AG, mitgeteilt. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 12. Januar 2010 vorbehaltlich vereinbarter Closing-Konditionen von beiden Parteien unterzeichnet und sieht einen Kaufpreis von 4,5 Mio. € sowie den Erwerb des Grundstücks und des Firmengebäudes am Standort Sternenfels zu einem Kaufpreis von ebenfalls 4,5 Mio. € vor. Am 15. Februar 2010 wurde die Transaktion vollzogen.

Die HamaTech APE GmbH & Co. KG hat sich als weltweit führender Ausrüster für die Reinigung von Fotomasken in der Halbleiterindustrie etabliert und beschäftigt am Standort Sternenfels und in den Auslandsgesellschaften etwa 80 Mitarbeiter.

f) Nicht fortgeführte Aktivitäten

Am 28. Januar 2010 gab die SÜSS MicroTec AG die Veräußerung des Segments Test Systeme bekannt. Zum Bilanzstichtag lagen sämtliche Voraussetzungen zur Bilanzierung des Geschäftsbereichs Test Systeme als aufzugebender Geschäftsbereich nach IFRS 5 vor.

Das Segment Test Systeme ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Dort sind Entwicklung, Produktion und der Vertrieb in Europa angesiedelt. In Asien und Nordamerika erfolgt der Vertrieb über Gesellschaften des SÜSS-Konzerns oder über externe Repräsentanten.

Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der Süss MicroTec Test Systems GmbH. Demzufolge umfasst der aufzugebende Geschäftsbereich im Wesentlichen die Vermögenswerte und Schulden dieser Gesellschaft. Zudem wurden einzelne Vermögenswerte von Auslandstöchtern veräußert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis für das Segment Test Systeme besteht aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente beträgt 4,5 Mio. € wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Käuferin bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig ist, die nach der Transaktion von dem Verkäufer erfüllt werden müssen und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führen.

Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wird, stellt sich wie folgt dar:

in T€	2009	2008
Umsatzerlöse	16.404	25.046
Kosten und Aufwendungen	-17.217	-27.423
Verlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Verkaufskosten	-4.690	-
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern	-5.503	-2.377
Ertragsteuern	110	0
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern	-5.393	-2.377

Der Verlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Verkaufskosten resultiert aus Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmwerts in Höhe von T€ 4.168 sowie immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen.

Weiterhin enthält die Ergebniszeile aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) des Vorjahres in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung das Ergebnis des Segments Device Bonder. Im Geschäftsjahr 2007 hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Device Bondern getrennt. Die in St. Jeoire, Frankreich, angesiedelte Suss MicroTec S.A.S. hat sich mit dem früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. auf die Veräußerung des Device Bonder-Geschäfts an eine vom früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. gehaltene Gesellschaft im Rahmen eines Management Buy Out geeinigt. Aus dem zum 31. Dezember 2007 noch vorhandenen Auftragsbestands an Device Bondern erzielte der Süss-Konzern im Vorjahr noch folgendes Ergebnis:

in T€	2008
Umsatzerlöse	2.771
Kosten und Aufwendungen	-2.736
Verlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Verkaufskosten	-
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern	35
Ertragsteuern	0
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern	35



Die in der Konzernbilanz zusammengefassten Positionen „Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte“ und „Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten“ beinhalten zum Bilanzstichtag ausschließlich Vermögenswerte und Schulden des Segments Test Systeme und setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	Nicht fortgeführte Aktivitäten 31.12.09
Sachanlagen	171
Sonstige Finanzanlagen	5
Steuererstattungsansprüche	400
Sonstige Vermögenswerte	142
Latente Steueransprüche	21
Vorräte	4.548
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.002
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	56
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	178
Summe der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte	7.523
Rückstellungen	605
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	727
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	435
Sonstige Verbindlichkeiten	605
Summe der zur Veräußerung bestimmten Verbindlichkeiten	2.372

Risikoberichterstattung

Auf die Ausführungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu betrachten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN-UND- VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns.

(3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Maschinen	80.958	100.069
Ersatzteile	10.321	9.478
Serviceleistungen	4.873	5.702
Sonstige	7.749	6.246
Umsatzerlöse	103.901	121.495

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Maskengeschäft sowie aus den Bereichen Mikrooptik und C4NP.

(4) Umsatzkosten

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 1.987 enthalten. Die Abschreibungen betreffen mit T€ 629 Entwicklungsprojekte im Bereich Lithographie und mit T€ 1.358 den Bereich Substrat Bonder. Im Vorjahr betrugen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen T€ 10.705, davon hatten 8.683 T€ außerordentlichen Charakter (T€ 8.020 betrafen die Abwertung des C4NP-Projektes, T€ 663 betrafen Entwicklungsprojekte im Bereich Substrat Bonder).

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von T€ 3.531 (2008: T€ 4.335) eingeflossen. Dabei entfallen T€ 2.350 (2008: T€ 2.256) auf Bestände des Bereichs Lithographie und T€ 1.181 (2008: T€ 2.079) auf Bestände des Bereichs Substrat Bonder. Zusätzlich fielen im Vorjahr T€ 1.181 an Wertminderungen im Rahmen der verlustfreien Bewertung angearbeiteter Lagerbestände für die noch auszuliefernden C4NP-Maschinen an.

Im Vorjahr enthielten die Umsatzkosten Abfindungen in Höhe von T€ 109, die im Rahmen von Personalabbaumaßnahmen im Bereich Substrat Bonder anfielen.



(5) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Fremdwährungsgewinne	2.177	3.470
Rückstellungsaufösungen	112	124
KFZ-Sachbezüge	223	128
Sonstige Zuschüsse	12	156
Endkonsolidierung MFI	0	121
Versicherungsleistungen	18	5
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	274	0
Kommissionen	119	0
Sonstiges	6	646
Sonstige betriebliche Erträge	2.941	4.650

Durch die Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen im ersten Quartal des Berichtsjahres sind der Gesellschaft Fremdwährungsgewinne aus dem operativen Geschäft entstanden, das in den Fremdwährungen US-Dollar und japanischer Yen abgewickelt wurde. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkursicherung.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 112 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Abfindungen. Die Erträge im Vorjahr (T€ 124) gingen im Wesentlichen auf gesunkene Garantie- und Gewährleistungskosten zurück.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen – wie im Vorjahr – insbesondere erhaltene Aufwandszuschüsse aus Förderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Fremdwährungsverluste	2.539	3.501
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	0	401
Sonstige Steuern	258	270
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	229	0
Sonstiges	494	154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.520	4.326

Durch die Abwertung des US-Dollars im Verhältnis zum Euro sind dem Unternehmen in den Quartalen zwei bis vier Fremdwährungsverluste im operativen Geschäft entstanden. Zudem belasteten sowohl realisierte sowie noch unrealisierte Kursverluste aus geschlossenen Fremdwährungskontrakten im Bereich des US-Dollars und des japanischen Yen vor allem im ersten Quartal des Berichtsjahres das Währungsergebnis.

Die Zuführung von Wertberichtigungen im Vorjahr in Höhe von T€ 401 wurde vor allem im Segment Substrat Bonder notwendig.

(7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie dem sonstigen Finanzergebnis zusammen.

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€	2009	2008
Bankverbindlichkeiten	667	671
Pensionsrückstellungen	0	113
Optionsanleihe	0	26
Zinsswaps	0	389
Bezahlte Stückzinsen	86	66
Sonstige Zinsaufwendungen	44	44
Zinsaufwendungen	797	1.309

Die Zinsaufwendungen sind im Berichtsjahr deutlich gesunken. Nach T€ 1.309 im Vorjahr beliefen sie sich auf T€ 797. Der wesentliche Grund für den Rückgang waren die positiven Marktwertveränderungen der geschlossenen Zinssicherungskontrakte. Während im Vorjahr noch Verluste von T€ 389 aus der negativen Marktwertentwicklung hingenommen werden mussten, stand im Berichtsjahr ein Ertrag zu Buch, der nachfolgend unter den Zinserträgen erläutert wird.

Weiterhin weist die Gesellschaft die Zinsaufwendungen aus Pensionsrückstellungen erstmals im Berichtsjahr nicht mehr unter den Zinsaufwendungen aus, sondern ordnet sie als Personalkosten den einzelnen Funktionsbereichen zu.

Die Zinsaufwendungen aus der Optionsanleihe bestanden im Vorjahr aus Zinszahlungen an die Anleihegläubiger (T€ 8) und aus dem Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Rückzahlungsbetrages bei Laufzeitende (T€ 18). Die Optionsanleihe wurde im Vorjahr in voller Höhe getilgt.

Die Zinserträge in Höhe von T€ 701 (2008: T€ 554) resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren. Enthalten ist außerdem die Marktwertveränderung der geschlossenen Zinssicherungskontrakte (Zinsswaps), die im Berichtsjahr zu einem Ertrag von T€ 103 (2008: T€ -389) führte.

Das sonstige Finanzergebnis in Höhe von T€ 43 (2008: T€ 49) enthält im Berichtsjahr im Wesentlichen Avalprovisionen in Höhe von T€ 36 (2008: T€ 49).



(8) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in T€	2009	2008
Deutsche Körperschaftsteuer	1.068	675
Deutsche Gewerbeertragsteuer	896	594
Ausländische Ertragsteuer	141	785
Gesamtaufwand	2.105	2.054
... davon laufend	808	1.607
... davon latent	1.297	447

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

in %	2009	2008
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	15,00 %	15,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuersatz	12,43 %	12,43 %
Kombinierter Steuersatz	28,25 %	28,25 %

in T€	2009	2008
Ergebnis vor Steuern	2.641	-9.505
Erwartete Ertragsteuern	746	-2.685
Abweichende Steuersätze im Ausland	-641	-865
Außerplanmäßige Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts (fortgeführte Aktivitäten)	0	1.250
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	69	94
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	154	933
Steueraufwand Vorjahre	53	5
Veränderung in der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche	2.323	2.698
Veränderung permanenter Differenzen	0	1.289
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-203	0
Steuerfreie Erträge	-13	-35
Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen aus nicht fortgeführten Aktivitäten	-266	-662
Sonstiges	-117	32
Effektive Ertragsteuern	2.105	2.054

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von T€ 1.359 (2008: T€ 4.739). Statt einen Steueraufwand in Höhe von T€ 746 auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im Berichtsjahr einen deutlich höheren Steueraufwand von T€ 2.105.

Wie bereits im Vorjahr liegt der wesentliche Grund für diese Abweichung in der Veränderung der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche. Der größte Teil dieser Veränderung der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche betrifft die Suss MicroTec Inc. in den USA.

Der nicht fortgeführte Bereich Test Systeme bzw. die Suss MicroTec Test Systems GmbH bildete bis zum Vollzug der Transaktion eine ertragsteuerliche Organschaft. Da die dargestellte Überleitungsrechnung auf das Vorsteuerergebnis der fortgeführten Aktivitäten abstellt, entsteht in Höhe des der Organträgerin zuzurechnenden und aktivierungsfähigen Verlustes eine Überleitungsposition. Diese betrug im Berichtsjahr T€ -266 (2008: T€ -662).

Weiterhin trugen im Vorjahr die Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert des Maskengeschäfts in Höhe von T€ 1.250 und nicht abzugsfähige Betriebsausgaben in Höhe von T€ 933 zur Abweichung der effektiven Ertragsteuern von den erwarteten Ertragsteuern bei. Die Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert ist steuerlich nicht abzugsfähig und somit als Überleitungsposition anzusetzen. Die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben beinhalten im Wesentlichen den bei der Muttergesellschaft erfassten Aufwand aus den Aktienoptionsplänen. Im Berichtsjahr betragen die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben lediglich T€ 59 und waren somit von untergeordneter Bedeutung.

In Folge der konzerninternen Übertragung der Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH von der Suss MicroTec Inc. an die SÜSS MicroTec AG entstanden im Vorjahr permanente Differenzen. Daraus resultierte eine Überleitungsposition zwischen effektiven und erwarteten Ertragsteuern in Höhe von T€ 1.289.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

	Aktiva		Passiva	
	2009	2008	2009	2008
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.194	2.579	3	12
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.101	1.125	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115	249	21	18
Langfristige Rückstellungen	249	537	81	0
Immaterielle Vermögenswerte	0	2	3.198	3.600
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1	3	301	350
Finanzschulden	5	0	69	108
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.334	1.097
Vorräte	721	1.474	49	48
Sachanlagen	87	1	147	117
Sonstiges	20	1	42	77
Verlustvorträge	3.269	3.086	0	0
Gesamt	7.762	9.057	5.245	5.427



Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von T€ 39.557 (2008: T€ 36.841). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2016 insgesamt T€ 3.334. Im Zeitraum von 2022 bis 2029 verfallen insgesamt T€ 20.968. Verlustvorträge in Höhe von T€ 15.254 sind unbegrenzt nutzbar.

Die Erhöhung der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Verlusten der Süss MicroTec Inc. im Berichtsjahr. Gegenläufig wirkten sich zum einen die Inanspruchnahme von Verlustvorträgen bei der Süss MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG sowie der Verfall von Verlustvorträgen bei der Süss MicroTec KK in Japan aus.

Für Verlustvorträge in Höhe von T€ 24.742 (2008: T€ 19.125) und temporäre Differenzen in Höhe von T€ 2.210 (2008: T€ 5.025) wurden keine latenten Steuern angesetzt.

(9) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in T€	2009	2008
Gewinn / Verlust aus fortgeführten Aktivitäten	536	-11.559
Abzüglich: Minderheitsanteile	-46	-30
Gewinn / Verlust aus fortgeführten Aktivitäten, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	490	-11.589
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien	17.019	17.019
Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert	0,03	-0,68
Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert	0,03	-0,68

In die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) ist für das Berichtsjahr der gewichtete Durchschnitt von 503.550 Aktien (2008: 628.300 Aktien) nicht eingeflossen, da der Ausübungspreis der Optionen über dem durchschnittlichen Marktpreis der SÜSS MicroTec-Aktie lag.

Weiterhin wurden in die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) der gewichtete Durchschnitt von 328.063 Aktien (2008: 0 Aktien) nicht berücksichtigt, da die Ausübungsvoraussetzungen im Berichtsjahr nicht erfüllt waren.

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

(10) Sonstige Angaben zur IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung

Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in T€	2009	2008
Löhne und Gehälter	30.689	35.043
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.283	3.590
Aufwendungen für Altersvorsorge	1.871	2.030
Personalaufwand	35.843	40.663

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen in 2009 T€ 40.938 (2008: T€ 46.100).

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Immaterielle Vermögenswerte	3.571	12.071
Geschäfts- oder Firmenwert	0	4.426
Sachanlagen	1.216	1.411
Abschreibungen	4.787	17.908

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von T€ 1.987 (2008: T€ 10.705) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 1.362 (2008: T€ 1.366) abgeschrieben. Außerdem wurden erstmals Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von T€ 222 (2008: T€ 0) vorgenommen.

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen. Im Vorjahr wurden in Höhe von T€ 8.683 Wertminderungen vorgenommen. Sie entfielen in Höhe von T€ 8.020 auf das C4NP-Projekt und in Höhe von T€ 663 auf Produktentwicklungen im Bereich Substrat Bonder. Die Wertminderungen wurden im Vorjahr in voller Höhe den Umsatzkosten zugeordnet.

Der wesentliche Teil der Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 1.134 (2008: T€ 892) ist in den Verwaltungskosten enthalten.

Zu den in 2008 vorgenommenen Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert verweisen wir auf Textziffer 12 Geschäfts- oder Firmenwert.



ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Im Vorjahr hingegen wurde eine entsprechende Aufteilung nicht vorgenommen.

(11) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von T€ 4.527 (2008: T€ 4.768) Entwicklungsleistungen von T€ 9.310 (2008: T€ 10.345) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von T€ 2.735 (2008: T€ 0) enthalten. Im Berichtsjahr veräußerte die SÜSS MicroTec AG ihre SAP-Anlage an eine Leasinggesellschaft und schloss eine entsprechende Lease-back-Vereinbarung ab. Der Leasingvertrag wurde so gestaltet, dass die geleaste SAP-Anlage dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen ist. Zudem enthält er eine Kaufoption.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder.

(12) Geschäfts- oder Firmenwert

Der Rückgang des Geschäfts- oder Firmenwerts im Berichtsjahr auf T€ 13.599 (2008: T€ 17.767) resultiert aus der Umgliederung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Bereich Test Systeme in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte.

Im Vorjahr wurde eine Wertminderung von T€ 4.426 auf den Geschäfts- oder Firmenwert im Segment Masken vorgenommen. Der Bereich Masken ist im Segment Sonstige angesiedelt und identisch mit dem Tochterunternehmen Image Technology Inc. Die Wertminderung wurde auf Grund einer veränderten Umsatz- und Ertragslage erforderlich.

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert entfällt in voller Höhe auf das Segment Lithografie und enthält keinen Fremdwährungsanteil mehr.

(13) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von T€ 176 (2008: T€ 461) auch geleaste Technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

(14) Sonstige (langfristige) Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen und von Zeitkontenrückdeckungen sowie geleistete Kauttionen für angemietete Bürogebäude.

in T€	2009	2008
Rückdeckungsversicherung	421	514
Kauttionen	132	149
Sonstiges	1	1
Sonstige langfristige Vermögenswerte	554	664

(15) Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in T€	2009	2008
Materialien und Hilfsstoffe	17.858	23.447
Unfertige Erzeugnisse	14.075	19.999
Fertigerzeugnisse	9.473	10.852
Demonstrationsgeräte	9.241	11.722
Handelswaren	256	122
Wertberichtigungen	-10.113	-11.546
Vorratsvermögen	40.790	54.596

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2009 bilanzierten Vorräte in Höhe von T€ 40.790 (2008: 54.596) sind T€ 22.422 (2008: T€ 15.669) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.



Der Rückgang der Vorräte ist in Höhe von T€ 4.548 auf die Umgliederung von Vorräten des nicht fortgeführten Segments Test Systeme in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte bedingt. In der Vorjahreszahl sind diese Vorräte noch enthalten. Sie beliefen sich auf T€ 6.469.

(16) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in T€	2009	2008
Forderungen gegen Dritte	15.225	24.136
Wertberichtigungen	-383	-994
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.842	23.142

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in T€	2009	2008
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	994	538
nicht fortgeführte Aktivitäten	-259	0
Ausbuchung von Forderungen	-78	-107
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-383	-337
Zuführung	109	900
Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	383	994

(17) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in T€	2009	2008
Aktiviert Stückzinsen	229	0
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	43	132
Sonstiges	83	716
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	355	848

Unter den aktivierten Stückzinsen werden geleistete Vorauszahlungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Wertpapieren dargestellt.

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten die positiven Marktwerte aus den Devisentermingeschäften aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften finden sich in der Textziffer 29 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(18) Wertpapiere

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen. Bei den Unternehmensanleihen wurden ausschließlich Papiere von Unternehmen angeschafft, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im Kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von T€ 10.489 (2008: T€ 3.759).

(19) Steuererstattungsansprüche

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von T€ 121 (2008: T€ 573) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Zahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,77 % p.a. zugrunde gelegt.

Das Körperschaftsteuer-Guthaben entfällt in Höhe von T€ 399 auf das Segment Test Systeme und wurde in die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte umgegliedert.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von T€ 265 (2008: T€ 298).

(20) Sonstige (kurzfristige) Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2009	2008
Aktive Rechnungsabgrenzung	490	668
Geleistete Anzahlungen	796	208
Umsatzsteuer	309	838
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.595	1.714

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.



ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

(21) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Bilanzstichtag T€ 17.019 und ist damit zum Vorjahresstichtag unverändert. Es ist in 17.019.126 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von € 1,00 eingeteilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag T€ 4.255 (2008: T€ 4.255).

Am 31. Dezember 2009 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt T€ 1.695 (2008: T€ 5.369). Es ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind T€ 45 dem Aktienoptionsplan 2002, T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 und T€ 900 dem Aktienoptionsplan 2008 zuzuordnen.

in T€	2009	2008
Grundkapital	17.019	17.019
genehmigtes Kapital	4.255	4.255
bedingtes Kapital	1.695	5.369

Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Kapitalrücklage	93.094	92.842
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-23.944	-19.133
Rücklagen	69.583	74.142

Der Kapitalrücklage wurden aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne T€ 252 ergebniswirksam zugeführt. Ausübungen von Aktienoptionen gab es im Berichtsjahr nicht.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust erhöhte sich durch das negative Jahresergebnis von T€ -4.811 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf T€ -23.944.

Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des Kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in T€	2009	2008
Fremdwährungsanpassungen	-753	-2.111
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-53	0
Steuereffekte		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	15	0
Stand zu Beginn der Periode	-791	-2.111
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	-80	1.358
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-202	0
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	379	-53
Steuereffekte		
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	-106	15
Absicherung künftiger Zahlungsströme	57	0
Stand am Ende der Periode	-743	-791

Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr erstmals für ihre bestehenden Zinsswaps Hedge-Accounting angewendet. Die Zinsswaps stammen aus dem Geschäftsjahr 2007 und wurden als Sicherungsinstrument für die variabel verzinslichen Schuldscheine abgeschlossen. Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Marktwertänderungen im Kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Die Durchführung von Hedge-Accounting erfolgte allerdings nur im ersten Quartal, da die Sicherungsbeziehung ab 1. April 2009 nicht mehr effektiv war.

Eigenkapitalmanagement

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr aus dem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhängig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags weiter verringern könnte.



Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

Aktionsoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren zu 100 % ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex

oder

- + der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Aktionsoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

Aktienoptionsplan 2008

In der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 900 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Zusätzlich zu diesen Erfolgszielen muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraums mindestens einmal bei € 5,00 für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei € 5,75 und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und 60. Monat mindestens einmal während der Laufzeit bei € 6,60 gelegen haben.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von T€ 252 (2008: T€ 630) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden aus dem in der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 genehmigten Kapital insgesamt 438.250 Bezugsrechte mit einem Bezugspreis von € 1,30 ausgegebenen. Im Vorjahr wurden keine Aktienoptionen ausgegeben.

Am 31. Dezember 2009 bestanden insgesamt 461.950 Bezugsrechte (2008: 587.650 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Geschäftsjahr gewährten Optionen in Höhe von € 0,95 wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells berechnet.



Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
01.01.08	668.950	7,26
gewährt 2008	0	0,00
ausgeübt 2008	0	0,00
verfallen 2008	81.300	7,30
31.12.08	587.650	7,26
gewährt 2009	438.250	1,30
ausgeübt 2009	0	0,00
verfallen 2009	170.700	7,04
31.12.09	855.200	4,25
noch begebbar	461.950	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

BEREICH DES BEZUGSPREISES

	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate
unter 2,50 €	435.750	1,30	52
2,50 € – 4,99 €	97.050	4,71	9
5,00 € – 7,49 €	0	0,00	0
7,50 € – 9,99 €	322.400	8,12	25
	855.200	4,25	37

(22) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i. d. R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Inländische Verpflichtungen	1.752	1.839
Ausländische Verpflichtungen	1.251	1.187
Gesamt	3.003	3.026

Leistungsorientierte Pläne („Defined benefit plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2009	2008
Abzinsungsfaktor	4,85 % – 5,03 %	5,60 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	4,30 % – 5,30 %	4,30 % – 5,20 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	2,0 %	2,0 %

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtig ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtig sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.



Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2009	2008
Abzinsungsfaktor	3,50 %	3,50 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,50 %	3,50 %
Gehaltssteigerung	1,5 %	1,5 %
Rentensteigerung	0,8 %	0,8 %

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2009 und 2008 wie folgt entwickelt:

in T€	2009	2008
Anwartschaftsbarwert am 1.1.	4.819	4.174
Dienstzeitaufwand	128	125
Zinsaufwand	191	173
Pensionszahlungen	-277	-271
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust	202	359
Währungsveränderungen	-49	259
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	5.014	4.819

Der versicherungsmathematische Verlust des Geschäftsjahres beruht maßgeblich auf dem niedrigeren Abzinsungsfaktor.

in T€	2009	2008
Planvermögen am 1.1.	1.664	1.640
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	61	60
Geleistete Fondsdotierungen	-81	-80
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	0	1
Währungsveränderungen	1	43
Planvermögen am 31.12.	1.645	1.664

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in T€	2009	2008
Barwert der Pensionsverpflichtungen	5.014	4.819
Zeitwert des Planvermögens	-1.645	-1.664
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	3.369	3.155
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	-366	-129
Rückstellung	3.003	3.026

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von T€ 2.909 (2008: T€ 2.794) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in T€	2009	2008
Dienstzeitaufwand	128	125
Personalaufwandskomponente	128	125
Zinsaufwand	191	173
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-61	-60
Zinsaufwandskomponente	130	113

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von T€ 23 (2008: T€ 36) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von T€ 105 (2008: T€ 89) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts, des Planvermögens sowie der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste unterteilt nach Anwartschaftsbarwert und Planvermögen zeigt folgende Tabelle:

in T€	2009	2008	2007	2006
Anwartschaftsbarwert	5.014	4.819	4.174	3.986
Planvermögen	1.645	1.664	1.640	1.281
Deckungsstatus	3.369	3.155	2.534	2.705

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 Ap waren im Betrachtungszeitraum auf Grund des im Rahmen der Bewertung unveränderten Mengengerüsts nicht notwendig.

Beitragsorientierte Pläne („Defined contribution plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2009 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2008: TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 162 (2008: TUSD 120).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von T€ 1.526 (2008: T€ 1.832) abgeführt.



(23) (Langfristige) Rückstellungen

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in T€	Stand 01.01.09	Verbrauch	Zuführung	nicht fortgeführte Aktivitäten	Stand 31.12.09
Altersteilzeit	902	-139	30	-82	711

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Süss MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(24) Finanzschulden

Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2009 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. DEZEMBER 2009

in T€	Restlaufzeit			Summe
	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	833	8.967	0	9.800
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	914	1.995	0	2.909
Gesamt	1.747	10.962	0	12.709

31. DEZEMBER 2008

in T€	Restlaufzeit			Summe
	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.614	9.047	0	14.661
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	144	152	0	296
Gesamt	5.758	9.199	0	14.957

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von T€ 752 (2008: T€ 5.538) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von T€ 9.048 (2008: T€ 9.123) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2009	2008
Kreditlinie	9.951	10.388
Inanspruchnahme	752	5.538
Verfügbare Kreditlinie	9.199	4.850

Die SÜSS MicroTec AG hat im April 2009 Kreditverträge mit drei Banken zur Prolongation der bis zum 31. März 2009 laufenden Kreditlinie unterzeichnet. Durch die Aufnahme eines dritten Konsortialmitglieds wurde die Kreditlinie von 6 Mio. € auf 9 Mio. € erweitert. Die erweiterte Kreditlinie läuft bis zum 31. März 2010 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie ist mit der Verpfändung von Umlaufvermögen und Patenten der betroffenen Inlandsgesellschaften verbunden und dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von T€ 2.450 (Vorjahr: T€ 2.089) in Form von Avalen genutzt.

Im Gegenzug reduzierte sich die lokale Kreditlinie in Japan von 700 Mio. YEN im Vorjahr auf 100 Mio. YEN. Diese Linie wird von einer Bank gestellt und wurde ohne Sicherheiten gewährt. Sie ist zum Bilanzstichtag voll in Anspruch genommen.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 1,88 % (2008: 1,98 %).



Neben der SÜSS MicroTec AG, die im Geschäftsjahr 2007 drei Schuldscheine mit einem Nominalbetrag von jeweils T€ 3.000 begeben hat, verfügt nur noch die Image Technology Inc. über Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

KONZERNGESELLSCHAFT

in T€	2009	2008	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	2.982	2.976	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.982	2.976	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.982	2.976	6,06 %	21.12.2012
Suss MicroTec Lithography GmbH	0	13	3,75 %	30.4.2011
Image Technology Inc.	102	182	9,27 %	26.3.2011
Gesamt	9.048	9.123		
... davon kurzfristig fällig	81	76		
... davon langfristig fällig	8.967	9.047		
... fällig in 2010	81			
2011	21			
2012	8.946			
2013	0			
2014	0			
... später	0			
	9.048			

Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, Technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Im Berichtsjahr hat die SÜSS MicroTec AG ihre im Juli 2008 eingeführte SAP-Software an eine Leasinggesellschaft verkauft und von dieser anschließend zurückgeleast. Der Kaufpreis betrug insgesamt T€ 2.957 und ist der Gesellschaft im vierten Quartal zugeflossen. Als Leasingdauer wurde ein Zeitraum von 40 Monaten vereinbart.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in T€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2009	311	2.350	0
Abschreibungen / Aufwendungen 2008	186	3.053	931
Künftige Verpflichtungen ... fällig in 2010	991	2.182	0
2011	991	1.811	0
2012	974	1.390	0
2013	98	1.265	0
2014	4	3	0
... später	0	0	0
Gesamt zukünftig	3.058	6.651	0
Zinsanteil	149		
Verbindlichkeit 31.12.2009	2.909		
... davon kurzfristig	914		
... davon langfristig	1.995		

(25)(Kurzfristige) Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Garantierückstellungen	1.226	1.907
Abfindungen	81	683
Übrige Rückstellungen	465	571
Kurzfristige Rückstellungen	1.772	3.161

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

In der Rückstellung für Abfindungen sind durchgeführte Personalabbaumaßnahmen am Standort Lyon, Frankreich, berücksichtigt.



Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.09	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Nicht fortgeführte Aktivitäten	Stand 31.12.09
Garantierückstellungen	1.907	-1.026	0	1056	-711	1.226
Abfindungen	683	-359	-92	81	-232	81
Übrige Rückstellungen	571	-362	-20	447	-171	465
Kurzfristige Rückstellungen	3.161	-1.747	-112	1.584	-1.114	1.772

(26) Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2009	2008
Prämien und Provisionen	1.825	1.743
Fremdleistungen	1.753	1.591
Aufsichtsratsvergütung	132	87
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	17	361
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	442	351
Sonstiges	367	1.232
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.536	5.365

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisentermingeschäften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften und Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 29 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(27) Sonstige (kurzfristige) Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2009	2008
Erhaltene Anzahlungen	12.118	19.368
Abgegrenzte Personalkosten	1.785	3.489
Passive Rechnungsabgrenzung	524	776
Umsatzsteuer	326	555
Sonstiges	153	0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	14.906	24.188

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(28) Steuerschulden

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 554 (2008: T€ 201) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 41 (2008: T€ 600).

SONSTIGE ANGABEN

(29) Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.



Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in T€	2009	2008
Finanzielle Vermögenswerte		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	10.489	3.759
Kredite und Forderungen	15.154	23.858
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	43	132
	25.686	27.749
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	459	712
Finanzielle Verbindlichkeiten	18.335	24.430
	18.794	25.142

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in T€	2009		2008	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Finanzielle Vermögenswerte				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.621	20.621	20.603	20.603
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.842	14.842	23.142	23.142
Sonstige Finanzanlagen	0	0	5	5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	355	355	848	848
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	312	312	716	716
bewertet zum Marktwert	43	43	132	132
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	10.489	10.489	3.759	3.759
Finanzielle Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.458	4.458	5.116	5.116
Finanzschulden	12.709	13.476	14.957	14.939
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.800	10.636	14.661	14.617
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	2.909	2.840	296	322
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.536	4.536	5.365	5.365
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	4.077	4.077	4.653	4.653
bewertet zum Marktwert	459	459	712	712

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die Buchwerte entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige Finanzanlagen: Eine zuverlässige Ermittlung des Marktwerts der sonstigen Finanzanlagen ist nicht möglich. Die sonstigen Finanzanlagen sind für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens von untergeordneter Bedeutung.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte / Verbindlichkeiten: Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Wertpapiere: Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2009	2008
Kredite und Forderungen	78	107
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	164	-967
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	53	8

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.



Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die im Vorjahr im Kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von T€ 53 infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2009		2008	
	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva
Devisentermingeschäfte	43	17	132	361
Zinsswaps	0	442	0	351

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des in 2007 begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Im ersten Quartal des Berichtsjahrs hat das Unternehmen erstmals Hedge-Accounting angewendet und die Marktwertschwankungen im Kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Nachdem die Effektivität der Sicherungsbeziehung im zweiten Quartal nicht mehr gegeben war, fiel die Anwendung von Hedge-Accounting weg und die Marktwertschwankungen der Zinsswaps wurden wieder in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst.

(30) Nahestehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der Konzern wird im Geschäftsjahr 2009 von den Angabepflichten nach IAS 24 in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zum mittlerweile ausgeschiedenen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der SÜSS MicroTec AG berührt. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Richter, war zugleich Vorstand der Thin Materials AG, Eichenau. Im ersten Quartal des Berichtsjahres hat die SÜSS MicroTec AG einen Kooperationsvertrag mit dieser Gesellschaft abgeschlossen. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich Dünn-Wafer-Prozessierung. Dabei hat die SÜSS MicroTec AG Intellectual Property (IP) und Know-how für T€ 900 erworben. Das aktivierte IP wird über fünf Jahre abgeschrieben. Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG, die am 24. Juni 2009 stattfand, hat Herr Dr. Richter sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft niedergelegt.

Im Vorjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 in Bezug auf die Geschäftsbeziehung zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats und deren nahen Familienangehörigen berührt. Am 19. Juni 2008 hat Dr. Winfried Süß sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender niedergelegt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Aufwendungen, die oben genannte Kriterien erfüllen, fallen unter die Angabepflichten von IAS 24. So haben verschiedene Konzerngesellschaften (Süss MicroTec Lithography GmbH, Süss MicroTec Test Systems GmbH, Süss MicroTec Inc.) ihre Geschäftsräumlichkeiten von Grundstücksgesellschaften (Süss Grundstücksverwaltungs GbR und Hunger Mountains, USA) gemietet, die von der Familie Süß kontrolliert werden. Dafür sind insgesamt Mietaufwendungen von T€ 931 angefallen. Zudem wurden Gehalts- und Pensionszahlungen von T€ 233 an Mitglieder der Familie Süß geleistet.

Herr Peter Heinz, der bis zum 19. Juni 2008 Mitglied des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG war, ist seit 2007 Mitglied des Boards der Image Technology Inc., einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Süss MicroTec Inc.. Für seine Tätigkeit erhielt Herr Heinz im Vorjahr anteilig eine Vergütung von T€ 4.



(31) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Bestellobligo	7.052	10.458
Mietverpflichtungen	6.150	9.843
Sonstiges	0	1.123
Summe	13.202	21.424

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

In Folge des Ausscheidens von Herrn Dr. Winfried Süß aus dem Aufsichtsrat enthalten die Verpflichtungen aus Mietverträgen keine Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Unternehmen bzw. Personen mehr.

(32) Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Teil von T€ 350 (2008: T€ 350) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Zudem wurde ein Guthaben von T€ 362 (2008: T€ 362) zur Deckung einer Mietbürgschaft verpfändet.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von T€ 432 (2008: T€ -1.628) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte.

Die im Berichtsjahr erfolgte „sale and lease back“-Transaktion des SAP-Projekts wird als Mittelaufnahme im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

(33) Segmentberichterstattung

Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie und Substrat Bonder aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitäten in der Segmentberichterstattung unter den fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt. Unter den nicht fortgeführten Aktivitäten werden die Segmente Test Systeme und Device Bonder zusammengefasst. Im Berichtsjahr enthalten die nicht fortgeführten Aktivitäten allerdings ausschließlich die Zahlen des Segments Test Systeme, da im Bereich Device Bonder keinerlei Aktivitäten mehr stattfanden.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segmentes dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6 und 8 Zoll Wafer-Anwendungen angeboten.

Für das in Sacka bei Dresden angesiedelte Segment Test Systeme bestand zum Bilanzstichtag eine konkrete Verkaufsabsicht, so dass ein Ausweis dieser Segmentaktivitäten unter den nicht fortgeführten Aktivitäten erfolgte. Im Januar 2010 wurde das Segment verkauft. Es umfasste die Entwicklung, Produktion sowie den Vertrieb in Europa von Test-Equipment. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z.B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Das 2007 verkaufte Segment Device Bonder befasste sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die Segmentaktivitäten waren in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befand sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Auf Grund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes waren keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.



Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten seit dem Vorjahr auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des seit 1. Januar 2009 verpflichtend anzuwendenden IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung erstmals die Angabe eines Vorsteuerergebnis je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich. Die Angabe wurde auch für das Vorjahr umgesetzt.

Bereits im Vorjahr wurde die Ermittlung des Segmentergebnisses angepasst. Es enthält seither auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. Die Summe der Segmentergebnisse entspricht damit dem operativen Konzernergebnis (EBIT).

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen. Eine Abstimmbarkeit mit dem Konzernanlagespiegel ist nicht unmittelbar möglich, da in der Segmentberichterstattung die „sale and lease back“-Transaktion der SAP-Software nicht als Investition gezeigt wird.

Die Abschreibungen enthalten im Berichtsjahr Wertminderungen in Höhe von T€ 4.690. Diese resultieren ausschließlich aus der Bewertung zum beizulegenden Wert im Zusammenhang mit den nicht fortgeführten Aktivitäten im Bereich Test Systeme. Im Vorjahr wiesen die Abschreibungen Wertminderungen in Höhe von T€ 13.210 auf. Diese fielen in Höhe von T€ 663 im Segment Substrat Bonder, in Höhe von T€ 101 im Segment Test Systeme und in Höhe von T€ 12.446 im Segment Sonstige an. Die Wertminderungen im Segment Sonstige setzten sich in Höhe von T€ 4.426 aus der Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwert des Bereiches Masken und in Höhe von T€ 8.020 aus der Wertminderung auf die aktivierten Entwicklungskosten für das C4NP-Projekt zusammen.

Im Vorjahr hat die SÜSS MicroTec AG den Ausweis der Mitarbeiterzahlen in der Segmentberichterstattung angepasst. Die Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen des Konzerns wurden erstmals im Berichtsjahr dem Segment zugeordnet, für das sie überwiegend tätig sind. Bisher wurden diese Mitarbeiter dem Segment Sonstige zugeordnet.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Eine Erhebung dieser Information für das Inland ist nicht Gegenstand des Konzernreportings. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

(34) Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2009 waren:

Frank Averdung Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender seit 1. Februar 2009
Zuständigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie

Michael Knopp Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands
Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations

Christian Schubert Diplom-Kaufmann, Metten, Mitglied des Vorstandes bis 31. Mai 2009
Zuständigkeitsbereiche: Materialwirtschaft und Logistik

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr T€ 754. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurde Herrn Knopp T€ 53 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Für den Jahresbonus 2009 von Herrn Averdung und Herrn Knopp wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von T€ 185 gebildet.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

2009

in T€	Frank Averdung	Michael Knopp	Christian Schubert
Barvergütung			
Fixum	245	219	100
Erfolgsbezogen	98	87	5
Summe	343	306	105



2008

in T€	Frank Averdung	Michael Knopp	Christian Schubert
Barvergütung			
Fixum	221	215	62
Erfolgsbezogen	32	53	15
Summe	253	268	77

Weiterhin wurden auf Grund der in 2009 an Vorstände gewährten Optionen T€ 69 (2008: T€ 287) als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von T€ 5 (2008: T€ 5).

Zudem wurden Gehaltszahlungen in Höhe von T€ 195 (2008: T€ 74) an ein ehemaliges Vorstandsmitglied geleistet sowie eine Rückstellung von T€ 0 (2008: T€ 282) für noch zu zahlende Gehälter gebildet.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2009:

Dr. Franz Richter	Eichenau, Vorstand der Thin Materials AG in Eichenau, Aufsichtsratsvorsitzender bis 24. Juni 2009
Weitere Mandate:	Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) EpiSpeed AG, Zug, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) Replisaurus Technologies Inc., Kista, Schweden („Chairman of the Board of Directors“) Industrieverband SEMI International, San Jose, Kalifornien, USA (Mitglied im „International Board of Directors“)
Dr. Stefan Reineck	Kirchartd, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender bis 24.06.2009, ab diesem Zeitpunkt Aufsichtsratsvorsitzender
weitere Mandate:	AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats) NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats) aleo solar Aktiengesellschaft, Prenzlau (Mitglied des Aufsichtsrats) TF Instruments Inc., Monmouth Junction, New Jersey, USA (Mitglied im „Board of Directors“) Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“) Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg an der Havel (Beiratsvorsitzender) bis 31. Oktober 2009
Jan Teichert	Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar
weitere Mandate:	keine

Sebastian Repegather Zürich, Investmentdirector bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz, ab dem 24. Juni 2009

weitere Mandate: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands
(Mitglied im „Board of Directors“)
IED Beteiligungs-GmbH, Frankfurt am Main (Mitglied der Geschäftsführung)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung pro Geschäftsjahr. Gemäß der Satzungsänderung vom 19. Juni 2008 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats € 45.000 p. a., sein Stellvertreter € 40.000 p. a. und jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats € 35.000 p. a. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von € 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

2009

in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und		Gesamt
				Umsatzsteuer		
Sebastian Repegather	ab 24.06.2009	17.500,00	7.500,00	4.050,00		29.050,00
Dr. Franz Richter	bis 24.06.2009	22.500,00	6.000,00	5.415,00		33.915,00
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	42.500,00	13.500,00	21.321,50		77.321,50
Jan Teichert	ganzjährig	37.500,00	13.500,00	9.690,00		60.690,00

2008

in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und		Gesamt
				Umsatzsteuer		
Dr. Winfried Süß	bis 19.06.2008	22.500,00	10.500,00	0,00		33.000,00
Gerhard Rauter	bis 19.06.2008	11.250,00	3.000,00	412,00		14.662,00
Peter Heinz	bis 19.06.2008	7.500,00	4.500,00	4.338,08		16.338,08
Prof. Dr. Anton Heuberger	bis 19.06.2008	7.500,00	3.000,00	3.385,00		13.885,00
Heinz-Peter Verspay	bis 19.06.2008	7.500,00	3.000,00	2.156,25		12.656,25
Dr. Franz Richter	ab 19.06.2008	22.500,00	9.000,00	25.416,83		56.916,83
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	27.500,00	19.500,00	20.521,46		67.521,46
Jan Teichert	ab 19.06.2008	17.500,00	9.000,00	5.086,00		31.586,00

Aus seiner Zeit als Geschäftsführer der heutigen Süss MicroTec Lithography GmbH bestand für Herrn Dr. Süß, dem Aufsichtsratsvorsitzenden bis zum 19. Juni 2008, zum 31.12.2008 eine Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 2.025.


AKTIEN- UND OPTIONSBESTÄNDE DER ORGANMITGLIEDER ZUM JAHRESENDE:

	2009		2008	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind (bis 2.10.2008)	–	–	18.278	150.000
Michael Knopp	22.500	97.500	22.500	30.000
Frank Averdung (ab 01.02.2009)	27.500	67.500	–	–
Christian Schubert (bis 31.05.2009)	–	–	0	0
Sebastian Repegather (ab 24.06.2009)	0	0	–	–
Dr. Franz Richter (bis 24.06.2009)	–	–	101.040	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	40.000	6.600	40.000
Jan Teichert (ab 19.06.2008)	0	0	0	0

(35) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 623 Mitarbeiter (2008: 699 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

in T€	2009	2008
Verwaltung	79	91
Marketing und Vertrieb	238	267
Produktion und Technik	297	316
Summe	614	674

(36) Honorare des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honorar nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB n. F. beträgt T€ 226 (2008: T€ 425) und setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	2009	2008
Abschlussprüfung	224	296
Steuerberatung	0	51
Sonstige Leistungen	2	78
Gesamt	226	425

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung war im Vorjahr das Honorar für die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen enthalten.

Wesentlicher Inhalt der sonstigen Leistungen im Vorjahr waren Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von SAP.

(37) Corporate Governance

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im November 2009 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 mit drei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und zukünftig der aktualisierten Fassung vom 18. Juni 2009 mit vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprechen werden.

Die Entsprechenserklärung wurde im Internet unter www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(38) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Am 7. Januar 2009 hat uns Herr Dr. Winfried Süß, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0 % beträgt (0 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Süß SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 7,53 % beträgt (1.281.000 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,04 % beträgt (518.194 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. Januar 2009 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (508.194 Stimmrechte).



Am 7. Januar 2009 hat uns die Terramater (Stichting), Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Terramater zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg

Am 7. Januar 2009 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Crest Capital S.A. zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg

Am 23. Januar 2009 hat uns die Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2009 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (513.194 Stimmrechte).

Am 15. Januar 2010 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihr 19,70 % (3.352.152 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihr zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 15. Januar 2010 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Januar 2010 die Schwelle von 20 % unterschritten hat und zu diesem Tag 19,70 % beträgt (3.352.152 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

(39) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS Konzernabschluss am 11. März 2010 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 11. März 2010

Der Vorstand



Frank Averdung



Michael Knopp



VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 11. März 2010

SÜSS MicroTec AG

Frank Averdung

Michael Knopp

BESTÄTIGUNGSVERMERK

des Abschlussprüfers

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 12. März 2010

KPMG Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Renner
Wirtschaftsprüfer

Jenuwein
Wirtschaftsprüfer



GLOSSAR

3D-Integration

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte „Through Silicon Vias“ (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-Chip) sowie weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding („Drahtbonden“) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile die durch „Through Silicon Vias“ (TSVs) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben z. B. aus einkristallinem Reist-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42%) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip.

Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

Backend

„Backend“ bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat („Frontend“), beginnt der „Backend“-Prozess. Dort werden die Mikro-

chips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der „Backend“-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene „Backend“-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

Bonden

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mithilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

Bump

(Engl.: Unebenheit); Metallische (Lot, Gold, o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

Coater (Beschichtungsgerät)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

Compound Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

Cost of Ownership (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ steht für „Controlled Collapse Chip Connection“ und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. „NP“ steht dabei für New Process.

Die

„Die“, „IC“ (Integrated Circuit), und „Chip“ sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der Dies spricht man von „Chips“.

DRAM

DRAM=Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird. Weltweit am weitesten verbreitetster Speicherchip.

Fab

(Engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden US Dollar.

Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h., der Chip muss vor der Montage umgedreht werden (engl.: to flip).

Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mithilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

Foundry

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

Frontend

„Frontend“-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das „Backend“ an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

Halbleiter

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

LED

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfach so lange Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.



Lithografie

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im „Frontend“ liegen heute in einer Größenordnung von 32nm (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im „Backend“ werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs benötigt werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

Mask Aligner (Belichtungsgerät)

Mask Aligner richten eine Glasmasken submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS

Micro Electro Mechanical System. MEMS ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

Mikrometer/Mikron

Metrisches Längenmaß. Symbol: μm . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 μm .

Mikrosystem

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

Mikrosystemtechnik

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z.B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

Nanoimprinting / Nano Imprint Lithografie (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

Nanotechnologie

(Griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

Optoelektronik

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit so genannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für

die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

Packaging Foundries

Siehe Backend.

Prober (Test- und Prüfsysteme)

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexible, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal umgewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

Substrat Bonder (Verbindungsgerät)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

Systems-on-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige erforderlich sind oder

ein einzelner ausreicht und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-Chips immer größere Wichtigkeit.

Through-Silicon-Vias (TSV)

Bei der „Through-Silicon-Via“-Technik werden die einzelnen Chipkomponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen („Through-Silicon-Via“) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

Tool

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

Wafer

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalleitungen mit einem Gehäuse zu verbinden.

Yield

Die Ausbeute – eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.



FINANZKALENDER 2010

Geschäftsbericht 2009	30. März
Quartalsbericht 2010	6. Mai
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	23. Juni
Halbjahresfinanzbericht 2010	5. August
6. UBS Best of Germany-Konferenz, New York (USA)	15. – 16. September
Neunmonatsbericht 2010	4. November
Analystenkonferenz auf dem Deutschen Eigenkapitalforum Herbst 2010	22. – 24. November

IMPRESSUM & KONTAKT

Impressum

Herausgeber:	SÜSS MicroTec AG
Redaktion:	Investor Relations, Finance
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung:	IR-One AG & Co., Hamburg
Druck:	Druckerei BluePrint Group, Munich
Fotos:	SÜSS MicroTec AG, DELO Industrie Klebstoffe, Getty Images, Corbis Images, istockphoto
Infografiken:	Manuela Heins

Kontakt

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Fon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Fon: +49 (0)89-32007-161
E-Mail: ir@suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

HIGHLIGHTS 2009

Januar



Nächste Generation des Coat/Develop-Cluster ACS300 vorgestellt

Anlässlich der Semicon Korea 2009 hat SÜSS MicroTec die zweite Generation des ACS300 Clusters vorgestellt, einem modularen System für die Belackung, Aushärtung und Entwicklung von Wafern bis 300mm Durchmesser. Das speziell für das Advanced Packaging und die 3D-Bearbeitung ausgerichtete System verfügt über die höchste derzeit auf dem Markt erhältliche Belackungs- und Entwicklungskonformität sowie eine hohe Konfigurationsflexibilität bei gleichzeitig niedrigeren Ausrüstungskosten. Seit seiner Markteinführung wurde der ACS300 Gen2 weltweit bereits 22-mal verkauft.

Februar



Frank Averdung übernimmt vorzeitig den Vorstandsvorsitz

Frank Averdung übernimmt mit Wirkung zum 1. Februar 2009 den Vorstandsvorsitz der SÜSS MicroTec AG. Der Aufsichtsrat hatte den vormaligen Geschäftsführer der Carl Zeiss

SMS GmbH bereits im November 2008 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der Diplom-Elektroingenieur verantwortet in seiner Funktion bei SÜSS MicroTec die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion, Arbeitssicherheit, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Qualitätsmanagement und Konzernstrategie.

April



60 Jahre SÜSS MicroTec

Am 1. April 1949 gründete der Kaufmann Karl Süß in einer ausgebombten Wohnung in der Christophstraße in München sein gleichnamiges Unternehmen. Bereits damals basierte das Geschäft auf dem Vertrieb von optischen und feinmechanischen Produkten wie Mikroskopen und Messgeräten. Anlässlich des sechzigjährigen Firmenjubiläums hat SÜSS MicroTec unter dem Motto „Innovative Minds – 60 Years of Engineering Spirit“ eine Kampagne gestartet, die neben der erfolgreichen und bewegten Firmenhistorie auch aktuelle Unternehmensentwicklungen sowie Aktivitäten zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern vorstellt.

Nemotek Technologies kauft SÜSS-Equipment für die Produktion von Wafer-Level-Kameras

Nemotek Technologies, ein weltweit führender Hersteller von kundenspezifischen Wafer-Level-Kameras für mobile Anwendungen, entscheidet sich für die Anschaffung zahlreicher Lithografie-systeme von SÜSS MicroTec. Neben dem 200mm Mask Aligner für die Produktion beinhaltet das Paket Anlagen zur Belackung, Aushärtung und Entwicklung. Das SÜSS MicroTec-Equipment wird in Nemoteks Fertigung in Marokko für die Herstellung von Bildsensoren eingesetzt.

Mai



Christian Schubert scheidet aus dem Vorstand der SÜSS MicroTec AG

Mit dem Ende seiner Bestellung scheidet Christian Schubert am 31. Mai 2009 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Der Diplom-Kaufmann war sein Vorstandsmandat am 2. Oktober 2008 interimistisch angetreten und hatte sich während seiner acht-monatigen Schaffenszeit insbesondere der Optimierung des Einkaufs- und Beschaffungswesens sowie der Materialwirtschaft gewidmet.

Juni



Hauptversammlung – Nachwahl zum Aufsichtsrat

Rund 120 Aktionäre, Bankvertreter und Gäste folgten der Einladung der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2009 nach München, um sich ausführlich über die produktstrategische Ausrichtung des Unternehmens und den Zukunftsmarkt der 3D-Integration zu informieren. In der anstehenden Nachwahl zum Aufsichtsrat wird Herr Sebastian Repegather als Nachfolger für Herrn Dr. Franz Richter in den Aufsichtsrat gewählt.

3M und SÜSS MicroTec schließen Kooperationsvereinbarung im Bereich 3D-Integration

3M, einer der führenden Anbieter von modernen Werkstoffen für die Halbleiterindustrie, und SÜSS MicroTec schließen eine Kooperationsvereinbarung über Entwicklung und Vertrieb von permanenten und temporären Bonding- und De-Bonding-Technologien für die dreidimensionale Systemintegration sowie die Herstellung von Durchkontaktierungen (TSVs – Through Silicon Vias). SÜSS MicroTec avanciert damit zum autorisierten Ausrüster für das Wafer-Support-System (WSS) von 3M und wird eigens für diese Prozesse konfigurierte Bondsysteme auf Basis der Wafer Bonder XBC300 und CBC300 herstellen und vertreiben.

Juli



Entwicklungskooperationen im Bereich der 3D-Integration mit Partnern aus Industrie und Forschung abgeschlossen

Im Juli kann SÜSS MicroTec den erfolgreichen Abschluss von zwei weiteren Entwicklungskooperationen im Bereich der 3D-Integration bekannt geben. Zu den Entwicklungspartnern aus Industrie und Forschung zählt neben der Thin Materials AG das belgische Forschungszentrum für Nanoelektronik IMEC. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die gemeinsame Entwicklung von permanenten und temporären Bonding und De-Bonding-Prozessen für den Zukunftsmarkt der 3D-Integration sowie die Herstellung von Durchkontaktierungen (TSVs). Thin Materials sowie IMEC setzen dabei maßgeblich auf den Wafer Bonder XBC300 von SÜSS MicroTec, der sich dank seiner modularen Bauweise und Prozessflexibilität optimal für die Umsetzung der beiden verschiedenen Prozesslösungen eignet.

September



SÜSS MicroTec stellt weltweit erstes Testsystem für die 3D-Integration vor

Anfang September stellt SÜSS MicroTec das weltweit erste Testsystem für die elektronische Prüfung von dreidimensionalen, gestapelten Strukturen auf 300mm Wafer-Ebene

vor. Das neue Testsystem PA300PS 3D wurde eigens für die 3D-Integration entwickelt und erlaubt die Durchführung verschiedener Tests während der Prozessentwicklung sowie die Funktionsprüfung nach der Wafer-Herstellung und vor weiteren Stapelvorgängen.



SÜSS MicroTec und taiwanesisches Forschungsinstitut ITRI kooperieren

Ende September gibt SÜSS MicroTec die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Forschungsinstitute im Bereich der Halbleiterindustrie, dem Industrial Technology Research Institut (ITRI) in Taiwan, bekannt. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Weiterentwicklung von Verpackungstechnologien im Bereich der Chipherstellung (3D-Integration) durch das Ad-STAC-Konsortium, einem Zusammenschluss von 13 multinationalen Equipment-, Material- und Applikationsherstellern der Halbleiterindustrie. Im Rahmen der Kooperation werden der 300mm Lithografie-Cluster LithoPack300 sowie der Bond-Cluster XBC300 in der Demo-Produktionslinie in Hsin-Chu, Taiwan, eingesetzt werden.

November



Finanzvorstand verpflichtet sich für weitere fünf Jahre

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft verlängert den bestehenden Vorstandsvertrag von Herrn Michael Knopp vorzeitig um weitere fünf Jahre und spricht damit sein Vertrauen in die Leistung des 43-jährigen Diplom-Kaufmanns aus. Herr Michael Knopp war im August 2007 als Finanzvorstand zur SÜSS MicroTec AG gekommen und ist insbesondere für die erfolgreiche SAP-Einführung sowie die Umsetzung der Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen verantwortlich.

Dezember



Kauf der HamaTech APE GmbH & Co. KG

Am 6. Dezember teilt die SÜSS MicroTec AG ihre Absicht mit, die HamaTech APE, eine 100-prozentige Tochter der Singulus Technologies AG sowie ein entsprechendes Produktionsgebäude am Standort der HamaTech APE in Sternenfels zu übernehmen. Die HamaTech APE ist einer der weltweit führenden Ausrüster für die Reinigung von Fotomasken in der Halbleiterindustrie und verfügt derzeit als weltweit einziger Anbieter über Lösungen zur Reinigung von Masken für die EUV-Lithografie. SÜSS MicroTec erweitert durch die Akquisition ihr bestehendes Produktportfolio im Bereich Nassprozesse.

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Fon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

www.suss.com